

การพัฒนาเครื่องวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์



นายรุจพันธ์ เกตุกล้า

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี

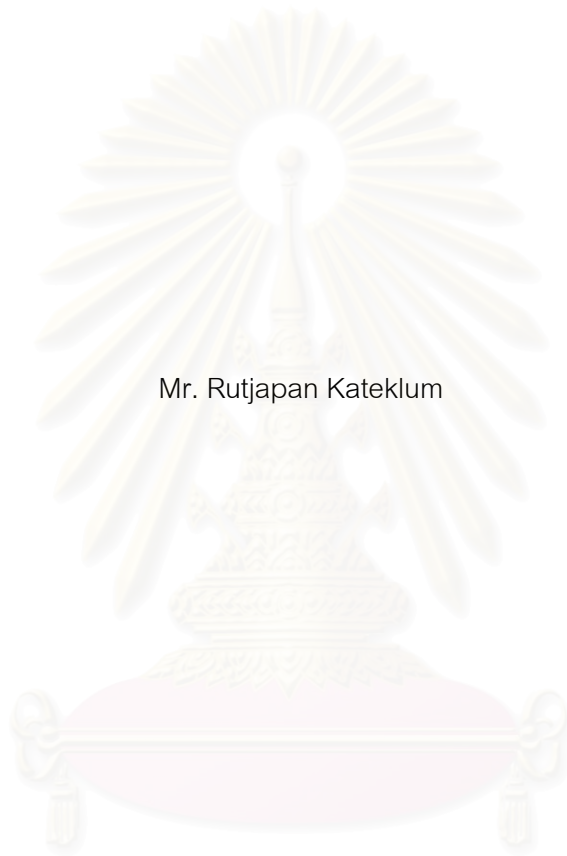
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2546

ISBN 974-17-5189-3

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEVELOPMENT OF A VIRTUAL NUCLEAR INSTRUMENT CONTROLLED BY MICROCOMPUTER



Mr. Rutjapan Kateklum

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering in Nuclear Technology

Department of Nuclear Technology

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2003

ISBN 974-17-5189-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์      การพัฒนาเครื่องวัดนิวเคลียร์แบบเสถียรแบบอัตโนมัติด้วย  
ไมโครคอมพิวเตอร์  
โดย                              นายรุจพันธ์ เกตุกล้า  
สาขาวิชา                      นิวเคลียร์เทคโนโลยี  
อาจารย์ที่ปรึกษา              อาจารย์ เดโช ทองอร่าม  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปุณณชัยยะ

---

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน  
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ สมยศ ศรีสถิตย์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(อาจารย์ เดโช ทองอร่าม)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปุณณชัยยะ)

..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพร ภัทรสุมันต์)

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูกพันธ์ เกตุกล้า : การพัฒนาเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์.(DEVELOPMENT OF VIRTUAL NUCLEAR INSTRUMENT CONTROLLED BY MICROCOMPUTER) อ.ที่ปรึกษา: อ.เดโช ทองอร่าม, อ.ที่ปรึกษาร่วม: ผศ. สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 79 หน้า.ISBN 974-17-5189-3

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนบนไมโครคอมพิวเตอร์ (VIRTUAL NUCLEAR INSTRUMENT) โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของระบบวัดเพื่อใช้แทนเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบโมดูลาร์ (MODULAR ELECTRONICS) ที่มีข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนหลักคือ ระบบวัดรังสี ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรแกรมควบคุมระบบวัดมีรูปแบบการทำงานเป็นเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน ซึ่งระบบวัดรังสีในส่วนขยายสัญญาณที่มีความเป็นเชิงเส้นของอัตราขยายแบบดิฟเฟอเรนเชียล 0.9930 และการรับข้อมูลวัดระดับความแรงรังสีจากเรตมิเตอร์ได้ 8 ช่องวัด ซึ่งแต่ละช่องวัดสามารถรับสัญญาณขนาด 0 ถึง 2.5 โวลต์ โดยสามารถให้กำเนิด สัญญาณอ้างอิงดิสคริ-มิเนเตอร์ระดับต่ำ (LLD) ขนาด 0 ถึง 10 โวลต์ มีความละเอียด 2.4 มิลลิโวลต์ในการตั้งค่าหน้าตาต่างวิเคราะห์พลังงานและมีความเป็นเชิงเส้น 0.9999 ในส่วนโปรแกรมควบคุมการทำงานประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 2 ส่วนคือ โปรแกรมควบคุมการรับข้อมูลวัดระดับสัญญาณจากเรตมิเตอร์และโปรแกรมควบคุมการวิเคราะห์พลังงานของอุปกรณ์วิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว(SCA) พร้อมแสดงผลวิเคราะห์สเปกตรัมทางจอภาพผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนเพื่อทดแทนระบบวัดแบบโมดูลาร์ โดยลดขนาดของระบบซึ่งจะลดต้นทุนและมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทันสมัยขึ้น

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา นิวเคลียร์เทคโนโลยี  
สาขาวิชา นิวเคลียร์เทคโนโลยี  
ปีการศึกษา 2546

ลายมือชื่อนิสิต.....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

## 4370468021: MAJOR NUCLEAR TECHNOLOGY

KEY WORD: VIRTUAL NUCLEAR INSTRUMENT / MODULAR ELECTRONICS

RUTJAPAN KATEKLUM:DEVELOPMENT OF A VIRTUAL NUCLEAR INSTRUMENT

CONTROLLED BY MICROCOMPUTER THESIS ADVISOR: DECHO THONG – ARAM

THESIS CO – ADVISOR: ASST. PROF. SUVIT PUNNACHAIYA

79 pp. ISBN 974 – 17 – 5189 - 3

This thesis is an attempt to develop a virtual nuclear instrument to be controlled by microcomputer which can be transformed as an instrument of more efficient functions in order that the regular type of nuclear instrument (the modular electronics) which can not be efficiently transformed can be replaced by this virtual nuclear instrument in the future. The newly developed, the virtual nuclear instrument is composed of 4 parts as follows, the radiation detection systems, the interface system, the micro controller and the virtual nuclear instrument program which has linearity of 0.9930 for the differential gain of amplifier and receives a signal level from 8 modules of ratemeter. Each channel can accept the signal of 0 to 2.5 V. The systems can generate a 0 to 10V low level discriminator scanning signal with resolution for energy window setting of 2.4 mV and linearity of 0.9999. The control program consists of two menus, i.e the ratemeter service routine and the single channel analyzer service routine. It is hopeful that this thesis will generate a new direction in adapting a newly and more efficient instrument in order to replace the modular electronics. The new instrument will be composed of small scale of systems which in turn will reduce the cost of production, and will produce a modern automatic control system.

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department Nuclear technology

Field of study Nuclear technology

Academic year 2003

Student's signature.....

Advisor's signature.....

Co-Advisor's signature.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือ และสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ เดโช ทองอร่าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปุณณชัชยะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาแนะนำ ให้คำปรึกษา และตรวจสอบรายงานการวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณ ภาควิชานิเทศศาสตร์เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและสำนักงานปรมานูเพื่อสันติที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์ สำหรับการทำวิจัยนี้

ขอขอบคุนอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์เทคโนโลยี ทุกคนที่ให้คำแนะนำ สนับสนุนงานวิจัยนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่เคารพรักอย่างยิ่งหาที่เปรียบมิได้ของกระผมที่ให้กำลังใจ ความรัก ความเมตตา สนับสนุนช่วยเหลืออย่างดีที่สุด ขอขอบคุน ภรรยา และพี่น้องร่วมงาน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการพิมพ์ต้นฉบับวิทยานิพนธ์จนเสร็จสิ้นบูรณ์



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.....	2
1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์.....	2
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 อุปกรณ์นิวเคลียร์.....	4
2.2 การจัดระบบวัดนิวเคลียร์.....	5
2.3 เครื่องมือแบบเสมือน.....	7
2.4 ระบบดาต้าเอกควิซชั่น.....	9
3. การดำเนินการวิจัย.....	13
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบโมดูลาร์.....	13
3.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน.....	13
3.3 การออกแบบระบบวัด.....	18
3.4 การออกแบบระบบเชื่อมโยงสัญญาณ.....	26
3.5 การออกแบบระบบประมวลผล.....	28
3.6 การออกแบบโปรแกรม.....	30

บทที่	หน้า
4. การทดสอบสมรรถนะและการทำงานของเครื่อง .....	40
4.1 การทดสอบวงจรภาคขยาย.....	40
4.2 การทดสอบวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว.....	43
4.3 การทดสอบวงจรเรตมิเตอร์.....	46
4.4 การทดสอบวงจรแปลงสัญญาณเชิงตัวเลข( ADC ) .....	48
4.5 การทดลองระบบวิเคราะห์พลังงานแบบ SCA SWEEP.....	51
5. สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ.....	53
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	53
5.2 ปัญหาและอุปสรรค.....	54
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	54
รายการอ้างอิง.....	56
ภาคผนวก.....	57
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	79



## สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
ตารางที่ 4.1	ผลทดสอบความเป็นเชิงเส้นของอัตราขยายแบบดิฟเฟอเรนเชียล.....	42
ตารางที่ 4.2	ผลทดสอบความเป็นเชิงเส้นของสเกล LLD.....	44
ตารางที่ 4.3	ผลทดสอบความเป็นเชิงเส้นของสเกล $\Delta E$ .....	45
ตารางที่ 4.4	ผลทดสอบความเป็นเชิงเส้นของ เรตมิเตอร์.....	47
ตารางที่ 4.5	ผลทดสอบการแปลงสัญญาณเชิงตัวเลขของวงจร ADC.....	50



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงการจัดระบบนับอนุภาค.....	5
รูปที่ 2.2 แสดงการจัดระบบนับแบบช่องเดี่ยว.....	6
รูปที่ 2.3 แสดงการจัดระบบวิเคราะห์พลังงานแบบ SCA SWEEP.....	6
รูปที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบการจัดระบบเครื่องมือวัดนิวเคลียร์.....	7
รูปที่ 2.5 แสดงแผนผังทั่วไปของเครื่องมือเสมือน.....	8
รูปที่ 3.1 แผนภาพการทำงานของระบบเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน.....	14
รูปที่ 3.2 โปรแกรมเครื่องมือนิวเคลียร์แบบเสมือน.....	15
รูปที่ 3.3 แสดงส่วนประกอบของระบบวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน.....	17
รูปที่ 3.4 แผนภาพการทำงานของภาคขยาย.....	18
รูปที่ 3.5 วงจรภาคขยายสัญญาณพัลส์.....	19
รูปที่ 3.6 แสดงแผนภาพการทำงานของวงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์.....	20
รูปที่ 3.7 วงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดี่ยว.....	22
รูปที่ 3.8 แผนภาพการทำงานของวงจรเรตมิเตอร์.....	23
รูปที่ 3.9 วงจรเรตมิเตอร์.....	25
รูปที่ 3.10 แหล่งจ่ายศักดาไฟฟ้าต่ำ.....	26
รูปที่ 3.11 แผนภาพการแสดงระบบเชื่อมโยงสัญญาณ.....	27
รูปที่ 3.12 วงจรเชื่อมโยงสัญญาณจากพอร์ตขนานของไมโครคอมพิวเตอร์.....	28
รูปที่ 3.13 แผนภาพแสดงการรับสัญญาณจากวงจรเรตมิเตอร์.....	29
รูปที่ 3.14 แผนภาพแสดงการส่งสัญญาณควบคุมวงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่อง เดี่ยว.....	29
รูปที่ 3.15 เรตมิเตอร์เสมือน.....	31
รูปที่ 3.16 แผนภาพแสดงโปรแกรมเรตมิเตอร์แบบเสมือน.....	33
รูปที่ 3.17 เครื่องวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดี่ยวแบบเสมือน.....	34
รูปที่ 3.18 แผนภาพแสดงโปรแกรมควบคุมวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบเสมือน.....	36
รูปที่ 3.19 แผนภาพแสดงโปรแกรมควบคุมวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบเสมือน(ต่อ).....	37
รูปที่ 3.20 แผนภาพแสดงโปรแกรมควบคุมการรับค่าเรตมิเตอร์.....	38
รูปที่ 3.21 แผนภาพแสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการจัดระบบวัด.....	39

บทที่	หน้า
รูปที่ 4.1 แผนภาพการจัดอุปกรณ์ทดสอบวงจรขยายสัญญาณพัลส์.....	40
รูปที่ 4.2 แผนภาพสัญญาณพัลส์ทางเข้าและออกจากวงจรขยายสัญญาณพัลส์ .....	41
รูปที่ 4.3 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นของอัตราขยายซึ่งทดสอบแบบดิฟเฟอเรนเชียล.....	42
รูปที่ 4.4 แผนภาพการจัดอุปกรณ์ทดสอบวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว.....	43
รูปที่ 4.5 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นของสเกลศักดาไฟฟ้าอ้างอิง LLD .....	45
รูปที่ 4.6 แผนภาพการจัดอุปกรณ์ทดสอบเรตมิเตอร์ .....	46
รูปที่ 4.7 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นของเรตมิเตอร์.....	48
รูปที่ 4.8 แผนภาพการจัดอุปกรณ์ทดสอบวงจรแปลงสัญญาณเชิงตัวเลข.....	49
รูปที่ 4.9 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นของการแปลงสัญญาณเชิงเลขของวงจร ADC.....	50
รูปที่ 4.10 แผนภาพการจัดระบบวิเคราะห์พลังงานแบบ SCA SWEEP.....	51
รูปที่ 4.11 แผนภาพสเปกตรัมของ Cs – 137.....	52

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 .ความเป็นมาและความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบโมดูลาร์ (MODULAR) มีข้อจำกัดในด้านที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสมรรถนะของฟังก์ชันใช้งานได้ ดังนั้นเครื่องมือวัดนิวเคลียร์ที่ควบคุมการทำงานผ่านไมโครคอมพิวเตอร์จึงเป็นที่นิยมใช้ในยุคปัจจุบันเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มสมรรถนะฟังก์ชันการทำงานได้โดยการแก้ไขโปรแกรม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความเร็วของระบบการประมวลผลได้ตามสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ซึ่งกล่าวโดยรวมแล้วจะมีค่าใช้จ่ายคุ้มทุนกว่าแบบโมดูลาร์ (MODULAR) ส่วนระบบเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างเครื่องมือทางนิวเคลียร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตเครื่องพิมพ์ (PRINTER PORT) จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากกว่าการเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบบัสของคอมพิวเตอร์โดยตรง โปรแกรมกราฟิก (GRAPHICAL PROGRAMMING) ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับระบบวัดทางนิวเคลียร์สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือออกแบบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากสื่อความหมายได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ การเขียนโปรแกรมแบบที่มีลักษณะข้อความ (TEXT MODE) และการสั่งงานของสวิทช์หรือส่วนแสดงผลของระบบวัดก็จะเป็นแบบกราฟิกบนหน้าจออมอนิเตอร์ซึ่งจะเสมือนเป็นส่วนของหน้าปัทม์ (FRONT PANEL) ของเครื่องมือวัดนิวเคลียร์โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางฮาร์ดแวร์ ลึกซึ้งก็จะสามารถใช้เครื่องมือวัดนี้ได้อย่างดี

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

## 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1. พัฒนาระบบวัดนิวเคลียร์แต่ละส่วนได้แก่ ภาคขยายสัญญาณหลัก อุปกรณ์วิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดี่ยวและเรทมิเตอร์พร้อมระบบควบคุมการทำงานผ่านพอร์ตขนานเครื่องพิมพ์ของไมโครคอมพิวเตอร์
2. พัฒนาโปรแกรม ควบคุมระบบวัดให้มีรูปแบบการทำงานเป็นเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน
3. ทดสอบและเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานกับเครื่องมือวัดที่ผลิตจากต่างประเทศ

## 1.4 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบและสร้างระบบวัดนิวเคลียร์แต่ละส่วนได้แก่ ภาคขยายสัญญาณหลัก อุปกรณ์วิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดี่ยวและเรทมิเตอร์
3. ออกแบบและสร้างระบบควบคุมการทำงานผ่านพอร์ตเครื่องพิมพ์ของไมโครคอมพิวเตอร์
4. พัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบวัดให้มีรูปแบบการทำงานเป็นเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน
5. ทดสอบและเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานกับเครื่องมือวัดที่ผลิตจากต่างประเทศ
6. สรุปผลและเขียนวิทยานิพนธ์

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้

ได้เครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนที่มีความสะดวกในการใช้งาน ลดการนำเข้าเครื่องมือนิวเคลียร์จากต่างประเทศและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องมือวัดนิวเคลียร์สำหรับงานด้านการเรียนการสอน

## 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ปี 1992 หัสฤกษ์ เนียมอินทร์, สุวิทย์ ปุณณชัยยะ . การพัฒนา A UNIVERSAL INTERFACE CARD FOR NUCLEAR MEASURING SYSTEMS ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนา Universal card สำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบ NIM และ ไมโครคอมพิวเตอร์โดยสามารถประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการควบคุมระบบ นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์โดยส่วน ของโปรแกรมเมนูประกอบ ด้วยส่วนของ Scaler, Rate meter, SCA , Nucleonic control
2. ปี 2000 Janguang Dai ; Guangju Chen : VISUAL TESTING SOFTWARE ENVIRONMENT USING OBJECT – ORIENTED PROGRAMMING, AUTOTESTCON PROCEEDINGS ,IEEE , 2000 Page (s): 328 – 333 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ Object Oriented Program ( OOP) ในการ พัฒนา โปรแกรมขนาดใหญ่สำหรับการประยุกต์การวัด การประยุกต์ใช้ OOP มาใช้กับ ระบบ Radar Testing และ High speed multi data acquisition systems
3. ปี 2001 S. Nuccio, C. Spataro : APPORACHES TO EVALUATE THE VIRTUAL INSTRUMENTATION MEASUREMENT UNCERTAINTIES, IEEE INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, Page(s): 84 - 89. ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดแหล่ง สัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนโดยเครื่องมือวัดเสมือนซึ่งใช้ 2 วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือคือ Numerical method simulating กระบวนการของ Analog to Digital Conversion และวิธี Approximated Theoretical Method applying the uncertainly propagation law โดยนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือสูง

## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 อุปกรณ์นิวเคลียร์

ระบบวัดนิวเคลียร์มีส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วน [1] คือ 1. หัววัดรังสี 2. ส่วนขยายสัญญาณ 3. ส่วนสร้างกระบวนการเก็บข้อมูล 4. ส่วนแสดงผล องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนจะทำหน้าที่สร้างกระบวนการของสัญญาณไฟฟ้า ที่ได้รับจากอันตรกิริยาของอนุภาคนิวเคลียร์จนกระทั่งแสดงผลการวัดในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ต่างๆคือ

2.1.1 แหล่งจ่ายศักดาไฟฟ้าแรงสูง ปรับค่าได้ (High voltage power supply)

2.1.2 อุปกรณ์ขยายและแต่งรูปสัญญาณ

2.1.2.1 ภาคขยายส่วนหน้า (Preamplifier)

2.1.2.2 ภาคขยายหลัก (Main amplifier)

2.1.2.3 ดิสคริมิเนเตอร์ (Discriminator)

2.1.3 อุปกรณ์นับรังสี

2.1.3.1 สเกลเลอร์ หรือ เคาน์เตอร์ (Scaler or Counter)

2.1.3.2 เครื่องตั้งเวลา (Timer)

2.1.3.3 เรทมิเตอร์ (Rate meter)

2.1.4 อุปกรณ์วิเคราะห์ความสูงของพัลส์ (Pulse high analyzer)

2.1.4.1 อุปกรณ์วิเคราะห์แบบช่องเดียว (SCA)

2.1.4.2 อุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (MCA)

2.1.5 อุปกรณ์บันทึกผลและแสดงผล

2.1.5.1 เครื่องโทรพิมพ์ (Teletype)

2.1.5.2 เครื่องพิมพ์ (Printer)

2.1.5.3 เครื่องเขียนกราฟ (x-y recorder)

2.1.5.4 เครื่องบันทึกแถบแม่เหล็ก (Tape recorder)

## 2.2 การจักระบบวัดนิวเคลียร์

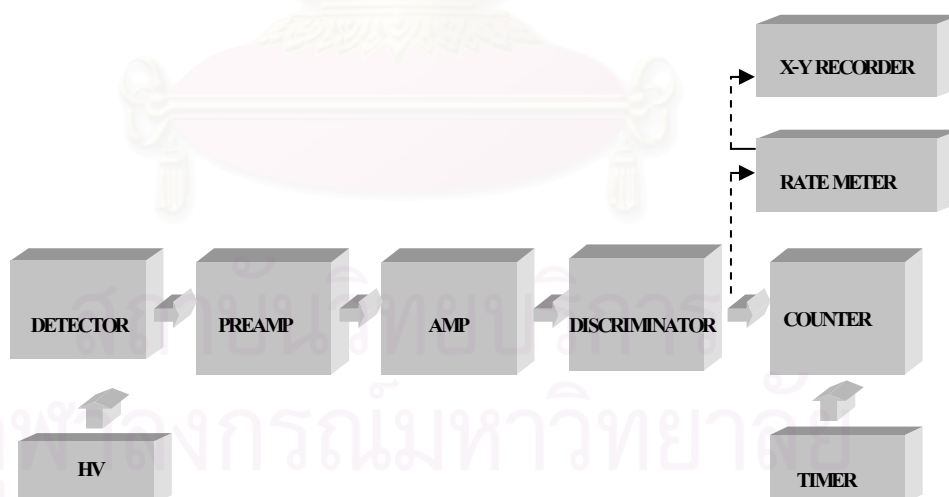
การจักระบบวัดนิวเคลียร์ได้เป็นระบบต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้วัดต้นกำเนิดรังสีและผลของข้อมูลที่ต้องการ แต่โดยทั่วไปแล้วหลักของการจักระบบวัดแบ่งออกเป็น 2 ระบบ [1] ใหญ่คือ

### 2.2.1 การจักระบบนับอนุภาค

ใช้วัดความแรงรังสีประกอบด้วย หัววัดรังสีและแหล่งจ่ายศักดาไฟฟ้าแรงสูง ส่วนขยายสัญญาณพัลส์ส่วนตัดสัญญาณรบกวน ส่วนบันทึกผลการนับและแสดงผลในหน่วยจำนวนนับต่อหน่วยเวลาหรือค่าเฉพาะCPM หรือ CPS [1]

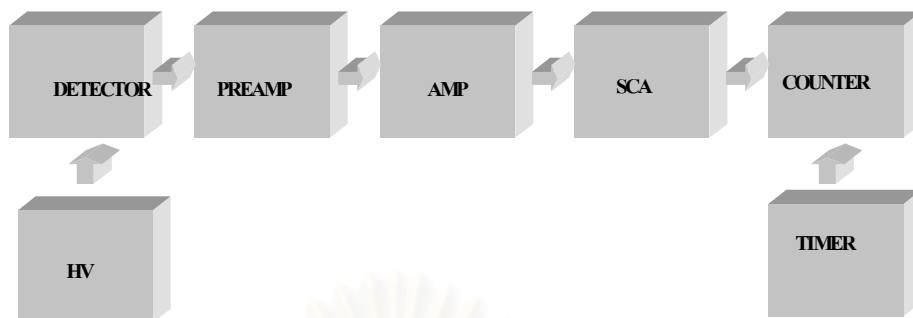
### 2.2.2 การจักระบบวิเคราะห์ระดับพลังงาน

ใช้ในงานวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วยหัววัดรังสีและแหล่งจ่ายศักดาไฟฟ้าแรงสูง ส่วนขยายสัญญาณ อุปกรณ์วิเคราะห์ความสูงของพัลส์ อุปกรณ์นับและแสดงผลข้อมูล [1] ผลของการวิเคราะห์พลังงานจะแสดงในรูปของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนับที่เปลี่ยนไปเทียบกับระดับพลังงานค่าต่างๆหรือสเปกตรัม

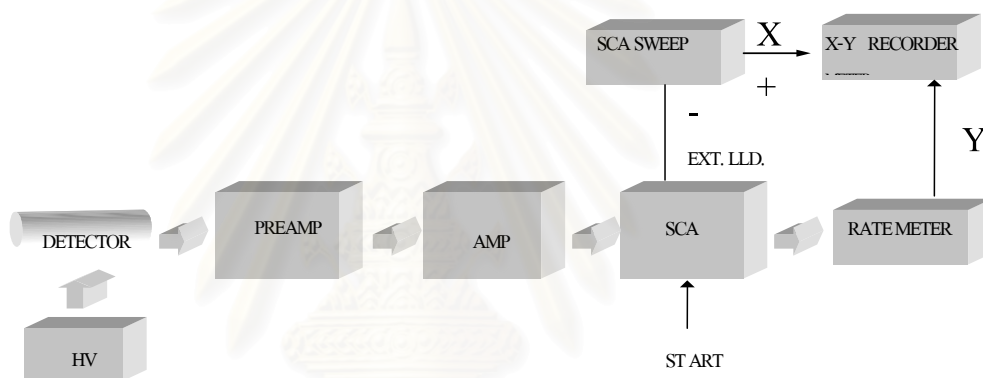


รูปที่ 2.1 แสดงการจักระบบนับอนุภาค





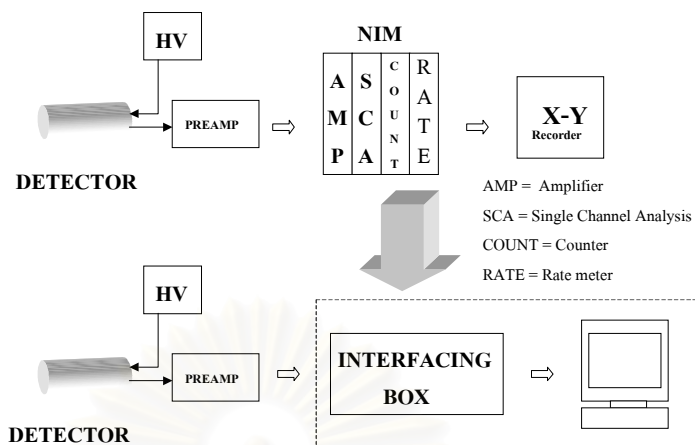
รูปที่ 2.2 แสดงการจัดระบบนับแบบช่องเดียว



รูปที่ 2.3 แสดงการจัดระบบวิเคราะห์พลังงานแบบ

SCA SWEEP

จากรูปที่ 2.1, 2.2, 2.3 แสดงระบบวัดนิวเคลียร์แบบต่างๆ โดยอยู่ในกลุ่มการจัดระบบวัดแบบนับอนุภาคและระบบวิเคราะห์ระดับพลังงาน



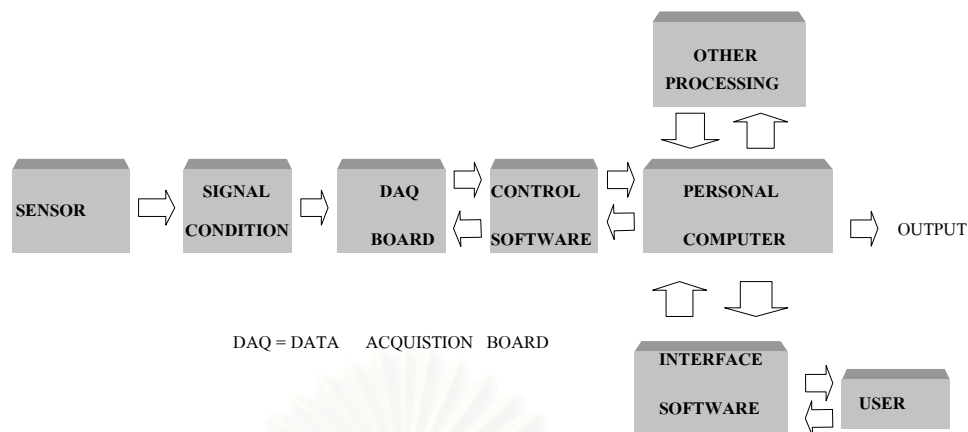
รูปที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบการจัดระบบเครื่องมือวัดนิวเคลียร์

รูปที่ 2.4 แสดงการพัฒนาของระบบวัดของระบบโมดูลาร์ ( Modular ) ซึ่งมีการปรับพารามิเตอร์แบบ Manual ให้เป็นระบบวัดที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์โดยมีการปรับพารามิเตอร์ด้วยการสั่งงานจาก Computer

### 2.3 เครื่องมือแบบเสมือน ( Virtual Instrument )

เครื่องมือแบบเสมือน ( Virtual Instrument หรือ VI ) [10] โดยคำว่า “เสมือน” บ่งบอกถึงการที่ซอฟต์แวร์กระทำการเลียนแบบทางกายภาพของเครื่องมือโดยตรวจวัดและประมวลผลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีความแตกต่างจากเครื่องมือเฉพาะทาง กล่าวคือ VI จะใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันมีความเร็วในการประมวลผลสูงดังนั้นจึงให้ความหลากหลายของงานโดยขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่ใช้

คำจำกัดความ ( Definition ) [10] เครื่องมือเสมือน ( Virtual Instrument ) คือ การนำเครื่องมือวัดที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์เพิ่มส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์กับไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการเชื่อมโยงสั่งการผ่านกราฟิก ( Visual user interface ) หรือหน้าปัดเสมือน ( Virtual panel ) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์สู่เครื่องมือ



รูปที่ 2.5 แสดงแผนผังทั่วไปของเครื่องมือเสมือน

จากรูปที่ 2.5 ประกอบด้วยส่วนต่างๆคือ

1. ส่วนที่เป็น sensor transducer หรือ detector ทำหน้าที่แปลงปริมาณฟิสิกส์ใด ๆ ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าและส่วน signal conditioner ทำหน้าที่ขยายและปรับแต่งสัญญาณทางไฟฟ้า
2. ส่วนที่เป็นคาน้ำเอกควิชชัน ( sampler, A/D convertor ) เป็นส่วนที่แปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณระดับดิจิทัลและสุ่มสัญญาณ
3. ส่วนที่เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการประมวลผลสัญญาณและควบคุมการทำงานของระบบ
4. ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ ( data acquisition board control, processing , user interface )

โดยส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์มีหน้าที่ในการควบคุมและแสดงผลเลียนแบบเครื่องมือทางกายภาพวัตถุ เช่นออสซิลโลสโคป (Oscilloscopes) หรือมัลติมิเตอร์ (Multimeter) โดยใช้ฟังก์ชันในการประมวลสัญญาณ ทางอินพุทและแสดงผลสู่คอมพิวเตอร์

## 2.4 ระบบดาต้าแอกควิซิชัน

ระบบดาต้าแอกควิซิชัน (Data acquisition system : DAQ) [3] เป็นการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจริงในงานวิจัยทดลองวิทยาศาสตร์และทดสอบงานวิศวกรรมเชิงคุณภาพและ ประสิทธิภาพผ่านคอมพิวเตอร์ โดยมีความแตกต่างจากระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปตรงที่มีฮาร์ดแวร์ พิเศษเพื่อตรวจจับสัญญาณทางกายภาพทางวิทยาศาสตร์ เช่น อุณหภูมิ ความดันอากาศ หรืออัตราการไหลแล้วแปลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาตามคุณลักษณะของ งานวิจัยทดลองนั้นๆ ในลักษณะเวลาจริง (real-time) ซึ่งในอดีตมักใช้ระบบเฉพาะเจาะจงลงไปตาม ประเภทงานไม่สามารถใช้งานร่วมกับงานวิจัยอื่นได้ ทั้งยังมีราคาที่สูงมากเนื่องด้วยความสามารถ ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบันกับการใช้งานที่ง่ายขึ้นของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการใน ลักษณะที่เป็นวินโดวส์หรือเป็นกราฟฟิกทำให้การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานดาต้าแอกควิซิชัน ไม่ยุ่งยากและให้ความคล่องตัวกับนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรเพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวได้เองจาก ฮาร์ดแวร์พิเศษและซอฟต์แวร์งานด้านดาต้าแอกควิซิชันที่มีให้เลือกมากมาย และสามารถใช้งาน ร่วมกันได้โดยส่วนใหญ่ทำให้ราคาระบบโดยรวมมีราคาไม่สูง และให้ประสิทธิภาพในการพัฒนา ประเทศเชิงเทคโนโลยีได้ดีกว่า

### 2.4.1 การประยุกต์การใช้งานกับระบบดาต้าแอกควิซิชัน

การนำเอาระบบดาต้าแอกควิซิชันมาประยุกต์ใช้ในงานวัดและทดสอบอัตโนมัติเพื่องาน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนั้นสามารถกระทำได้หลากหลายมาก เนื่องจากผู้พัฒนาระบบหรือผู้วิจัย สามารถเพิ่มเติมปรับแต่งและกำหนดค่าได้ตามลักษณะของซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นๆ ในหน้าที่หลัก ของซอฟต์แวร์คือเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์วัดหรือตัวตรวจจับ (sensor) มาเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูล แล้วทำการแสดงผลข้อมูลที่ได้รับตามเวลาจริงที่หน้าจอแสดงผลในลักษณะภาพ กราฟฟิก อีกทั้งยังสามารถป้อนข้อมูลตั้งค่าวัดและทดสอบได้ จากนั้นนำข้อมูลที่รวบรวมได้มา ประมวลผลวิเคราะห์ตามเงื่อนไขฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ออกมาเป็นกราฟคุณลักษณะของกลุ่ม ข้อมูลจากการสุ่ม [3]

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในระบบงานดาต้าแอกควิซิชันมีดังนี้

ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น, การสื่อสาร ข้อมูลดิจิทัล การทดลองทฤษฎีงานควบคุม งานประมวลผลสัญญาณ (signal processing) ทดลอง หลักการคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก

ในงานวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ระบบวัดและทดสอบอัตโนมัติ งานทดลองกลศาสตร์ของ ไหล, งานทดสอบการส่งถ่ายความร้อนและมวลสาร ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ในงานวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เช่น ระบบวัดค่ากายภาพวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แรง ความดัน น้ำหนักและอุณหภูมิ ระบบวัดสนามแม่เหล็กและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า เลเซอร์

ในงานชีวภาพเช่น งานทดสอบโมเดลถ่ายทอดพันธุ์ ระบบงานรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวทางกายภาพ การวัดการขยายตัวของออกซิเจน มิเตอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG EKG :electro cardiogram ) งานทดสอบโครงสร้างและสมรรถภาพกล้ามเนื้อ

ในงานวิศวกรรมเคมีเช่น การวัดแคลอรีเผาผลาญ, งานวิเคราะห์สารทางเคมีแบบดิจิทัล, การวัดไอโซโทป ( half-life of isotopes) งานพัฒนาสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ งานวิเคราะห์ผังโมเลกุลโทโปกราฟี ( topography) งานทดสอบการเชื่อมผ่านถ่ายความร้อนสาร

ในงานประมวลคณิตศาสตร์เช่นการ คำนวณเชิงพีชคณิต การจัดวางค่าที่ให้ผลดีที่สุด การอินทิเกรตและดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงรูปสมการคณิตศาสตร์

ดังนั้นด้วยการใช้งานระบบค้ำแอกควิซันจึงสามารถพัฒนาระบบการวัดและทดสอบอัตโนมัติได้หลากหลาย ที่สามารถครอบคลุมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตและระบบการทดสอบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสาร อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในการทำงานไปจนถึงสามารถที่จะพัฒนาระบบค้ำแอกควิซันอย่างง่ายขึ้นใช้เอง

#### 2.4.2 ส่วนชุดตรวจจับสัญญาณกายภาพ

ชุดตรวจจับสัญญาณกายภาพหรือทรานสดิวเซอร์ (Transducer) คือตัวแปลงสัญญาณทางกายภาพ เช่นอุณหภูมิ ความดัน ระดับของไหล ความยาว ตำแหน่งการเคลื่อนที่ ฯลฯ ให้เป็นรูปสัญญาณทางไฟฟ้านั้นเองหรือบางครั้งเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่าตัวตรวจจับ (sensor) ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ อาทิ เทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) เทอร์มิสเตอร์ (thermister) ตัวตรวจจับอุณหภูมิให้ผลเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้า (RTDs Resistance Temperature Detectors) ตัวตรวจจับการไหล (flow sensor) ตัวตรวจจับความดัน (pressure sensor) สเตรนเกจวัดแรงเค้น (strain guages) โหลดเซลล์น้ำหนัก (load cell) และ LVDT ซึ่งใช้วัดค่าของอัตราการไหล การเปลี่ยนแปลงความดัน แรงกด หรือระยะทางเป็นต้น [3]

#### 2.4.3 ส่วนปรับปรุงสัญญาณ

หน้าที่หลักของส่วนปรับสภาพสัญญาณนี้คือปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากชุดตรวจจับก่อนส่งสัญญาณต่อไปยังฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้อง

ปรับสเกลสัญญาณ ขยายขนาดสัญญาณ แปลงรูปสัญญาณให้เป็นเชิงเส้น (linearization) กรองคลื่นสัญญาณ การแยกกราวด์ของสัญญาณ (common-mode rejection) และทำการกระตุ้นสัญญาณ [3]

หน้าที่หลักของส่วนปรับปรุงสัญญาณคือ ขยายขนาดสัญญาณ (amplifier) เพราะโดยส่วนใหญ่สัญญาณที่ได้จากชุดตรวจจับจะมีขนาดสัญญาณที่ต่ำมากมีอยู่ในระดับมิลลิโวลต์ (millivolt mV) หรือ  $1/1000$  V และมักมีสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟปะปนมาซึ่งอาจรบกวนสัญญาณด้านอินพุตในขณะที่สัญญาณเข้าสู่ระบบทำให้ค่าสัญญาณที่วัดไม่ถูกต้องและไม่เที่ยงตรง

นอกจากนี้วงจรปรับปรุงสัญญาณและยังใช้ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่ได้อยู่ในรูปของแรงดันไฟฟ้าเช่น กระแสไฟฟ้าหรือความต้านไฟฟ้ามายู่ในรูปของแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิทัลที่อยู่ในฮาร์ดแวร์พิเศษสำหรับวัดคูลม เช่น แปลงค่ากระแสไฟฟ้า 4-20 mA จากตัวตรวจจับที่ให้ผลแบบกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟตรง 0-5V หรือปรับแรงดันไฟตรงจากตัวตรวจจับที่ให้ผลเป็นแรงดัน -10V ถึง +10V เป็น 0-5 V เป็นต้น

#### 2.4.4 ส่วนฮาร์ดแวร์พิเศษเพื่อวัดคูลมและเชื่อมกับคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ที่ใช้วัดและเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีอยู่ 2 แบบหลักๆคือ แบบการ์ดเสียบ (plug-in DAQ cards) และแบบเชื่อมต่อภายนอก (external DAQ system) โดยในแบบการ์ดเสียบจะต้องติดตั้งลงบนสล๊อตขยายของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับติดตั้งฮาร์ดแวร์พิเศษเพิ่มเติม ซึ่งการติดต่อของการ์ดเสียบนี้จะกระทำผ่านบัส ISA สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า หรือผ่านบัส PCI สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ส่วนแบบเชื่อมต่อภายนอกจะใช้พอร์ตสื่อสารมาตรฐาน ซึ่งได้แก่พอร์ตอนุกรม RS-232 พอร์ตขนานIEEE1284 (ซึ่งก็คือ พอร์ตขนานสำหรับติดต่อกับเครื่องพิมพ์หรือพอร์ตเครื่องพิมพ์นั่นเอง) พอร์ตขนานIEEE488 หรือบัส GPIB รวมถึงบัสแบบ VXI แทนการเสียบการ์ด มักใช้กับงานสนามที่ต้องพกพาแยกส่วนอุปกรณ์เพื่อความสะดวกและถอดเปลี่ยน [3]

ในส่วนฮาร์ดแวร์พิเศษเพื่อวัดคูลมและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นี้ อาจกำหนดให้ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวหรือมากกว่านั้น เพื่อรับค่าสัญญาณอะนาลอกอินพุต (analog input) ส่งค่าสัญญาณดิจิทัลเอาต์พุต (digital output) และทำการนับจำนวนหรือจับเวลา (counter / timer) แล้วแต่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จะกำหนดให้มีฟังก์ชันใดบ้างและมีความละเอียดหรือตอบสนองได้เร็วเท่าใด

#### 2.4.5 ซอฟต์แวร์ในระบบค้ำค้ำแยกควิซัน

ส่วนประกอบนี้จะขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาระบบเป็นหลัก นั่นคือ ความถนัดในการใช้งานซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม โดยปัจจุบันผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับงานค้ำค้ำแยกควิซันมักมี

การออกแบบรองรับทั้งการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและมีไคร์เวอร์สนับสนุนหรือทูลซอฟต์แวร์อย่าง OCX สำหรับภาษาพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ อาทิ เช่น ภาษา Visual BASIC Visual C หรือ Delphi เพื่อให้สามารถพัฒนาโปรแกรมเองได้อีกด้วยดังนั้นการเลือกซอฟต์แวร์โปรแกรมเพื่อพัฒนางานระบบค่าตัว แยกควิซชั้น นี้ จึงมีหลักพิจารณา 3 ประการ คือ

1. ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไมโครซอฟต์วินโดวส์ 95/98/ME/XP/NT หรือ 2000 หรือ ระบบปฏิบัติการประเภทยูนิกซ์ อาทิ เช่น Linux HP-Uinx และ Solaris เป็นต้น
2. ความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมหรือความชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์
3. ความสามารถเข้ากันได้ระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ [3]



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 3

### การดำเนินการวิจัย

#### 3.1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบโมดูลาร์ (Modular Electronics)

จากการศึกษาสมรรถนะของระบบวัดนิวเคลียร์แบบโมดูลาร์เช่น วงจรภาคขยายสัญญาณพัลส์ วงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว วงจรเรตมิเตอร์ และวงจรอื่นๆ พบว่าสมรรถนะถูกจำกัดโดย

1. การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรูปแบบฟังก์ชันและการจัดระบบวัดนิวเคลียร์มีความยืดหยุ่นต่ำ
2. การขยายระบบและการเชื่อมโยงสัญญาณวัด (Data interface) ไม่สะดวก
3. ใช้พื้นที่มากในการติดตั้งระบบเนื่องจากวงจรและอุปกรณ์ประกอบมีขนาดใหญ่
4. ใช้ต้นทุนสูงมากเนื่องจากความยากในการผลิตและวัสดุอุปกรณ์เป็นชนิดพิเศษราคาแพง และหาแหล่งจัดซื้อยาก

#### 3.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน

จากข้อมูลพื้นฐานข้อ 3.1 สามารถกำหนดปรับสมรรถนะของระบบวัดนิวเคลียร์แบบโมดูลาร์เป็นระบบวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนได้ดังนี้

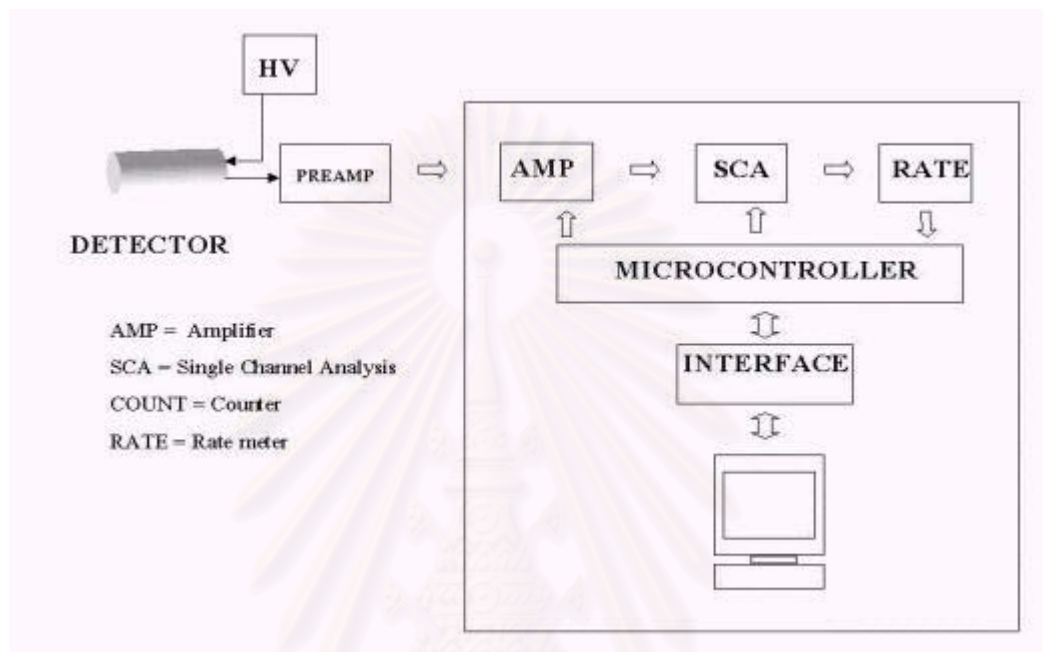
1. เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับวงจรระบบวัดนิวเคลียร์ที่ออกแบบสร้างขึ้น
2. ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงานเพื่อลดความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. ประยุกต์โปรแกรมแบบกราฟฟิก (Graphical programming) เพื่อจำลองและควบคุมเครื่องมือวัดนิวเคลียร์

โครงสร้างของระบบวัดเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆดังนี้

1. อุปกรณ์วัดรังสีส่วนหน้า (Detector) ได้แก่ หัววัดรังสีแกมมา
2. ระบบวัดปริมาณรังสี (Measuring system) ประกอบด้วยวงจรย่อยๆ ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูง วงจรขยายสัญญาณพัลส์ วงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยวและเรตมิเตอร์



3. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวัด (Data interface) ได้แก่วงจรรับส่งข้อมูลจากพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์
4. ระบบประมวลผลข้อมูลวัด (Data processing) ที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 3.1 แผนภาพการทำงานของระบบเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.2 โปรแกรมเครื่องมือนิวเคลียร์แบบเสมือน

จากแผนภาพรูปที่ 3.1 เครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนมีการทำงานของระบบดังนี้

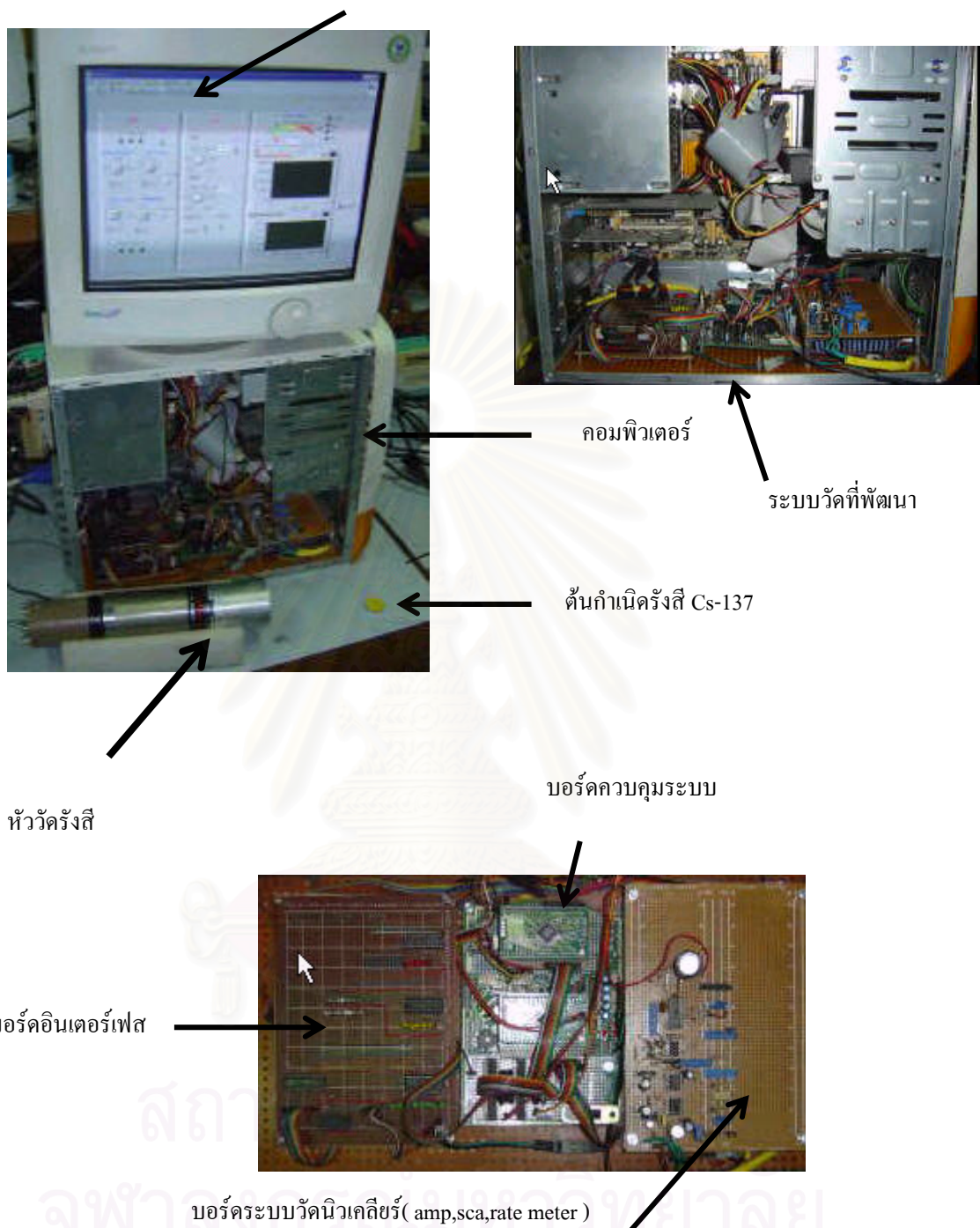
1. อุปกรณ์วัดส่วนหน้าซึ่งประกอบด้วยหัววัดรังสีแบบเรืองรังสี เมื่อหัววัดรังสีได้รับไบอัสจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูงที่เหมาะสมจะเกิดกระบวนการวัดรังสีที่ตกกระทบหัววัดรังสี โดยรังสีจะทำอันตรกิริยากับผลึกเรืองรังสี ( Scintillator ) เกิดประกายแสงที่มีความสว่างเป็นสัดส่วนกับพลังงานของรังสี ปริมาณแสงที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการทวีปริมาณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ ( PMT ) เกิดเป็นสัญญาณพัลส์ที่มีความสูงเป็นสัดส่วนกับระดับพลังงานของรังสีที่ส่งไปวัดปริมาณรังสีในระบบวัดรังสี

2. ระบบวัดปริมาณรังสี [2] จะทำหน้าที่รับสัญญาณพัลส์จากอุปกรณ์วัดส่วนหน้ามาขยายให้ได้สัญญาณที่มีอัตราส่วนของสัญญาณพัลส์สูงกว่าสัญญาณรบกวน (S/N) ด้วยการขยายพร้อมแต่งรูปสัญญาณในวงจรขยายสัญญาณพัลส์ สัญญาณพัลส์ที่มีขนาดความสูงของพัลส์เป็นส่วนสำคัญกับระดับพลังงานจะได้รับการวิเคราะห์พลังงานด้วยวงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์ซึ่งตั้งค่าศักดาไฟฟ้าอ้างอิงของช่องวิเคราะห์พลังงานไว้เฉพาะค่าที่ต้องการสัญญาณลจิกที่ผ่านออกมาจากช่องวิเคราะห์พลังงานจะถูกนับอัตราพัลส์ด้วยวงจรถมมิเตอร์

3. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวัดซึ่งวงจรเชื่อมโยงกับพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์โดยรับข้อมูลจากเรตมิเตอร์นำไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลควบคุมวงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดียวโดยข้อมูลเชิงเลขจะผ่านส่วนพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการประมวลข้อมูลวัด

4. ระบบประมวลข้อมูลวัด ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ในการประสานจังหวะการรับส่งข้อมูลให้สอดคล้องกันของข้อมูลจากพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์ การควบคุมแปลงศักดาไฟฟ้าจากเรตมิเตอร์ให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขของปริมาณรังสี การควบคุมและสร้างแรงดันจาก Digital to analog conversion ( DAC ) ให้แก่วงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดียว และการจัดระบบวัดนิวเคลียร์

ส่วนสวิตช์และหน้าปัดเครื่องมือนิวเคลียร์แบบเสมือน

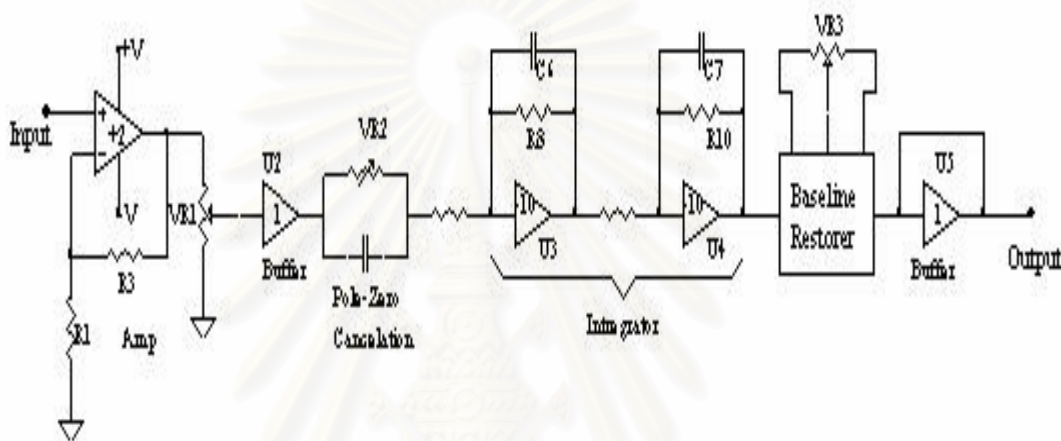


รูปที่ 3.3 แสดงส่วนประกอบของระบบวัดนิวเคลียร์แบบเสมือน

### 3.3 การออกแบบระบบวัด

#### 3.3.1 วงจรขยายสัญญาณพัลส์

วงจรขยายสัญญาณพัลส์ [2] ทำหน้าที่ขยายและปรับแต่งรูปสัญญาณพัลส์จากหัววัดรังสีให้เหมาะสมกับการใช้งานในส่วนวงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดียวมีแผนภาพการทำงานดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 แผนภาพการทำงานของภาคขยาย

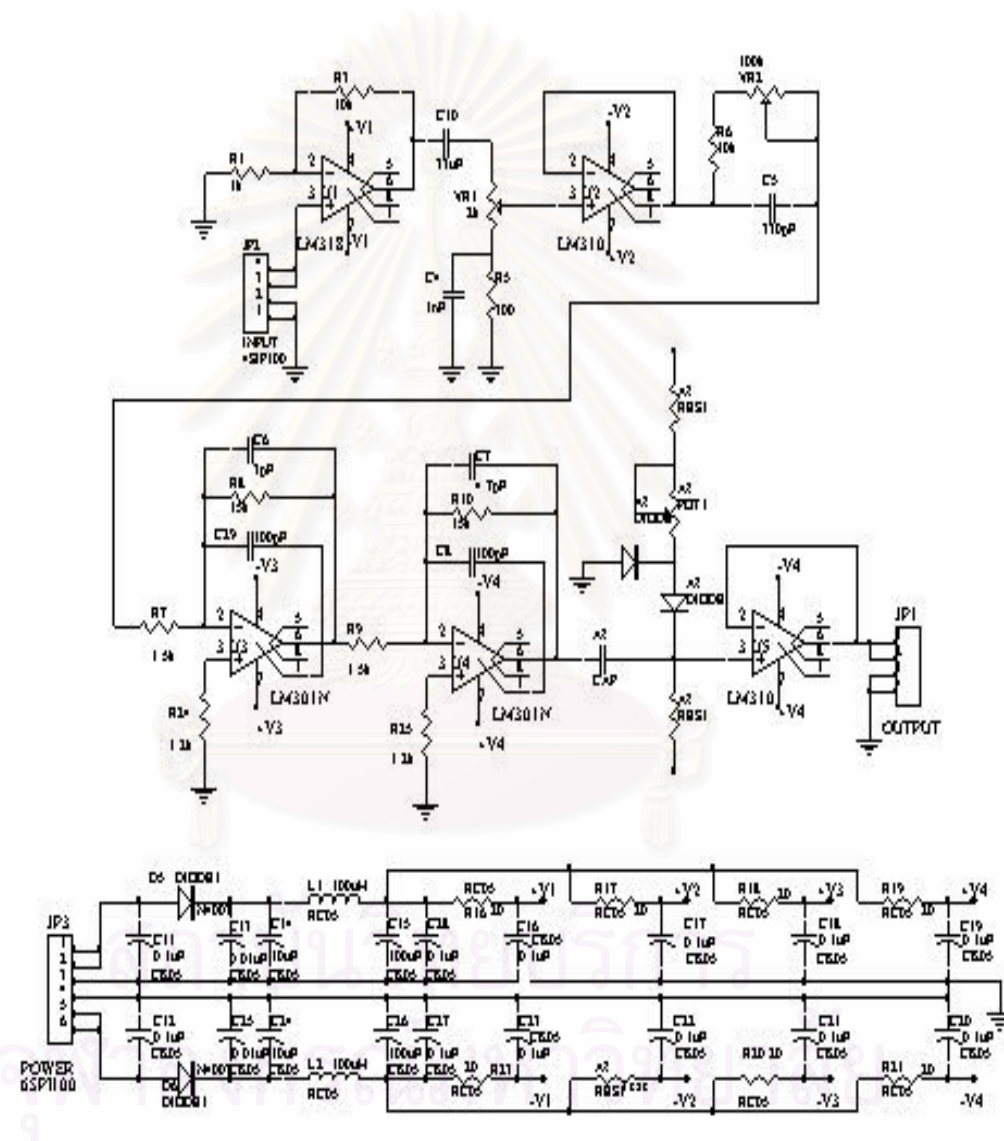
จากแผนภาพในรูปที่ 3.4 และวงจรรูปที่ 3.5 สามารถออกแบบวงจรขยายสัญญาณพัลส์โดย U1 เป็นส่วนวงจรขยายส่วนหน้าจัดการทำงานแบบนอนอินเวอร์ตดึงรับสัญญาณพัลส์บวก โดยมี R3 และ R1 เป็นวงจรป้อนกลับและใช้ค่าคาปาซิเตอร์ C1 คับปลิงสัญญาณจากหัววัดรังสีมายังงานอนอินเวอร์ตดึงสัญญาณของ U1 ทางออกเป็นพัลส์บวกที่มีรูปร่างเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มีค่าคงตัวเวลาการสลายตัวเท่ากับ 10.89 ไมโครวินาที

สัญญาณที่ได้จากวงจรถ่ายส่วนหน้าสามารถลดทอนความสูงของสัญญาณได้ถึง 20:1 โดยการปรับ VR2 U2 ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ระหว่างวงจรถ่ายส่วนหน้ากับวงจรลบสิ่งโพล-ซีโร (pole-zero cancellation) ที่มีค่าคงตัวเวลา 0.473 ไมโครวินาทีเพื่อลดอันเดอร์ชูต (undershoot)

วงจรถ่ายหลักทั้งสองวงจร (U2, U4) จัดเป็นรูปวงจรแบบอินเวอร์ตดิ้งอินทิเกรเตอร์ ซึ่งแต่ละวงจรมีอัตราขยาย 10 เท่า วงจรถ่ายแรก (U3) มีค่าคงตัวเวลา 0.075 ไมโครวินาที ( $5 \text{ pF} \times 15 \text{ k}\Omega$ ) และวงจรถ่ายวงจรที่สอง (U4) มีค่าคงตัวเวลา 0.705 ไมโครวินาที ( $47 \text{ pF} \times 15 \text{ k}\Omega$ ) ทำให้ได้

สัญญาณพัลส์ทางออกของ U4 มีรูปร่างสัญญาณแบบยูนิโพลาร์ มีความกว้างประมาณ 1.0 ไมโครวินาที

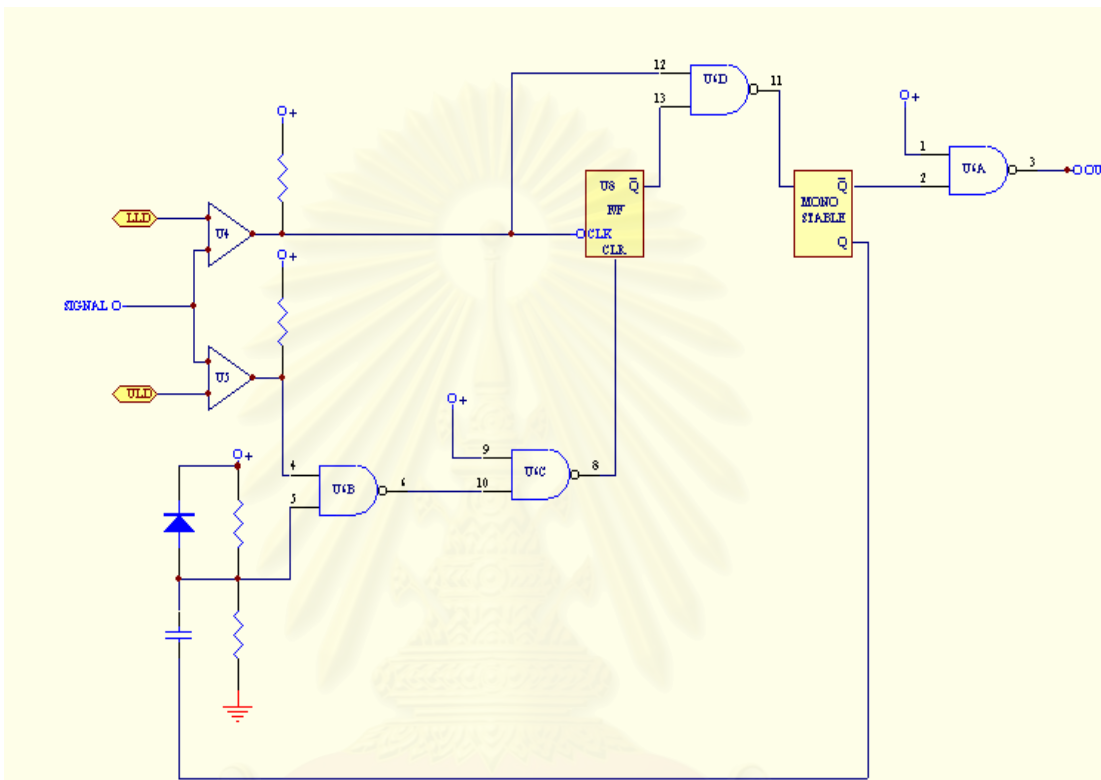
วงจรปรับเบสไลน์กลับสู่ศูนย์ (baseline restorer) เนื่องจากสัญญาณพัลส์ที่ออกจาก U4 อาจมีศักดาไฟฟ้ากระแสตรงร่วมอยู่ด้วย ซึ่งมีผลกระทบมากในการวิเคราะห์ความสูงของพัลส์จึงจำเป็นต้องปรับเบสไลน์ให้กลับสู่ศูนย์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการปรับ VR3 และเพื่อไม่ให้วงจรในส่วนถัดไปมีผลกระทบด้านการไหลคสัญญาณจึงให้ U5 เป็นวงจรมัลติเพล็กซ์เพื่อขับวงจรภายนอก



รูปที่ 3.5 วงจรขยายสัญญาณพัลส์

### 3.3.2 วงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดียว

วงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์ (Pulse height analyzer) [2] ทำหน้าที่วิเคราะห์ความสูงของพัลส์ที่ได้จากวงจรขยายหลักและเปลี่ยนรูปสัญญาณพัลส์นิวเคลียร์เป็นสัญญาณลอจิกพัลส์ที่มีความกว้าง 0.5 ไมโครวินาที เพื่อป้อนให้กับวงจรเรดมิเตอร์ มีแผนภาพการทำงานดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 แสดงแผนภาพการทำงานของวงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์

วงจรที่ออกแบบในรูปที่ 3.6 ประกอบด้วย ไอซี U4 และ U5 เป็นวงจรเปรียบเทียบศักดาไฟฟ้าอ้างอิง (voltage comparator) ทำหน้าที่เปรียบเทียบศักดาไฟฟ้าอ้างอิงกับศักดาไฟฟ้าของสัญญาณพัลส์ที่ต้องการวิเคราะห์โดยช่วงพลังงานที่ต้องการวิเคราะห์ถูกกำหนดด้วยศักดาไฟฟ้าอ้างอิงระดับล่าง (Lower level discriminator) และศักดาไฟฟ้าอ้างอิงระดับบน (upper level discriminator) ซึ่งศักดาไฟฟ้าทั้งสองนี้สามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 10 โวลต์ ผลต่างของศักดาอ้างอิงในการวิเคราะห์พลังงาน เรียกว่า “ $\Delta E$ ” ( $\Delta E = ULD - LLD$ )

การวิเคราะห์ความสูงของพัลส์ในวงจรเปรียบเทียบศักดาไฟฟ้าเริ่มจาก สัญญาณความสูงของพัลส์ที่ต้องการวิเคราะห์ถูกป้อนให้ทางเข้าสัญญาณ (Input signal) ของ U4 และ U5 ซึ่งมี

ศักดาไฟฟ้าอ้างอิง LLD ป้อนที่ U5 และศักดาไฟฟ้าอ้างอิง ULD ป้อนที่ U4 สภาวะที่วิเคราะห์จะเป็นดังนี้

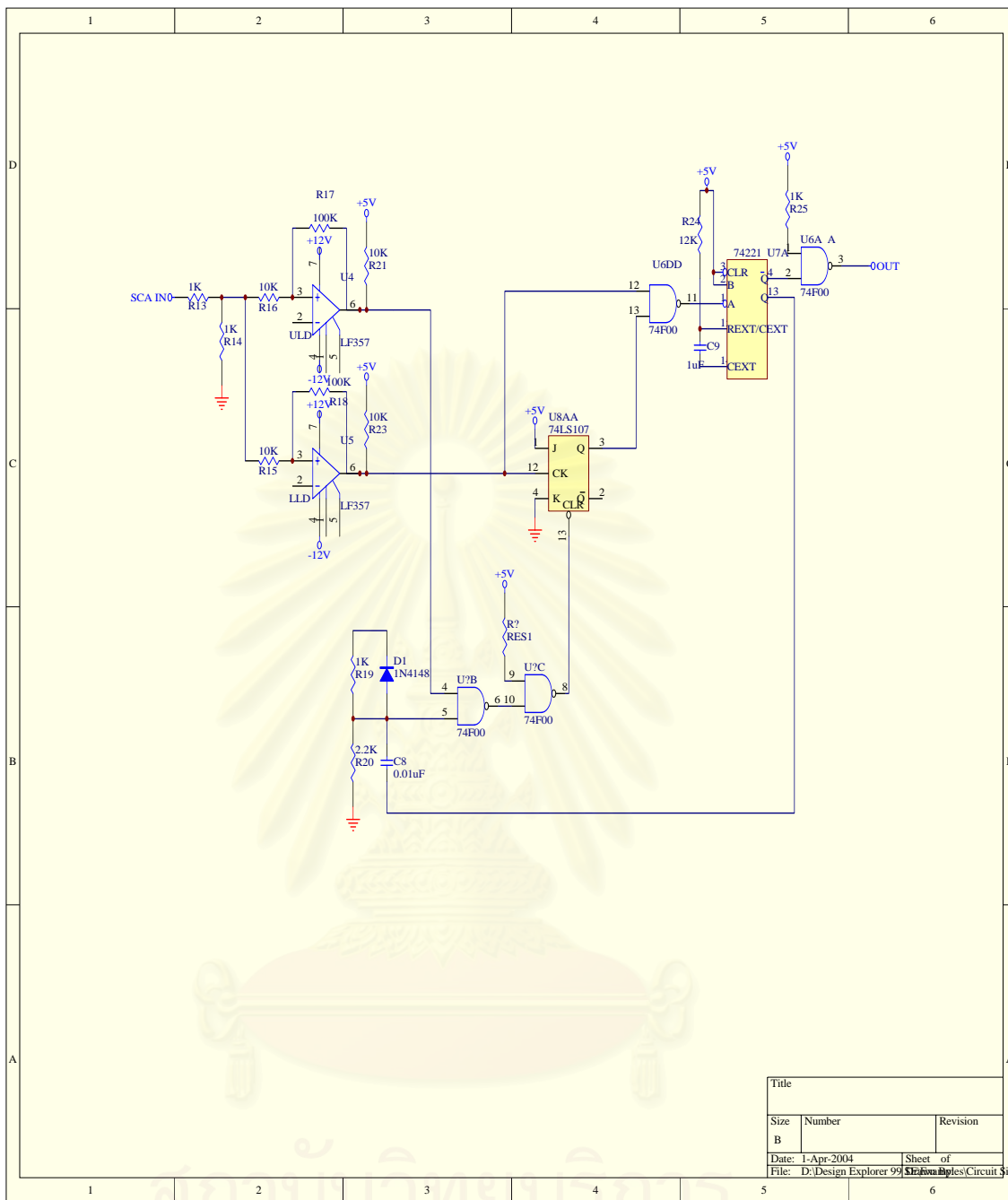
กรณีแรกเมื่อ  $LLD \leq \text{Input signal} < ULD$  ศักดาไฟฟ้าที่ทางออกสัญญาณของ U5 จะเปลี่ยนจากลอจิก “1” เป็น “0” ฟลิปฟลอป U8A จะถูกเซตให้เป็นลอจิก “1” ทำให้สัญญาณทางออกของ U6D เปลี่ยนเป็นลอจิก “0” วงจรโมนอสเตเบิล U7A ถูกกระตุ้นให้ทำงานด้วยขอบขาลงของ U6D ทำให้ได้สัญญาณพัลส์บวกรักษาความกว้าง 0.5 ไมโครวินาทีที่ทางออกสัญญาณของ U6B ในขณะเดียวกัน U7B ทำงานทำให้ไดโอดเปล่งแสงติดสว่างขึ้น หลังจากนั้นโมนอสเตเบิล U7A จะกลับสู่สถานะเดิม ขา Q ของ U7B เปลี่ยนจาก “1” เป็น “0” ทำให้ฟลิปฟลอป U8B ถูกรีเซต

กรณีที่สอง เมื่อ  $LLD < \text{Input signal} > ULD$  ในช่วงเวลาที่  $\text{Input signal} \geq LLD$  ทางออกสัญญาณของ U5 จะเป็นลอจิก “0” ฟลิปฟลอป U8A ถูกเซตให้ Q เป็นลอจิก “1” และช่วงที่  $\text{Input signal} \geq ULD$  ทางออกสัญญาณของ U4 เป็นลอจิก “0” ฟลิปฟลอป U8A ถูกรีเซตให้ Q เป็นลอจิก “0” ก่อนที่สัญญาณทางออกของ U5 จะเปลี่ยนจากลอจิก “0” เป็น “1” ในช่วงเวลาที่  $\text{Input signal} < LLD$  ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทางออกสัญญาณของ U6D จึงไม่มีการกระตุ้นให้โมนอสเตเบิล U7A และ U7B ทำงานดังนั้นที่ทางออกสัญญาณของ U6A จะไม่ปรากฏสัญญาณพัลส์ออกไป

จากการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสองกรณี สรุปได้ว่าการทำงานของวงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์จะให้สัญญาณพัลส์ออกมาเมื่อสัญญาณพัลส์จากวงจรขยายหลักมีความสูงมากกว่าหรือเท่ากับระดับศักดาไฟฟ้าอ้างอิง LLD แต่น้อยกว่าศักดาไฟฟ้าอ้างอิง ULD และในสภาวะนอกเหนือไปจากนี้จะไม่มีการสัญญาณพัลส์ ปรากฏที่ทางออกสัญญาณ (SCA out)

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





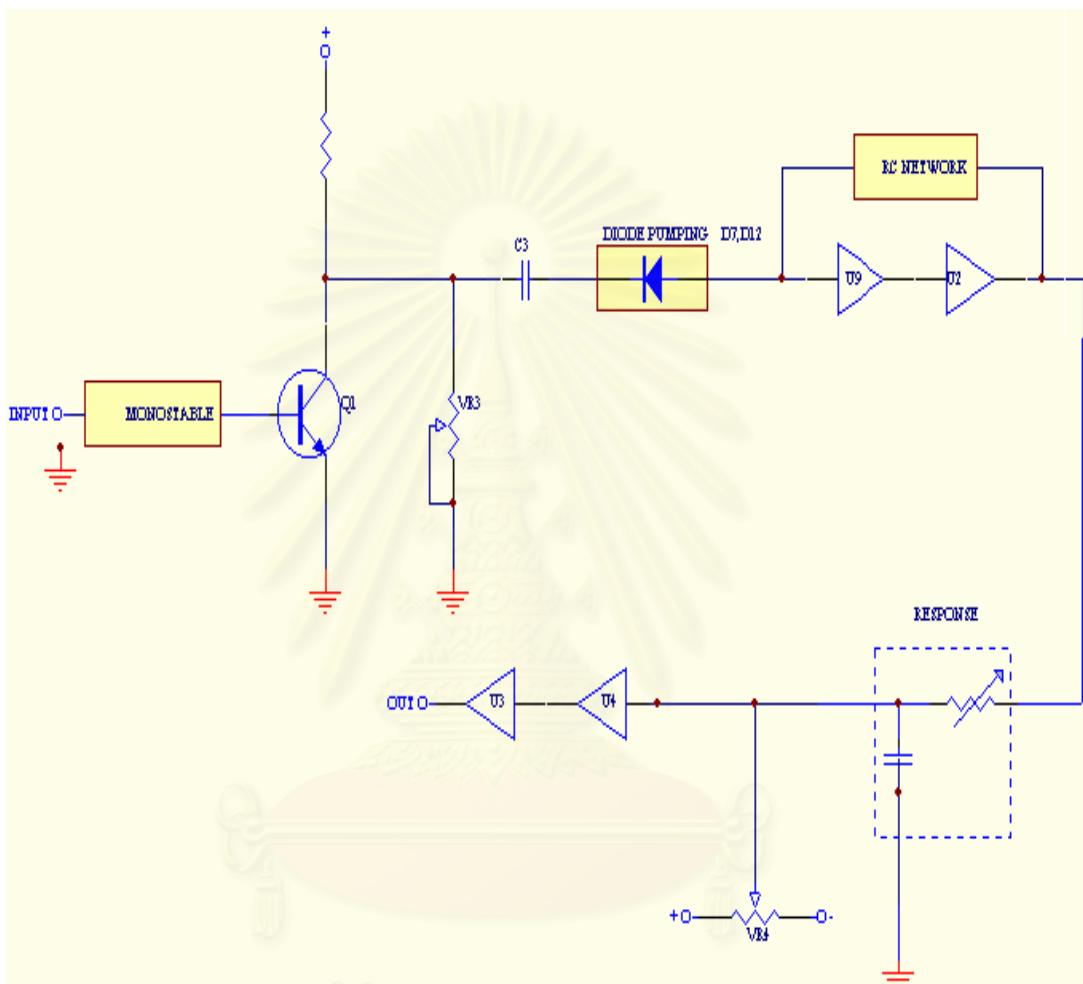
รูปที่ 3.7 วงจรวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดียว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Title		
Size	Number	Revision
B		
Date:	1-Apr-2004	Sheet of
File:	D:\Design Explorer 99\Examples\Circuit Sim	

### 3.3.3 วงจรเรตมิเตอร์

ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณลอจิกพัลส์เป็นค่าศักดาไฟฟ้าเฉลี่ยเพื่อใช้สำหรับอ่านค่าการวัดอัตราเฉลี่ยของพัลส์ต่อเนื่องโดยมีการทำงานดังแผนภาพรูปที่ 3.8 [2]



รูปที่ 3.8 แผนภาพการทำงานของวงจรวจรเรตมิเตอร์

จากแผนภาพรูปที่ 3.8 นำมาออกแบบวงจรของเรตมิเตอร์ได้ดังรูปที่ 3.9 ขบวนการสัญญาณพัลส์ที่ป้อนเข้าที่ทางเข้าสัญญาณของวงจรวจรเรตมิเตอร์ ผ่านวงจรป้องกันทางด้านทางเข้าสัญญาณซึ่งจัดไว้เพื่อป้องกันการกลับขั้วและความสูงของสัญญาณพัลส์ที่เกินกว่ากำหนด อันจะเป็นอันตรายต่อไอซี U1 ประกอบด้วย ไดโอด D1 D6 มี VR1 เป็นตัวช่วยในการตัดสัญญาณรบกวนที่มาพร้อมกับขบวนการสัญญาณพัลส์ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของวงจรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ได้ออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ที่มีค่าความถี่ต่ำและสูงที่ 100 เฮิร์ตซ์ (L) และ 100 กิโลเฮิร์ตซ์ (H) ตามลำดับเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของวงจรเรติเมเตอร์เองโดยความถี่ 100 เฮิร์ตซ์ ใช้สำหรับสเกลที่อัตรานับต่ำและความถี่ 100 กิโลเฮิร์ตซ์ สำหรับสเกลอัตรานับสูง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณพัลส์จากภายนอกมาทำการทดสอบการทำงานของวงจรเรติเมเตอร์

วงจรโมโนสเตเบิล (UTO) ทำหน้าที่รักษาความกว้างของพัลส์ให้คงที่ 4.0 ไมโครวินาที เพื่อป้อนต่อไปที่ Q1 โดยความสูงของพัลส์ถูกกำหนดโดย VR3 ที่จะถูกส่งผ่านไปยัง C3 และ วงจรไดโอดปั๊มปี (Diode pump)

วงจรกำเนิดสัญญาณขั้นบันได (stircase generator) ประกอบด้วยการทำงานร่วมกันของคาปาซิเตอร์ C3 ไดโอด D7, D12 ไอซี U2 U9 และวงจร RC การทำงานเริ่มจากขบวนของสัญญาณพัลส์ (Vi) ที่มีขนาดความกว้างและความสูงคงที่ถูกป้อนไปยังคาปาซิเตอร์ C3 และเข้าสู่วงจรไดโอดปั๊มปี (D7, D12) ที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณพัลส์ไดโอด D12 นำกระแส C3 อัดประจุจนมีศักดาไฟฟ้าเท่าสัญญาณพัลส์ที่ป้อนเข้ามาและที่ขอบขาลงของสัญญาณพัลส์ D12 ได้รับไบอัสกลับ D7 นำกระแส C3 คายประจุไปยังวงจร RC (Q = C3 Vi) เมื่อวงจร RC อัดประจุเรียบร้อยแล้วจะได้ศักดาไฟฟ้าที่ทางออกสัญญาณของ U9 ดังนี้ (ดังรายละเอียดจากวงจรในรูป 3.11)

$$\partial V_o = \frac{Q_f}{C_f} = \frac{Q_i}{C_f} = V_i \frac{C_3}{C_f} \dots\dots\dots(3)$$

Rf Cf คือค่าคงที่เวลาในวงจร RC [3]

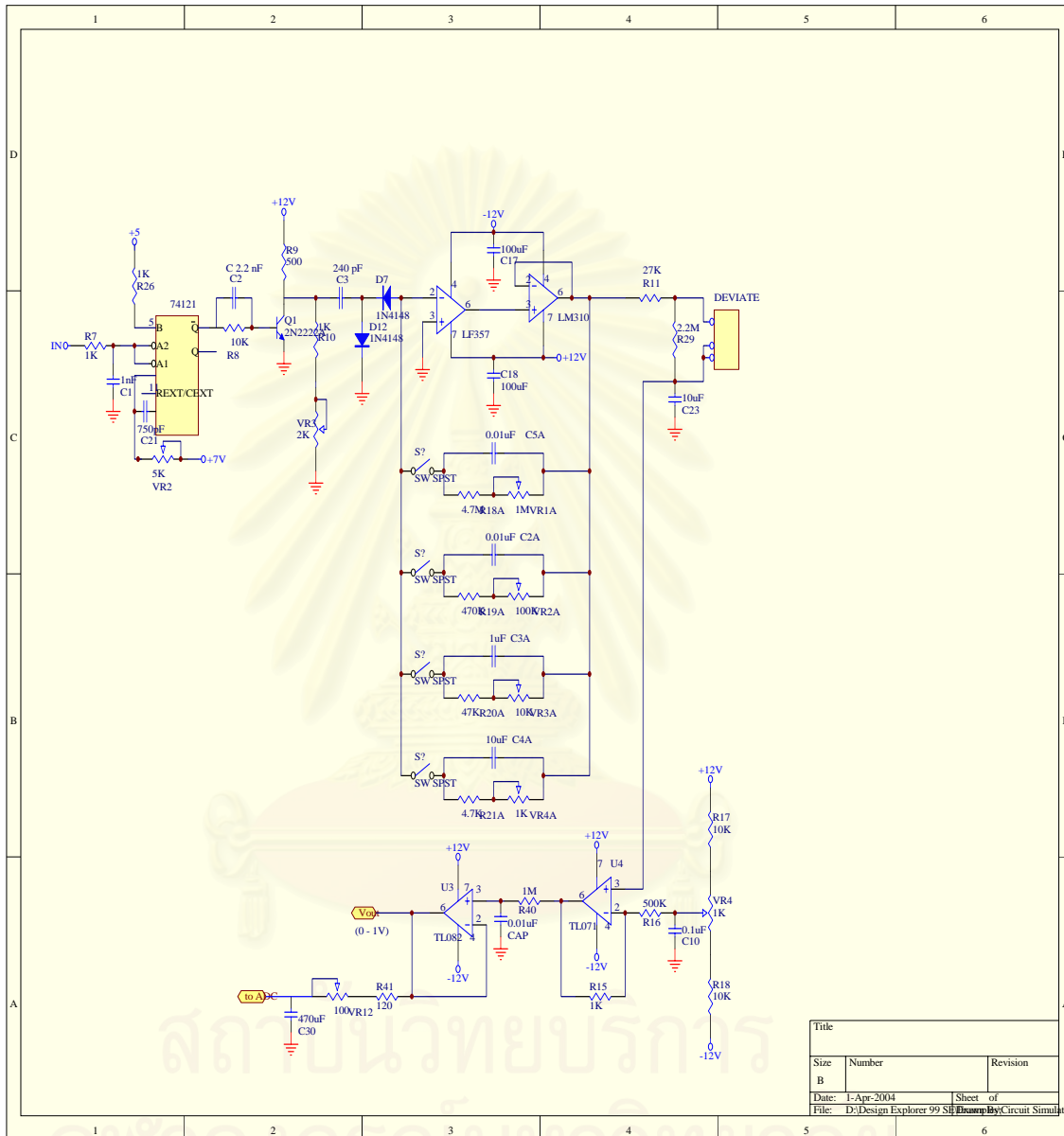
ในการทำงานของวงจร Rc Rf และ Cf ต่อขนานกันทำให้ประจุบน Cf ถูกคายประจุตลอดเวลาด้วย Rf ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่าน Rf จะมีค่าเท่ากับประจุทางอินพุทหารด้วยเวลา (Q/f) ค่าของ Vo จะคำนวณได้ดังนี้

$$V_0 = i_r R_f = V_i C_i F_{in} R_f \dots\dots\dots(4)$$

Fin คือ ความถี่ของขบวนพัลส์ที่ป้อนให้กับ C3

ถ้าค่าของ Vi มีขนาดความกว้างและความสูงของสัญญาณคงที่ V0 จะแปรผันตามความถี่ Fin จากวงจรกำเนิดสัญญาณขั้นบันไดสัญญาณเอาพุทที่ได้ถูกส่งต่อไปยังวงจรเลือกค่าคงที่เวลา

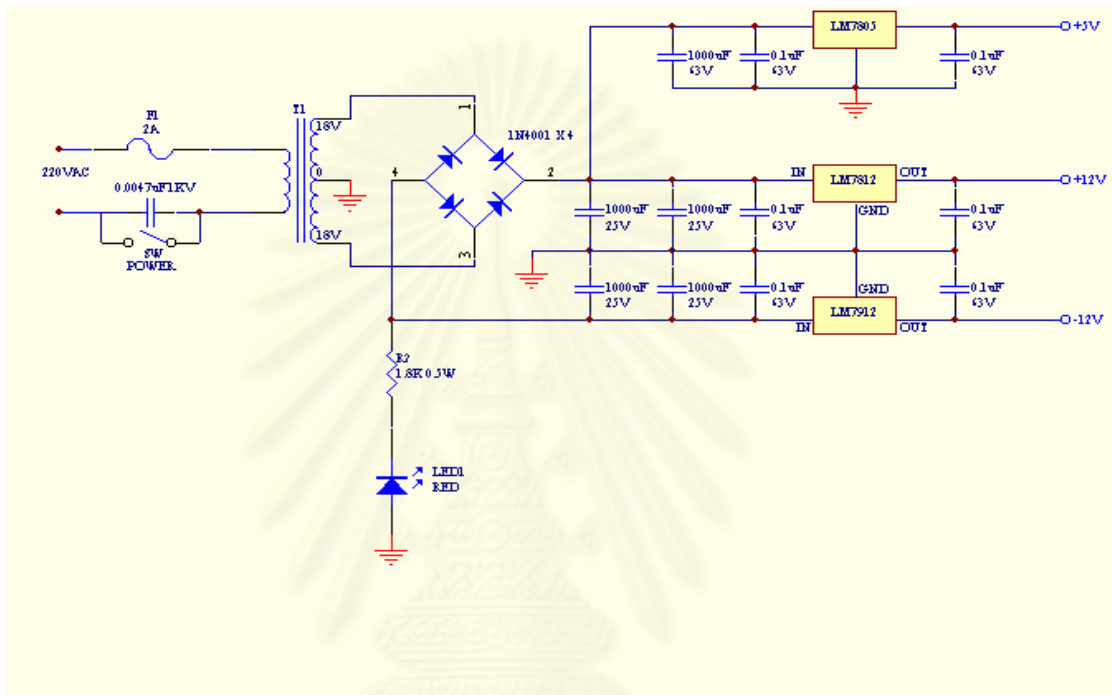
เพื่อปรับเวลาการตอบสนองการเฉลี่ยค่า  $V_o$  ซึ่งในส่วนนี้สามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 0.05 ถึง 3 วินาที



รูปที่ 3.9 วงจรเรตมิเตอร์

### 3.3.4 แหล่งจ่ายไฟฟ้าสัปดาห์

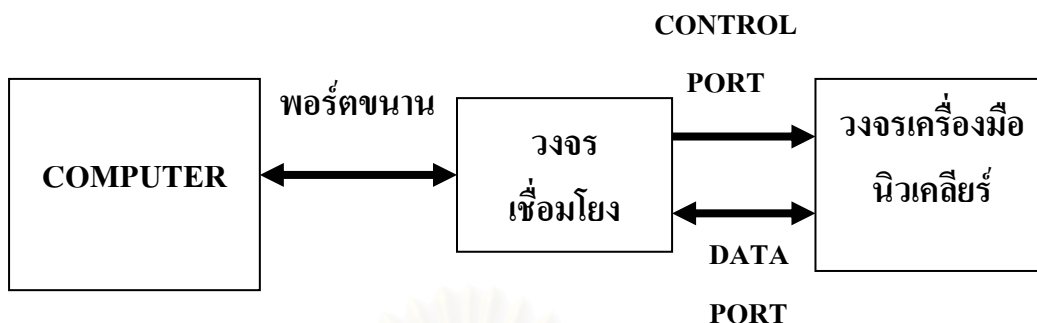
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าสัปดาห์ในรูปที่ 3.10 ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 4 ชุด ดังนี้ สัปดาห์ไฟฟ้า  $\pm 12$  โวลต์ กระแส 1.0 แอมแปร์ สำหรับจ่ายให้วงจรถ่ายสัญญาณพัลส์และวงจรที่ใช้ไอซีประเภทลีนีเยร์ สัปดาห์ไฟฟ้า 5 โวลต์ กระแส 1.0 แอมแปร์ สำหรับจ่ายให้วงอินเทอร์เฟสวงจรมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรที่ใช้ไอซีประเภท TTL



รูปที่ 3.10 แหล่งจ่ายไฟฟ้าสัปดาห์

### 3.4 การออกแบบระบบเชื่อมโยงสัญญาณ

ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวัดรังสีทำหน้าที่ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างวงจรเครื่องมือวัดนิวเคลียร์กับคอมพิวเตอร์โดยการออกแบบใช้พอร์ตขนานในการเชื่อมโยงสัญญาณ โดยมีแผนภาพดังรูปที่ 3.11 และ รูปที่ 3.12

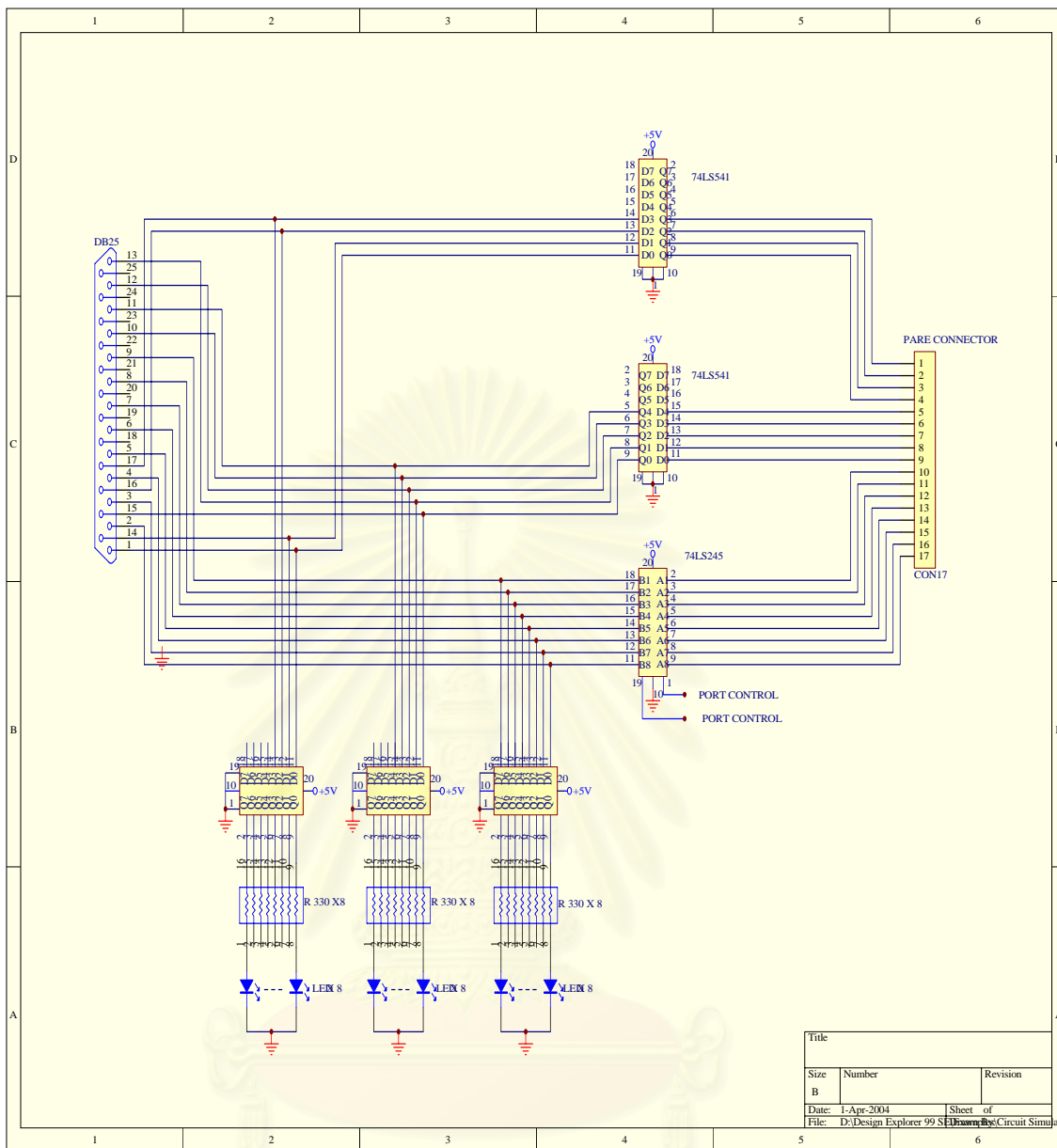


รูปที่ 3.11 แผนภาพแสดงระบบการเชื่อมโยงสัญญาณ

เนื่องด้วยส่วนของพอร์ตคาต้าจะถูกปรับเป็นสองทิศทาง ( Bidirection ) เพื่อรับข้อมูลจากเรดมิเตอร์และส่งข้อมูลไปสร้างแรงดันสำหรับวงจรวิเคราะห์ความสูงของสัญญาณพัลส์

การกำหนดตำแหน่งของบิต C5 ของพอร์ตควบคุม ( 37AH ) ให้เป็นศูนย์สำหรับการรับข้อมูลเข้าพอร์ต และ C5 เป็น 1 สำหรับการส่งข้อมูลออกจากพอร์ตคาต้าโดยมีวงจรบัฟเฟอร์สองทิศทางเป็นส่วนการป้องกันวงจรพอร์ตของคอมพิวเตอร์เสียหายเนื่องจากข้อสัญญาณในบัสชนกัน ซึ่งวงจรเชื่อมโยงสัญญาณได้ออกแบบไว้ดังรูปที่ 3.12

ในส่วนพอร์ตควบคุมก็จะมีวงจรบัฟเฟอร์เช่นกัน โดยเป็นการส่งสัญญาณทิศทางเดียวเพื่อไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ



รูปที่ 3.12 วงจรเชื่อมโยงสัญญาณจากพอร์ตขนานของไมโครคอมพิวเตอร์

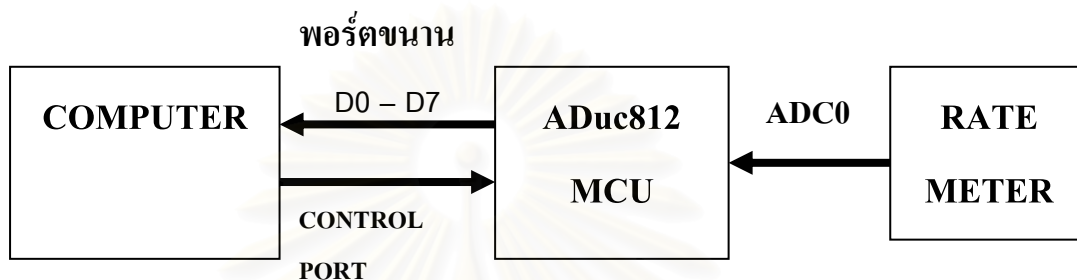
### 3.5 การออกแบบระบบประมวลผล

ระบบประมวลผลของเครื่องวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนชุดนี้เลือกวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AduC812 ซึ่งมีค่าสังขนิคเดียวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8051 แต่มีส่วนเพิ่มขึ้นมาคือมี ADC 12 บิต 8 ช่องและมี DAC 12 บิตจำนวน 2 ช่องรวมอยู่ในไอซีของ AduC812 ทำให้ลด วงจรลงได้มากดังรายละเอียดของโครงสร้างและการทำงานในภาคผนวก และมีพอร์ตอนุกรมประสงค์สำหรับการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับไมโครคอมพิวเตอร์ได้โดย

ผ่านทางพอร์ตมาตรฐาน RS-232C ซึ่งสามารถโปรแกรมแบบ In Circuit ลง ROM ภายในไอซี โดยสะดวก

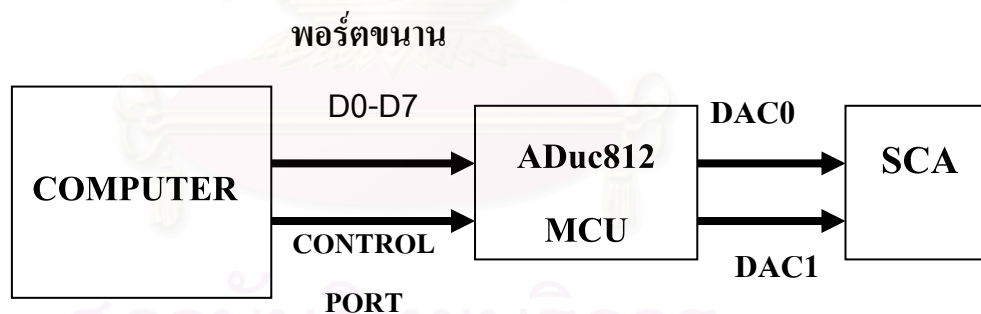
การติดต่อสัญญาณระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบภายนอก

### 3.5.1 การรับสัญญาณจากวงจรถ่ายสัญญาณ



รูปที่ 3.13 แผนภาพแสดงการรับสัญญาณจากวงจรถ่ายสัญญาณ

### 3.5.2 การส่งสัญญาณควบคุมวงจรถ่ายสัญญาณความถี่ของพัลส์แบบช่องเดี่ยว



รูปที่ 3.14 แผนภาพแสดงการส่งสัญญาณควบคุมวงจรถ่ายสัญญาณความถี่ของพัลส์แบบช่องเดี่ยว



### 3.6 การออกแบบโปรแกรมเครื่องมือเสมือน

โปรแกรมที่ออกแบบนั้นมี 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแรกจะเป็นโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้งาน ( User interface ) ซึ่งมีหน้าที่แสดงผลแบบเครื่องมือเสมือนเช่น หน้าปัทม์(Panel) สวิตช์ ปุ่มเลือก มิเตอร์ ส่วนแสดงผลกราฟ และ ส่วนอื่นๆที่มีหน้าที่ควบคุมและรับส่งข้อมูลผ่านออกพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

1. โปรแกรมเรตมิเตอร์แบบเสมือน ( Virtual Ratemeter )
2. โปรแกรมเครื่องวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดี่ยว ( Virtual Single Channel Analyser)
3. โปรแกรมภาคขยายสัญญาณพัลส์

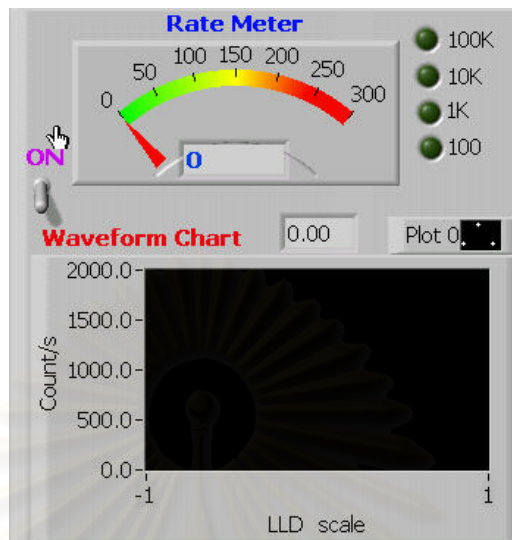
กลุ่มที่สองจะเป็นส่วนโปรแกรมควบคุมและสนับสนุนการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ภาษาแอสเซมบลีซึ่งมีโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

1. จากโปรแกรมควบคุม ADC เพื่อใช้สำหรับรับข้อมูลจากเรตมิเตอร์
2. โปรแกรมควบคุมการจัดระบบวัดนิวเคลียร์

รายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทั้งสองกลุ่มมี ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3.6.1 โปรแกรมเรตมิเตอร์แบบเสมือน ( Virtual Ratemeter )



รูปที่ 3.15 เรตมิเตอร์เสมือน

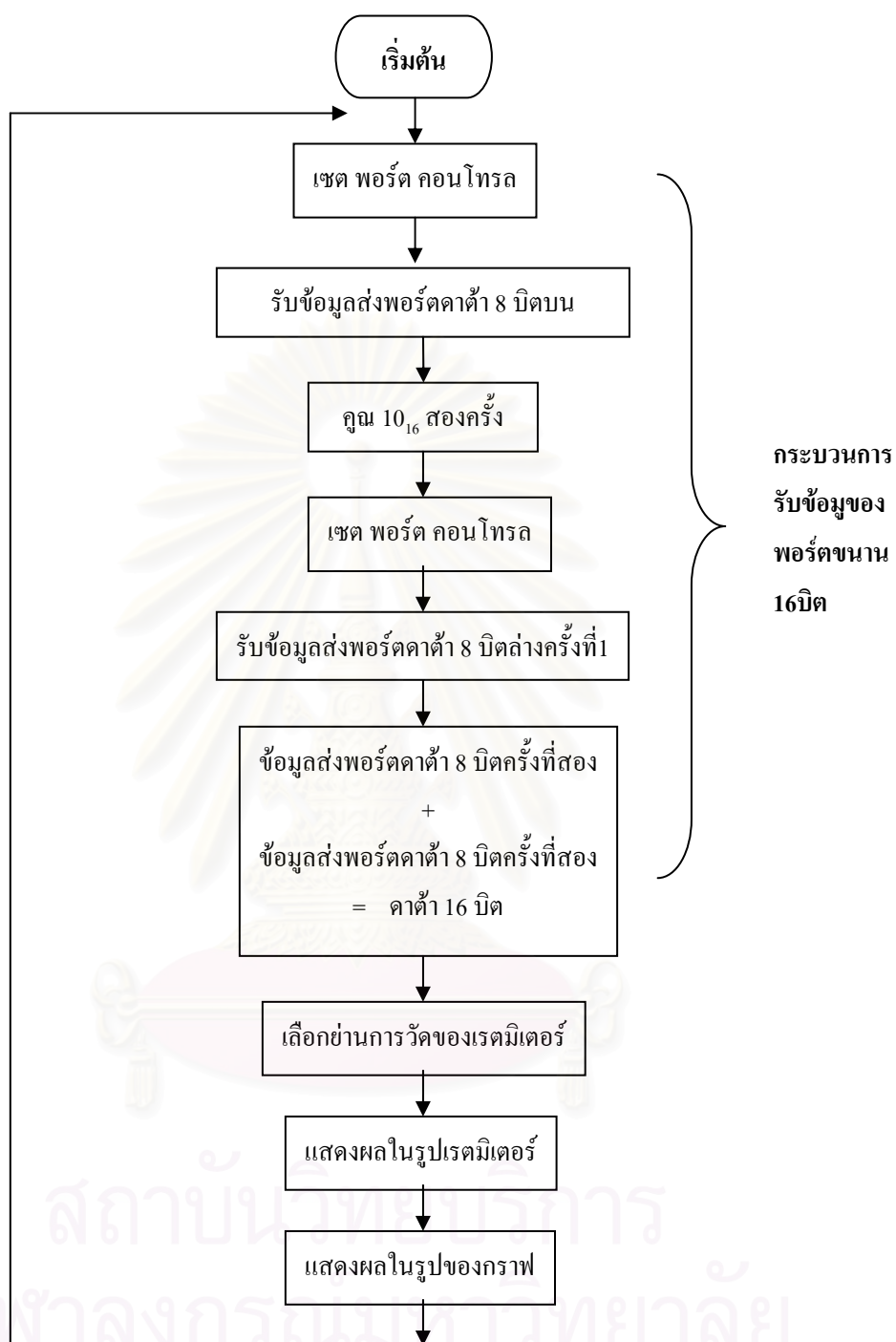
มีการทำงานตามแผนภาพดังรูปที่ 3.16 จากแผนภาพจะเห็นว่าในช่วง 6 ขั้นตอนแรกของแผนภาพนั้นจะเป็นส่วนของการรับข้อมูลจากการแปลงแรงดันของวงจรเรตมิเตอร์ซึ่งรับสัญญาณพัลส์จาก วงจร SCA โดยข้อมูลที่ี้ได้จากการแปลงจะส่งผ่านพอร์ตขนานเข้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะกล่าวถึงแต่ละขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดพอร์ตคอนโทรล (control port = 37AH) ให้มีค่า C5 = 1 โดยกำหนดให้พอร์ตดาต้า ( data port = 378H ) มีทิศทางรับข้อมูลเข้าพอร์ต และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสร้างจังหวะการสอดคล้องกันของการรับข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นข้อมูลจาก ADC ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์
2. รับข้อมูลจาก ADC ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งพอร์ตดาต้า 8 บิตบนของไมโครคอมพิวเตอร์
3. ข้อมูลที่ได้รับมานำมาคูณ ด้วย  $10_{16}$  สองครั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้อมูลเป็นหลักที่สามและหลักที่สี่
4. กำหนดพอร์ตคอนโทรล (control port = 37AH) ให้มีค่า C5 = 1 โดยกำหนดให้พอร์ตดาต้า (data port = 378H ) มีทิศทางรับข้อมูลเข้าพอร์ต และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสร้างจังหวะการสอดคล้องกันของการรับข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นข้อมูลจาก ADC ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์

5. รับข้อมูลส่งพอร์ตคาต้า 8 บิตล่างซึ่งเป็นข้อมูลตำแหน่งหลักแรกและหลักที่สอง
6. นำข้อมูลจากพอร์ตคาต้า 8 บิตบนและ ข้อมูล 8 บิตล่าง นำมารวมกันได้ข้อมูลทั้งหมด 16 บิตมีตำแหน่งที่หลักสิ้นสุดกระบวนการรับข้อมูล 16 บิต 1 รอบ
7. นำข้อมูลที่ได้มาสู่กระบวนการเลือกย่านการวัดของเรตมิเตอร์โดยการเลือกแต่ละย่าน จะปรับข้อมูลการแสดงผลให้เหมาะสมตามแต่ละย่านที่เลือกจากวงจรฮาร์ดแวร์ของเรตมิเตอร์
8. แสดงผลที่ได้ออกสู่หน้าปัทม์เสมือนซึ่งบอกปริมาณของอัตรานับต่อวินาทีเป็นรูปเข็มบนหน้าปัทม์ เสมือนและแบบตัวเลขดิจิทัล
9. แสดงผลที่ได้ออกสู่ส่วนแสดงผลแบบกราฟซึ่งสามารถนำมาประมวลผลวิเคราะห์ที่สเปกตรัมของพลังงานจากรังสี โดยแสดงแผนภาพดังรูปที่ 3.15

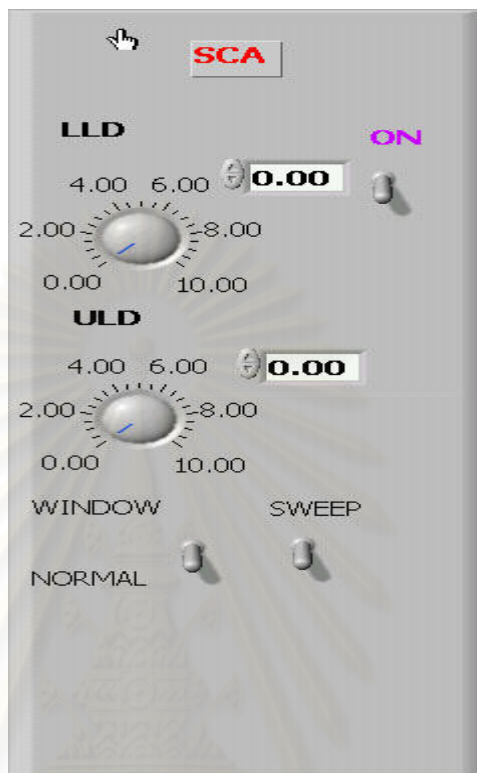


สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.16 แผนภาพแสดงโปรแกรมเรตมิเตอร์แบบเสมือน

### 3.6.2 โปรแกรมเครื่องวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดี่ยว (Virtual Single Channel Analyser)



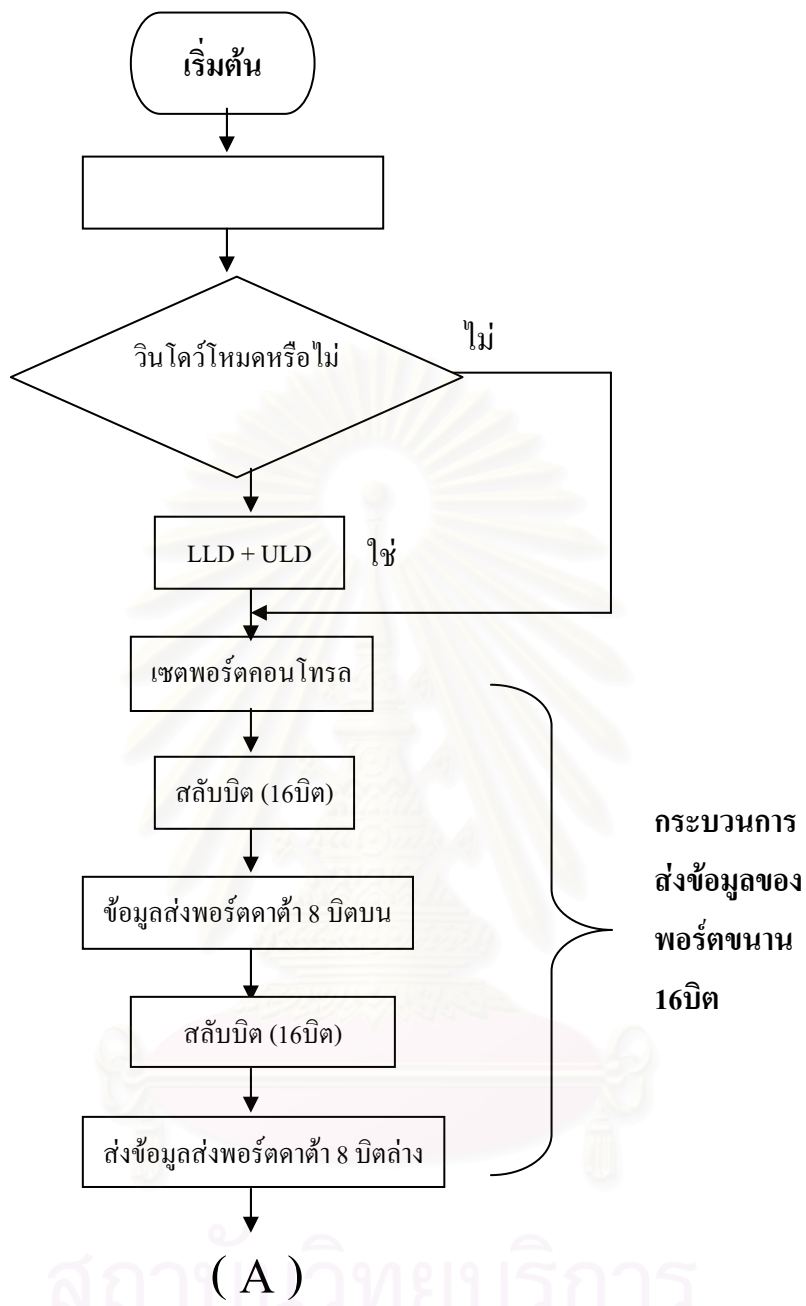
รูปที่ 3.17 เครื่องวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบช่องเดี่ยวแบบเสมือน

จากแผนภาพจะเห็นว่าในช่วงของ 6 ขั้นตอนของแผนภาพนั้นจะเป็นส่วนของการส่งออกของข้อมูลผ่านพอร์ตขนานจากคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดค่าของ Digital to Analog Conversion (DAC) ที่อยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะกล่าวถึงแต่ละขั้นตอนดังนี้

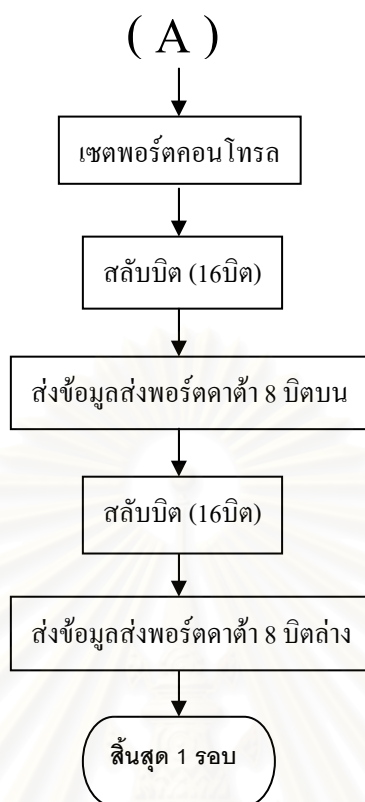
1. กำหนดค่าของ ULD และ LLD
2. เลือกโหมดแบบวินโดว์หรือโหมดปกติ โดยกำหนดจากพอร์ตคอนโทรล
3. ถ้าเลือกเงื่อนไขวินโดว์โหมด ก็จะรวมค่าของแรงดันจาก DAC0 และ DAC1 เข้าด้วยกัน
4. เข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลออก (Data out) 16 บิตจากพอร์ตคาต้าซึ่งกำหนดพอร์ตคอนโทรล (control port = 37AH) ให้มีค่า C5 = 0 โดยกำหนดให้พอร์ตคาต้า (data port = 378H) มีทิศทางส่งข้อมูลออกจากพอร์ต และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสร้างจังหวะการ

สอดคล้องกันของการส่งข้อมูลเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็น DAC 0 ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ (DAC0,DAC1)

5. สลับบิตส่วนละ 8 บิตจาก 16 บิต (Swap bit) เพื่อแยกกลุ่ม 8 บิตบน
6. ข้อมูลส่งพอร์ตคาต้า 8 บิตบนออกพอร์ตขนานเป็นข้อมูลตำแหน่งหลักที่สี่และสาม
7. สลับบิตส่วนละ 8 บิตจาก 16 บิต (Swap bit) เพื่อแยกกลุ่ม 8 บิตล่าง
8. ข้อมูลส่งพอร์ตคาต้า 8 บิตบนออกพอร์ตขนานเป็นข้อมูลตำแหน่งหลักแรกและหลักที่สอง
9. เข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลออก ( Data out ) 16 บิตจากพอร์ตคาต้าซึ่งกำหนดพอร์ตคอนโทรล (control port = 37AH) ให้มีค่า C5 = 0 โดยกำหนดให้พอร์ตคาต้า ( data port = 378H) มีทิศทางส่งข้อมูลออกจากพอร์ต และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสร้างจังหวะการสอดคล้องกันของการส่งข้อมูลเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็น DAC 1 ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ (DAC0,DAC1)
10. สลับบิตส่วนละ 8 บิตจาก 16 บิต (Swap bit) เพื่อแยกกลุ่ม 8 บิตบน
11. ข้อมูลส่งพอร์ตคาต้า 8 บิตบนออกพอร์ตขนานเป็นข้อมูลตำแหน่งหลักที่สี่และสาม
12. สลับบิตส่วนละ 8 บิตจาก 16 บิต (Swap bit) เพื่อแยกกลุ่ม 8 บิตล่าง
13. ข้อมูลส่งพอร์ตคาต้า 8 บิตบนออกพอร์ตขนานเป็นข้อมูลตำแหน่งหลักแรกและหลักที่สอง



รูปที่ 3.18 แผนภาพแสดงโปรแกรมควบคุมวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบเสมือน

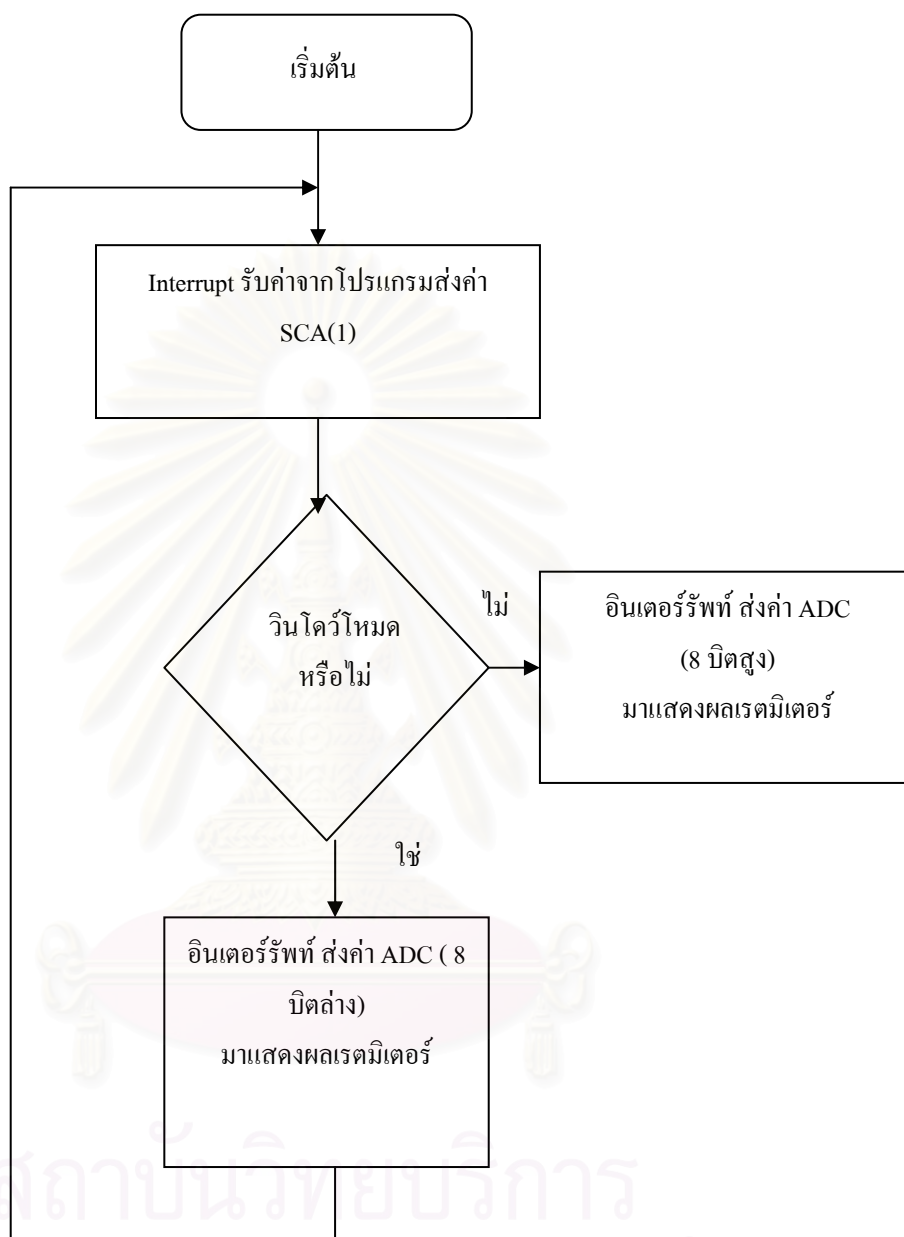


รูปที่ 3.19 แผนภาพแสดงโปรแกรมควบคุมวิเคราะห์ความสูงของพัลส์แบบเสมือน ( ต่อ )

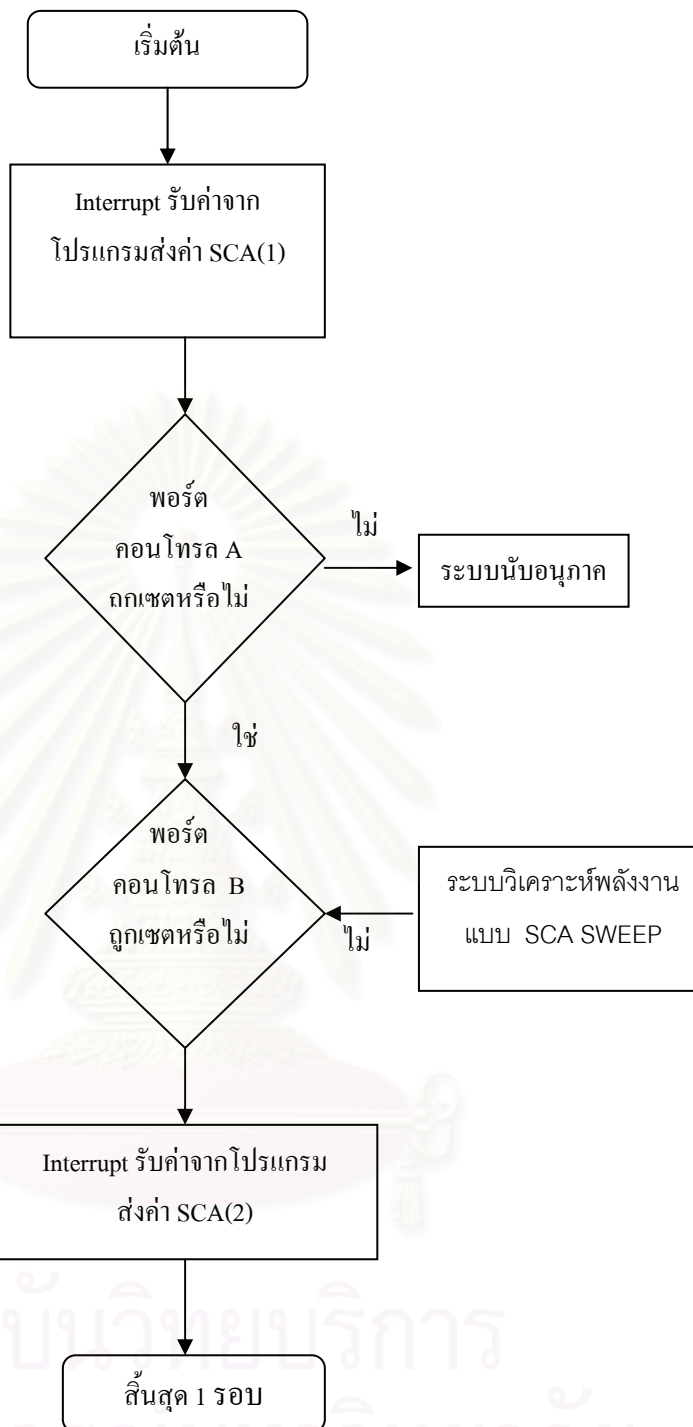
สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### 3.6.3 โปรแกรมควบคุมและสนับสนุนการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 3.20 แผนภาพโปรแกรมควบคุมการรับค่าเรดมิเตอร์



รูปที่ 3.21 แผนภาพโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการจัดระบบวัด

## บทที่ 4

### การทดสอบสมรรถนะและการทำงานของเครื่อง

เครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่รวมกันของวงจรรขยายสัญญาณพัลส์ วงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว และเรตมิเตอร์มารวมเป็นระบบวิเคราะห์พลังงาน โดยการควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเมื่อประกอบเครื่องวัดสมบูรณ์แล้วได้ทำการทดสอบระบบต่างๆ ดังนี้

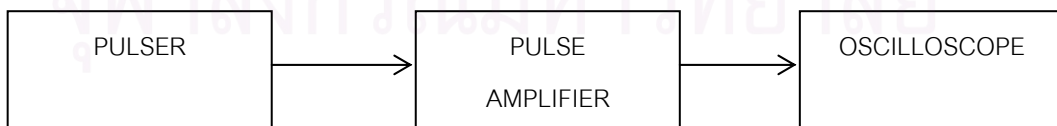
1. ทดสอบวงจรรขยาย
2. ทดสอบวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว
3. ทดสอบวงจรรเรตมิเตอร์
4. ทดสอบการแปลงข้อมูลของวงจรแปลงสัญญาณเชิงเลข
5. ทดสอบระบบวิเคราะห์พลังงาน

#### 4.1 การทดสอบวงจรรขยาย

##### 4.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องกำเนิดสัญญาณเลียนแบบหัววัดรังสี (Pulser) ของ Canberra รุ่น 807
2. เครื่องอ่านสัญญาณไฟฟ้า (Oscilloscope) ของ HAMEG
3. อุปกรณ์ขยายสัญญาณพัลส์ที่พัฒนาขึ้น

##### 4.1.2 ขั้นตอนการทดสอบ

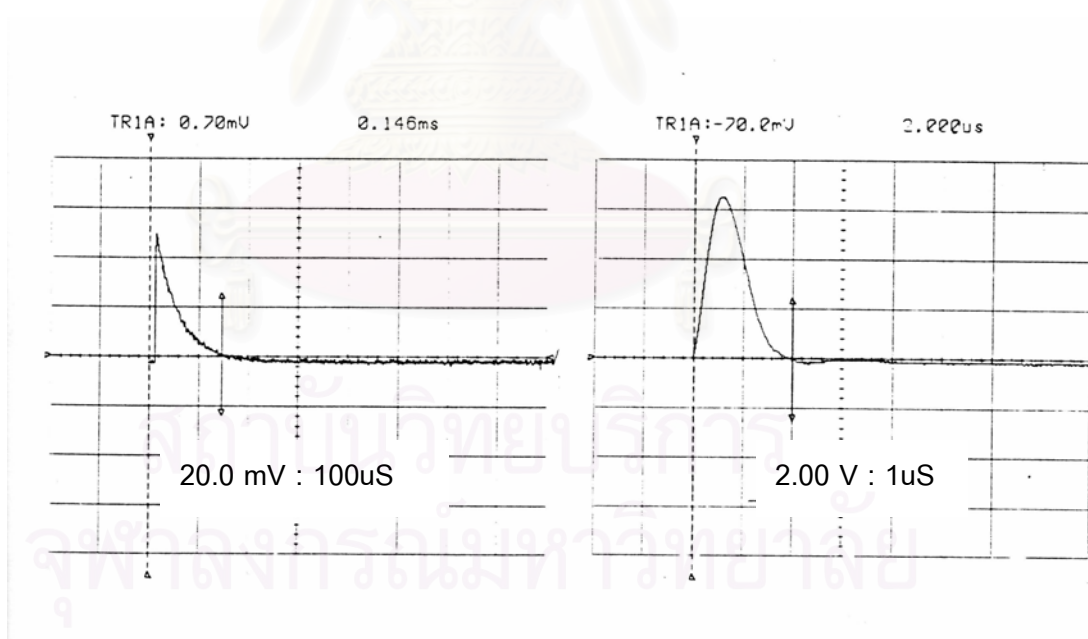


รูปที่ 4.1 แผนภาพการจัดอุปกรณ์ทดสอบวงจรรขยายสัญญาณพัลส์

1. จัดอุปกรณ์ทดสอบดังแผนภาพรูปที่ 4.1
2. ทดสอบการตอบสนองสัญญาณพัลส์ของวงจรถยายโดยป้อนสัญญาณพัลส์ขาขึ้นขนาด 50 มิลลิโวลต์ ดังในรูปที่ 4.2 ก. ให้กับอุปกรณ์ขยายสัญญาณพัลส์อ่านรูปสัญญาณจากอุปกรณ์ขยายสัญญาณพัลส์หลังการปรับ Pole-Zero Cancellation และ Base Line Restorer ที่สมบูรณ์แล้วจะได้สัญญาณดังรูปที่ 4.2 ข.
3. ทดสอบความเป็นเชิงเส้นของอัตราขยายแบบดิฟเฟอเรนเชียล ( differential non- linearity ) โดยตั้งอัตราขยายคงที่และแปรเปลี่ยนขนาดสูงของสัญญาณพัลส์ทางเข้าจากอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเลียนแบบหัววัดรังสี บันทึกผลในตารางที่ 4.1และคำนวณอัตราขยาย

#### 4.1.3 ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบการตอบสนองสัญญาณพัลส์ของวงจรถยายสัญญาณในรูปที่ 4.2 มีความเป็นเชิงเส้นของอัตราขยายแบบดิฟเฟอเรนเชียล 0.9935 ดังเส้นกราฟรูปที่ 4.3



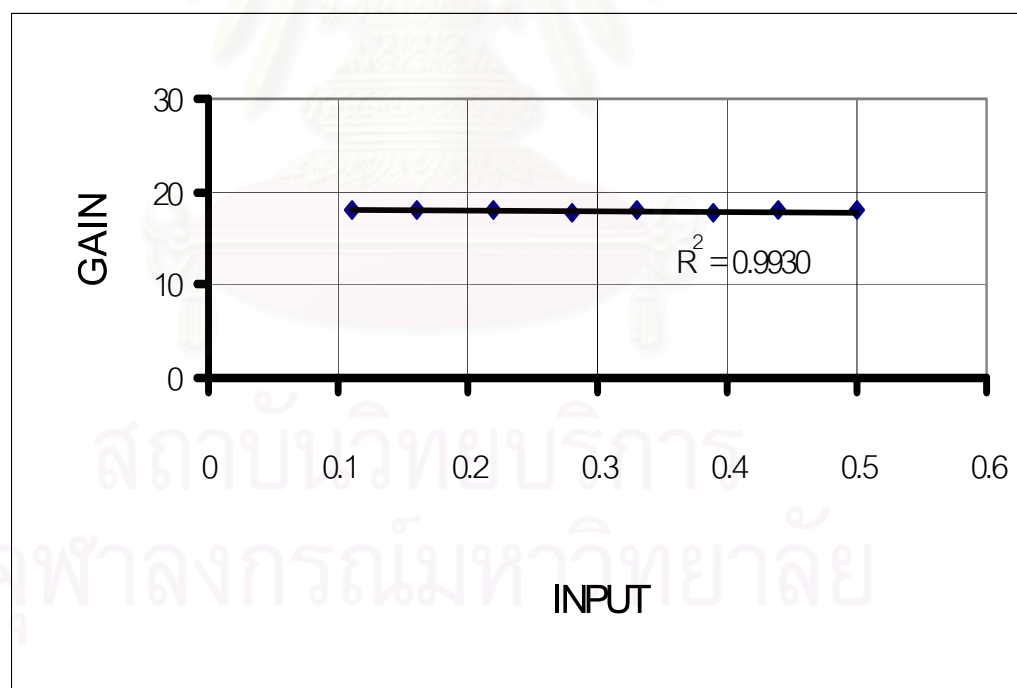
ก. สัญญาณทางเข้า

ข. สัญญาณทางออก

รูปที่ 4.2 แผนภาพสัญญาณพัลส์ทางเข้าและออกจากวงจรถยายสัญญาณพัลส์

ตารางที่ 4.1 ผลทดสอบความเป็นเชิงเส้นของอัตราขยายแบบดิฟเฟอเรนเชียล

สัญญาณพัลส์ ทางเข้า (V)	สัญญาณพัลส์ ทางออก (V)	อัตราขยาย
0.315	2	6.25
0.48	3	6.25
0.63	4	6.34
0.79	5	6.32
0.96	6	6.25
1.12	7	6.25
1.28	8	6.25
1.43	9	6.25



รูปที่ 4.3 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นของอัตราขยายซึ่งทดสอบแบบดิฟเฟอเรนเชียล

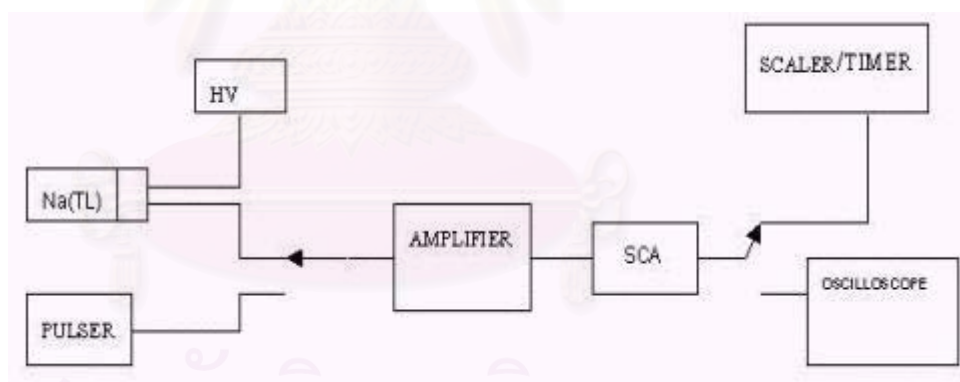
## 4.2 การทดสอบวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว

### 4.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องกำเนิดสัญญาณเลียนแบบหัววัดรังสีของ ORTEC รุ่น 807
2. อุปกรณ์นับรังสีและอุปกรณ์ตั้งเวลา (Scaler/timer) ของ Canberra รุ่น 1772
3. เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า (Oscilloscope) รุ่น HM1507-3
4. ระบบนับรังสีที่พัฒนาขึ้นได้แก่วงจรขยายสัญญาณพัลส์และวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว

### 4.2.2 ขั้นตอนการทดสอบ

การทดสอบวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยวเป็นการทดสอบความเป็นเชิงเส้นของสเกลศักดาไฟฟ้าอ้างอิงของ LLD และ  $\Delta E$



รูปที่ 4.4 แผนภาพการจัดอุปกรณ์ทดสอบวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว

1. จัดอุปกรณ์เพื่อทดสอบการทำงานของ SCA ดังแผนภาพในรูปที่.4.4 (ตำแหน่ง สวิตช์ A)
2. ทดสอบความเป็นเชิงเส้นของสเกลศักดาไฟฟ้าอ้างอิง LLD โดยการแปรเปลี่ยนค่าความสูงของพัลส์และบันทึกสเกลศักดาไฟฟ้าอ้างอิง ณ ตำแหน่งที่เกิด HT (half triggering) ดังตารางที่ 4.2

3. ตั้งศักดาอ้างอิง LLD ที่ 1.0 V และทดสอบความเป็นเชิงเส้นของสเกลศักดาไฟฟ้าอ้างอิง E โดยการแปรเปลี่ยนค่าความสูงของพัลส์และบันทึกสเกลศักดาไฟฟ้าอ้างอิง ณ ตำแหน่งที่เกิด HT ดังตารางที่ 4.3

#### 4.2.3 ผลการทดสอบ

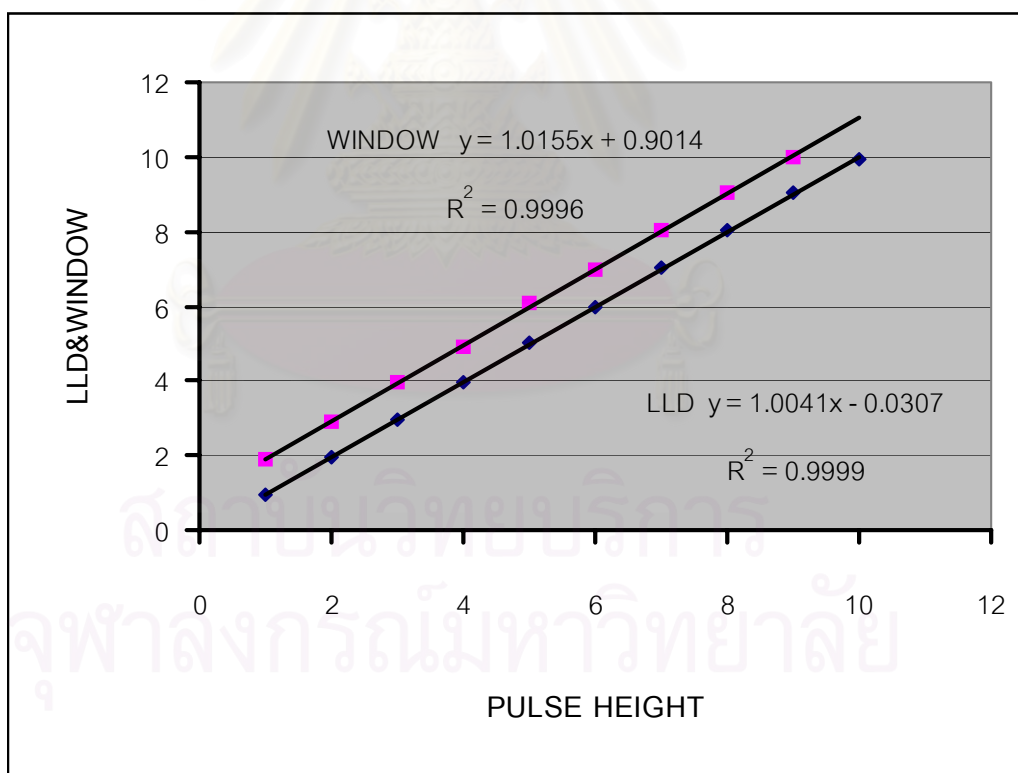
ผลการสอบเป็นเชิงเส้นของสเกลศักดาไฟฟ้าอ้างอิงของ LLD และ  $\Delta$  ให้ผลตามตารางที่ 4.2 และ 4.3

ตารางที่ 4.2 ผลทดสอบความเป็นเชิงเส้นของสเกล LLD

ความสูงของพัลส์	สเกล LLD(V)
1.0	0.96
2.0	1.96
3.0	2.98
4.0	3.99
5.0	5.01
6.0	6.00
7.0	7.01
8.0	8.04
9.0	9.02
10.0	9.95

ตารางที่ 4.3 ผลทดสอบความเป็นเชิงเส้นของสเกล  $\Delta E$

ความสูงของพัลส์	สเกล $\Delta E$ (V)
1.0	1.92
2.0	2.89
3.0	3.99
4.0	4.89
5.0	6.08
6.0	6.98
7.0	8.01
8.0	9.05
9.0	10.00



รูปที่ 4.5 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นของสเกลศักดาไฟฟ้าอ้างอิง LLD และ  $\Delta E$

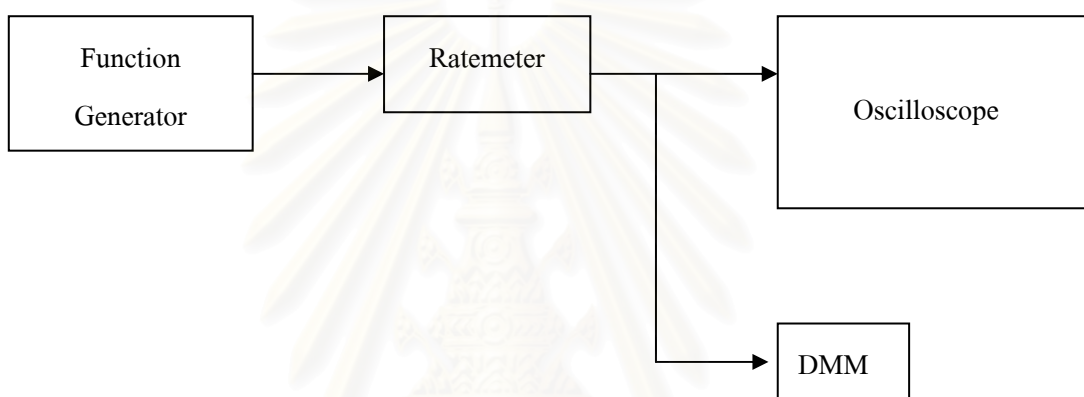


### 4.3 การทดสอบวงจรเรตมิเตอร์

#### 4.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องกำเนิดรูปสัญญาณ (function generator)
2. วงจรเรตมิเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
3. เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า (digital multimeter)

#### 4.3.2 ขั้นตอนการทดสอบ



รูปที่ 4.6 แผนภาพการจัดอุปกรณ์ทดสอบเรตมิเตอร์

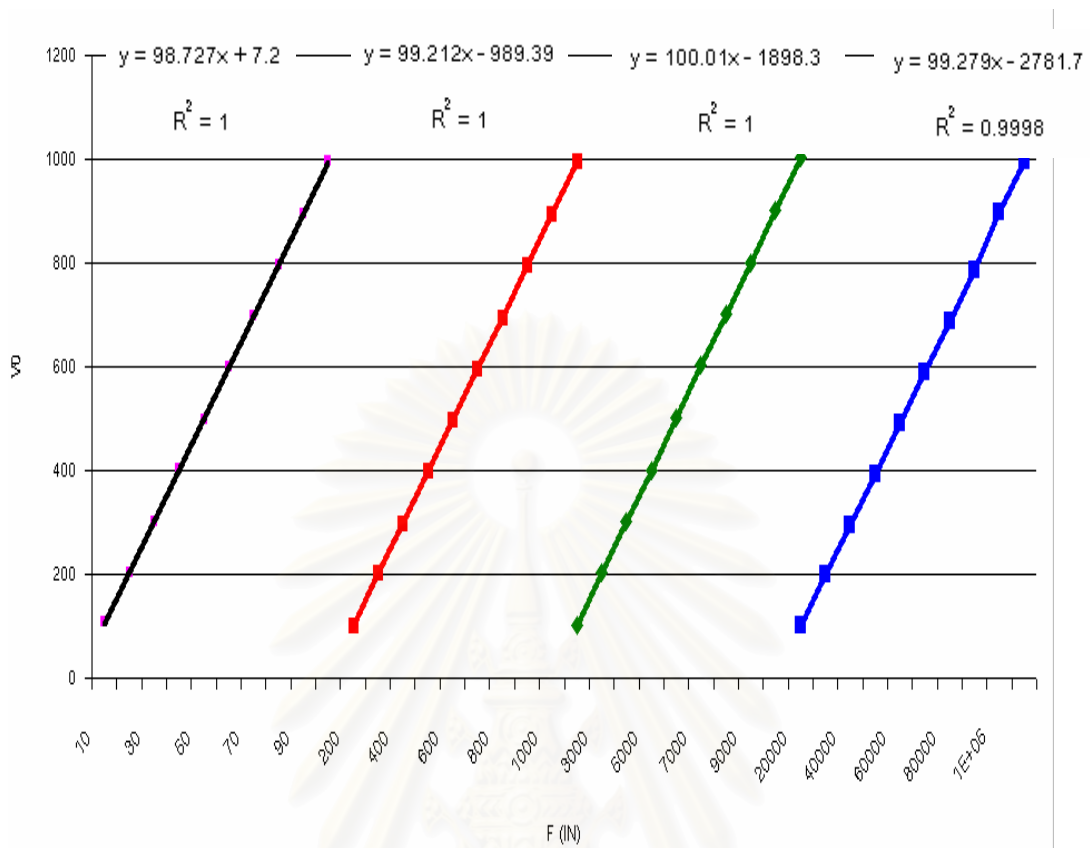
1. จัดอุปกรณ์ทดสอบเรตมิเตอร์
2. เลือกย่านการทำงานของเรตมิเตอร์ที่  $X1 (10^0)$
3. ป้อนสัญญาณพัลส์จาก Function generator ให้กับวงจรเรตมิเตอร์โดยเริ่มปรับความถี่ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เฮิร์ตซ์ โดยการเพิ่มความถี่ครั้งละ 10 เฮิร์ตซ์
4. อ่านและบันทึกค่าที่อ่านได้จาก DMM และสังเกตลักษณะของสัญญาณที่ปรากฏบนเครื่องอ่านรูปสัญญาณ
5. ทำซ้ำจากข้อ 2 ถึงข้อ 4 แต่เปลี่ยนย่านการทำงานเป็น  $X 10 (10^1)$  และปรับความถี่ตั้งแต่ 100 ถึง 1 กิโลเฮิร์ตซ์ โดยเพิ่มความถี่ครั้งละ 100 เฮิร์ตซ์
6. ทำซ้ำในข้อ 5 แต่เลือกย่านการทำงาน  $X 100 (10^2)$  และความถี่ 1 ถึง 10 กิโลเฮิร์ตซ์ เพิ่มความถี่ครั้งละ 1 กิโลเฮิร์ตซ์
7. ทำซ้ำในข้อ 6 แต่เลือกย่านการทำงาน  $X 1000 (10^3)$  และความถี่ 10 ถึง 100 กิโลเฮิร์ตซ์ เพิ่มความถี่ครั้งละ 10 กิโลเฮิร์ตซ์

### 4.3.3 ผลการทดสอบ

ความเป็นเชิงเส้นของสเกลศักดาไฟฟ้าที่ได้จากทางออกของวงจรเรตมิเตอร์กับความถี่ที่ป้อนเข้าทางด้านขาเข้าของวงจรแต่ละย่านการทำงานได้ผลตามตารางที่ 4.4 และเส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นแสดงดังรูปที่ 4.7

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความเป็นเชิงเส้นของเรตมิเตอร์

Range X 1		Range X 10		Range X 100		Range X 1000	
F(IN) Hz	Vo (mV)	F(IN) Hz	Vo (mV)	F(IN) kHz	Vo (mV)	F(IN) kHz	Vo (mV)
10	107	100	103	1	103	10	101
20	205	200	202	2	202	20	199
30	303	300	300	3	302	30	296
40	402	400	399	4	401	40	394
50	500	500	498	5	501	50	492
60	599	600	597	6	602	60	590
70	698	700	696	7	703	70	688
80	796	800	797	8	801	80	787
90	896	900	896	9	902	90	899
100	996	1000	996	10	1003	100	995



รูปที่ 4.7 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นของเรตมิเตอร์

#### 4.4 การทดสอบวงจรแปลงสัญญาณเชิงตัวเลข ( ADC )

##### 4.4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. แหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้เที่ยงตรงสูง
2. ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมเครื่องวัดแบบเสมือนสำหรับถ่ายโอนข้อมูล
3. วงจรแปลงสัญญาณเชิงตัวเลขที่พัฒนาขึ้น(อยู่ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์)



รูปที่ 4.8 แผนภาพการจัตุปกรณ์ทดสอบวงจรแปลงสัญญาณเชิงตัวเลข

#### 4.4.2 ขั้นตอนการทดสอบ

1. จัตุปกรณ์ทดลองดังภาพรูปที่ 4.8
2. โหลด โปรแกรมสำหรับถ่ายโอนข้อมูลให้ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมรับข้อมูลเชิงตัวเลขจากวงจรแปลงสัญญาณเชิงตัวเลข จากนั้นแปรเปลี่ยนศักดาไฟฟ้าทางเข้าและบันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขจากไมโครคอมพิวเตอร์ดังในตารางที่ 4.5

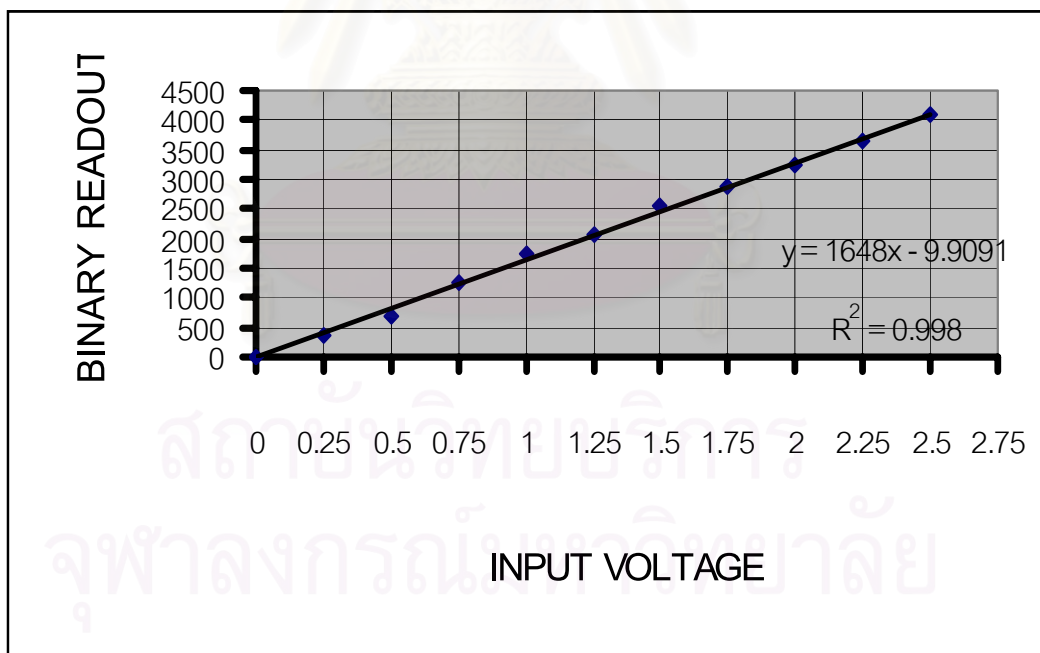
#### 4.4.3 ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบความเป็นเชิงเส้นของวงจรแปลงสัญญาณเชิงตัวเลข เป็นไปตามตารางที่ 4.5 และเส้นกราฟความสัมพันธ์ของศักดาไฟฟ้าทางเข้าและข้อมูลเชิงตัวเลขในรูปที่ 4.9 มีค่าสหสัมพันธ์ความเป็นเชิงเส้นเท่ากับ 0.9980

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.5 ผลทดสอบการแปลงสัญญาณเชิงตัวเลขของวงจร ADC

ศักดาไฟฟ้า (V)	ค่าที่แปลงได้
0	0
0.25	374
0.50	701
0.75	1242
1.00	1723
1.25	2073
1.50	2571
1.75	2881
2.00	3246
2.25	3645
2.50	4095

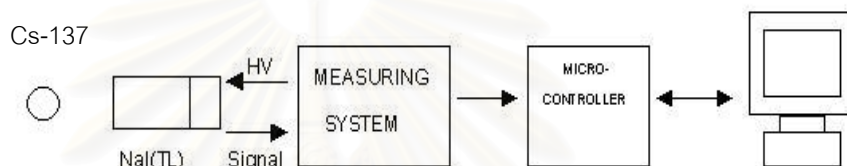


รูปที่ 4.9 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้นของการแปลงสัญญาณเชิงตัวเลขของวงจร ADC

## 4.5 การทดลองระบบวิเคราะห์พลังงานแบบ SCA SWEEP

### 4.5.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ต้นกำเนิดรังสี Cs - 137 ความแรง 10 uCi
2. หัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์(ทึบเลียม)ขนาด 1"x1"
3. ระบบวัดรังสีที่พัฒนาขึ้น
4. ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโปรแกรมมอนิเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
5. โปรแกรมเครื่องวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนที่พัฒนาขึ้น



รูปที่ 4.10 แผนภาพการจัดระบบวิเคราะห์พลังงานแบบ SCA SWEEP

### 4.5.2 ขั้นตอนการทดสอบ

1. จัดอุปกรณ์ทดสอบดังในแผนภาพรูปที่ 4.11
2. ปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูง ณ จุดทำงาน ( 850 โวลต์ ) พร้อมทั้งตั้งช่องวิเคราะห์พลังงานของวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดียวให้วิเคราะห์พลังงานเฉพาะ 662 KeVของธาตุ Cs - 137
3. โปรแกรมเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนโดยเลือกระบบวัดรังสีแบบวิเคราะห์พลังงานแบบ SCA SWEEPผ่านการอ่านข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อวิเคราะห์สเปกตรัมโดยอัตโนมัติ

## 4.5.3 ผลการทดสอบ

ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมของ Cs - 137 แสดงในรูปที่ 4.11 เมื่อใช้ โบอิ์ส 850 โวลต์



รูปที่ 4.11 แผนภาพสเปกตรัมของ Cs - 137

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการพัฒนาเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนบนไมโครคอมพิวเตอร์ได้ข้อมูลสรุป ดังนี้

1. ผลการพัฒนาเครื่องต้นแบบนี้พบว่าเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาเครื่องมือวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนบนไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นต้นกำเนิดรังสีและหัววัดรังสีเท่านั้นที่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยตรง นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้นำเข้าอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทันสมัยและมีคุณภาพสูงทำให้การออกแบบเพื่อประกอบเครื่องมือวัดมีขนาดกระทัดรัดและมีความเชื่อมั่นในการทำงานสูงขึ้น

2. การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของระบบวัดและประมวลผลการวัดปริมาณรังสีจะช่วยลดความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลง รวมทั้งลดการสูญเสียเวลาในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นพิมพ์วงจรและเนื่องจากเทคโนโลยีความก้าวหน้าในการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ก้าวหน้าทำให้มีความสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้นในการพัฒนาโปรแกรมมอนิเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ

3. การพัฒนาการเชื่อมโยงสัญญาณโดยใช้พอร์ตขนานของไมโครคอมพิวเตอร์ในการรับและส่งข้อมูลนั้นพบว่าแม้จะมีความซับซ้อนของการควบคุมในการรับส่งข้อมูลให้ได้ 16 บิตเพราะในการส่งข้อมูลธรรมดาของพริเตอร์จะเป็น 8 บิต แต่ข้อมูลที่ได้อาจจะมีความเร็วกว่าเมื่อใช้พอร์ตอนุกรมซึ่งจำเป็นในการใช้งานกับอุปกรณ์วัดทางนิวเคลียร์ซึ่งมีลักษณะของข้อมูลแบบสุ่ม (RANDOM)

4. การพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัดแบบเสมือนเพื่อควบคุมการทำงานและแสดงผลของข้อมูลต่างๆช่วยให้สามารถเพิ่มสมรรถนะของระบบได้อย่างมากเนื่องจากออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ไม่จำกัดทำให้ระบบสามารถขยายออกไปได้มากตาม



การประยุกต์ของการเขียนโปรแกรมและจะลดการใช้อุปกรณ์ส่วนที่เป็นหน้าปัทม์หรือสวิทช์บางอย่างซึ่งจัดหาค่อนข้างยากและราคาแพง

5. ผลการทดสอบเครื่องวัดรังสีที่พัฒนาขึ้นพบว่า ด้านทางเข้าของสัญญาณของวงจรขยายสัญญาณพัลส์สามารถรับสัญญาณพัลส์ขาลบโดยปรับอัตราขยายสัญญาณจากภาคขยายส่วนหน้าได้ และภาคขยายหลักให้สัญญาณออกในรูปยูนิโพลาร์ที่มีความสูงของพัลส์ 0 ถึง 10 โวลต์ในส่วนของวงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยวทำงานแบบ normal mode และ window mode โดยศักดาไฟฟ้าอ้างอิง LLD ปรับค่าได้จาก 0 ถึง 10 โวลต์และศักดาไฟฟ้าอ้างอิง ( $\Delta E$ ) ปรับค่าได้ 0 ถึง 10 โวลต์หรือ 0 ถึง 1 โวลต์ ส่วนท้ายสุดของระบบวัดรังสีคือ เรทมิเตอร์ สามารถเลือกค่าเต็มสเกลของการวัดอัตรานับรังสีได้จาก 100 cps 1 kcps 10 kcps และ 100 kcps

## 5.2 ปัญหาและอุปสรรค

1. ปัญหาในการออกแบบและประกอบเครื่องต้นแบบที่พบได้แก่ในการออกแบบที่ต้องรวมกรวดของแหล่งจ่ายไฟของระบบวัดที่ออกแบบกับส่วนของไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งมีแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทช์ซึ่งจะเป็นส่วนที่ผลิตสัญญาณรบกวนออกมาด้วยทำให้ประสบปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนทั้งในส่วนของวงจรขยายสัญญาณ วงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยวซึ่งต้องออกแบบส่วนกันสัญญาณรบกวนทำให้ประกอบได้ลำบาก

2. ปัญหาการเชื่อมโยงสัญญาณแบบสองทิศทางของข้อมูลในพอร์ตดาต้าของพอร์ตขนานของไมโครคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่เป็น SPP MODE อย่างเดียวได้ เนื่องจากต้องปรับเป็น EPP MODE ซึ่งจะมีในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นหลังจาก CPU 486 เป็นต้นมา

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

1. เครื่องวัดและส่วนควบคุมควรออกแบบเป็น โมดูลอิสระ เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการซ่อมบำรุง เมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง

2. เครื่องวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนที่พัฒนาขึ้นจะเป็นแนวทางในการปรับสมรรถนะของเครื่องวัดนิวเคลียร์แบบ โมดูลดาร์แบบเก่าซึ่งอาจจะมีปัญหาของอุปกรณ์ส่วนภายนอก เช่น ส่วนสวิทช์ Selector ส่วนแสดงผลตัวปรับต่างๆ และส่วนของวงจรยังใช้งานได้โดยสามารถนำกลับมาทำใช้ใหม่ (Refurbishment) โดยใช้วิธีการเครื่องมือวัดแบบเสมือนเข้าช่วยแก้ปัญหา

3. เนื่องจากการเชื่อมโยงผ่านพอร์ต USB มีความก้าวหน้าไปรวดเร็ว ดังนั้นการควบคุมผ่าน USB โดยการแปลงผ่านส่วนวงจรแปลงพอร์ตขนานเป็นพอร์ตUSBซึ่งมีไอซีแปลงจำหน่ายโดยสามารถจะเพิ่มสมรรถนะการอินเทอร์เน็ตได้โดยเพิ่มส่วนของข้อดีของพอร์ต USB มารวมกับการควบคุมของพอร์ตขนานซึ่งจะเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการเขียน โปรแกรมไค์เวอร์



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

1. สุวิทย์ ปุณณชัยยะ. Nuclear Radiation Detection and Instrumentation. เอกสารการสอนวิชา 2111606นิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
2. เตโช ทองอร่าม .การพัฒนาระบบควบคุมความหนาแบบนิวเคลียร์ไออนิกสำหรับเครื่องรีดโลหะบาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
3. ชีรบุญย์ หล่อวิเชียรรุ่ง. เรียนรู้และปฏิบัติการระบบคาน้ำเอกควิซีชั่น, หน้า 6-30. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อินโนเวตีฟอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด, 2544.
4. P.W Nicholson. Nuclear Electronics.(n.p): John Wiley & sons, 1974
5. Glenn F. Knoll. Radiation Detection and Measurement. 3<sup>rd</sup> ed. (n.p) : John Wiley & sons, 1999
6. Nicholas Tsoulfanidid. Measurement and Detection of Radiation. (n.p) :McGraw Hill, 1983
7. Dhanajay V.Gadre.Programming the parallel port. (n.p) :CMP Books,1998
8. P.A. Egelstaff and E.R. Rae. Proceedings Conference on Automatic Acquisition and Reduction of Nuclear Data. (n.p) :EANDC Karlsruhe,1964
9. A.M Boyaski. Proceedings for the Skytop conference on computer systems in experimental nuclear physics. (n.p) : Boyasi, 1969
10. S. Nuccio and C. Spataro. Approaches to Evaluate the Virtual Instrumentation Measurement Uncertainties.IEEE Instrumentation and Measurement. Vol.12(2001) : 84 – 89



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก.

คุณลักษณะและรายละเอียดของไมโครคอนโทรลเลอร์ AduC812



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ADuC812

SPECIFICATIONS<sup>1, 2</sup>

( $V_{DD} = DV_{DD} = 3.0\text{ V or }5.0\text{ V} \pm 10\%$ ,  $REF_{IN}/REF_{OUT} = 2.5\text{ V}$  Internal Reference,  $MCLKIN = 11.0592\text{ MHz}$ ,  $f_{SAMPLE} = 200\text{ kHz}$ , DAC  $V_{OUT}$  Load to AGND;  $R_L = 2\text{ k}\Omega$ ,  $C_L = 100\text{ pF}$ . All specifications  $T_A = T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$ , unless otherwise noted.)

Parameter	ADuC812BS		Unit	Test Conditions/Comments
	$V_{DD} = 5\text{ V}$	$V_{DD} = 3\text{ V}$		
<b>ADC CHANNEL SPECIFICATIONS</b>				
<b>DC ACCURACY<sup>3, 4</sup></b>				
Resolution	12	12	Bits	
Integral Nonlinearity	$\pm 1/2$	$\pm 1/2$	LSB typ	$f_{SAMPLE} = 100\text{ kHz}$
	$\pm 1.5$	$\pm 1.5$	LSB max	$f_{SAMPLE} = 100\text{ kHz}$
	$\pm 1.5$	$\pm 1.5$	LSB typ	$f_{SAMPLE} = 200\text{ kHz}$
Differential Nonlinearity	$\pm 1$	$\pm 1$	LSB typ	$f_{SAMPLE} = 100\text{ kHz}$ . Guaranteed No Missing Codes at 5 V
<b>CALIBRATED ENDPOINT ERRORS<sup>5, 6</sup></b>				
Offset Error	$\pm 5$	$\pm 5$	LSB max	
	$\pm 1$	$\pm 1$	LSB typ	
Offset Error Match	1	1	LSB typ	
Gain Error	$\pm 6$	$\pm 6$	LSB max	
	$\pm 1$	$\pm 1$	LSB typ	
Gain Error Match	1.5	1.5	LSB typ	
<b>USER SYSTEM CALIBRATION<sup>7</sup></b>				
Offset Calibration Range	$\pm 5$	$\pm 5$	% of $V_{REF}$ typ	
Gain Calibration Range	$\pm 2.5$	$\pm 2.5$	% of $V_{REF}$ typ	
<b>DYNAMIC PERFORMANCE</b>				
Signal-to-Noise Ratio (SNR) <sup>8</sup>	70	70	dB typ	$f_{IN} = 10\text{ kHz}$ Sine Wave $f_{SAMPLE} = 100\text{ kHz}$
Total Harmonic Distortion (THD)	-78	-78	dB typ	
Peak Harmonic or Spurious Noise	-78	-78	dB typ	
<b>ANALOG INPUT</b>				
Input Voltage Ranges	0 to $V_{REF}$	0 to $V_{REF}$	V	
Leakage Current	$\pm 1$	$\pm 1$	$\mu\text{A}$ max	
	$\pm 0.1$	$\pm 0.1$	$\mu\text{A}$ typ	
Input Capacitance <sup>9</sup>	20	20	pF max	
<b>TEMPERATURE SENSOR<sup>10</sup></b>				
Voltage Output at 25°C	600	600	mV typ	Can vary significantly ( $> \pm 20\%$ ) from device to device
Voltage TC	-3.0	-3.0	mV/°C typ	
<b>DAC CHANNEL SPECIFICATIONS</b>				
<b>DC ACCURACY<sup>11</sup></b>				
Resolution	12	12	Bits	
Relative Accuracy	$\pm 3$	$\pm 3$	LSB typ	
Differential Nonlinearity	$\pm 0.5$	$\pm 1$	LSB typ	Guaranteed 12-Bit Monotonic
Offset Error	$\pm 60$	$\pm 60$	mV max	
	$\pm 15$	$\pm 15$	mV typ	
Full-Scale Error	$\pm 30$	$\pm 30$	mV max	
	$\pm 10$	$\pm 10$	mV typ	
Full-Scale Mismatch	$\pm 0.5$	$\pm 0.5$	% typ	% of Full-Scale on DAC1
<b>ANALOG OUTPUTS</b>				
Voltage Range_0	0 to $V_{REF}$	0 to $V_{REF}$	V typ	
Voltage Range_1	0 to $V_{DD}$	0 to $V_{DD}$	V typ	
Resistive Load	10	10	k $\Omega$ typ	
Capacitive Load	100	100	pF typ	
Output Impedance	0.5	0.5	$\Omega$ typ	
$I_{SINK}$	50	50	$\mu\text{A}$ typ	

## ADuC812

SPECIFICATIONS<sup>1, 2</sup> (continued)

Parameter	ADuC812BS		Unit	Test Conditions/Comments
	V <sub>DD</sub> = 5 V	V <sub>DD</sub> = 3 V		
<b>DAC AC CHARACTERISTICS</b>				
Voltage Output Settling Time	15	15	μs typ	Full-Scale Settling Time to within 1/2 LSB of Final Value 1 LSB Change at Major Carry
Digital-to-Analog Glitch Energy	10	10	nV sec typ	
<b>REFERENCE INPUT/OUTPUT</b>				
REF <sub>IN</sub> Input Voltage Range <sup>9</sup>	2.3/V <sub>DD</sub>	2.3/V <sub>DD</sub>	V min/max	Initial Tolerance @ 25°C
Input Impedance	150	150	kΩ typ	
REF <sub>OUT</sub> Output Voltage	2.5 ± 2.5%	2.5 ± 2.5%	V min/max	
	2.5	2.5	V typ	
REF <sub>OUT</sub> Tempco	100	100	ppm/°C typ	
<b>FLASH/EE MEMORY PERFORMANCE CHARACTERISTICS<sup>12, 13</sup></b>				
Endurance	10,000		Cycles min	
	50,000	50,000	Cycles typ	
Data Retention	10		Years min	
<b>WATCHDOG TIMER CHARACTERISTICS</b>				
Oscillator Frequency	64	64	kHz typ	
<b>POWER SUPPLY MONITOR CHARACTERISTICS</b>				
Power Supply Trip Point Accuracy	±2.5	±2.5	% of Selected Nominal Trip Point Voltage max	
	±1.0	±1.0	% of Selected Nominal Trip Point Voltage typ	
<b>DIGITAL INPUTS</b>				
Input High Voltage (V <sub>INH</sub> )	2.4	2.4	V min	V <sub>IN</sub> = 0 V or V <sub>DD</sub>
XTAL1 Input High Voltage (V <sub>INH</sub> ) Only	4		V min	
Input Low Voltage (V <sub>INL</sub> )	0.8	0.8	V max	V <sub>IN</sub> = 0 V or V <sub>DD</sub>
Input Leakage Current (Port 0, EA)	±10	±10	μA max	
	±1	±1	μA typ	
Logic 1 Input Current (All Digital Inputs)	±10	±10	μA max	V <sub>IN</sub> = V <sub>DD</sub>
	±1	±1	μA typ	
Logic 0 Input Current (Port 1, 2, 3)	-80	-40	μA max	V <sub>IL</sub> = 450 mV
	-40	-20	μA typ	
Logic 1-0 Transition Current (Port 1, 2, 3)	-700	-500	μA max	V <sub>IL</sub> = 2 V
	-400	-200	μA typ	
Input Capacitance	10	10	pF typ	V <sub>IL</sub> = 2 V

## ADuC812

Parameter	ADuC812BS		Unit	Test Conditions/Comments
	V <sub>DD</sub> = 5 V	V <sub>DD</sub> = 3 V		
<b>DIGITAL OUTPUTS</b>				
Output High Voltage (V <sub>OH</sub> )	2.4	2.4	V min	V <sub>DD</sub> = 4.5 V to 5.5 V
	4.0	2.6	V typ	I <sub>SOURCE</sub> = 80 μA V <sub>DD</sub> = 2.7 V to 3.3 V I <sub>SOURCE</sub> = 20 μA
Output Low Voltage (V <sub>OL</sub> )				
ALE, PSEN, Ports 0 and 2	0.4	0.4	V max	I <sub>SINK</sub> = 1.6 mA
	0.2	0.2	V typ	I <sub>SINK</sub> = 1.6 mA
Port 3	0.4	0.4	V max	I <sub>SINK</sub> = 8 mA
	0.2	0.2	V typ	I <sub>SINK</sub> = 8 mA
Floating State Leakage Current	±10	±10	μA max	
	±1	±1	μA typ	
Floating State Output Capacitance	10	10	pF typ	
<b>POWER REQUIREMENTS<sup>14, 15, 16</sup></b>				
I <sub>DD</sub> Normal Mode <sup>17</sup>	43	25	mA max	MCLKIN = 16 MHz
	32	16	mA typ	MCLKIN = 16 MHz
	26	12	mA typ	MCLKIN = 12 MHz
	8	3	mA typ	MCLKIN = 1 MHz
I <sub>DD</sub> Idle Mode	25	10	mA max	MCLKIN = 16 MHz
	18	6	mA typ	MCLKIN = 16 MHz
	15	6	mA typ	MCLKIN = 12 MHz
	7	2	mA typ	MCLKIN = 1 MHz
I <sub>DD</sub> Power-Down Mode <sup>18</sup>	30	15	μA max	
	5	5	μA typ	

## NOTES

- <sup>1</sup>Specifications apply after calibration.
- <sup>2</sup>Temperature range -40°C to +85°C.
- <sup>3</sup>Linearity is guaranteed during normal MicroConverter core operation.
- <sup>4</sup>Linearity may degrade when programming or erasing the 640 byte Flash/EE space during ADC conversion times due to on-chip charge pump activity.
- <sup>5</sup>Measured in production at V<sub>DD</sub> = 5 V after Software Calibration Routine at 25°C only.
- <sup>6</sup>User may need to execute Software Calibration Routine to achieve these specifications, which are configuration dependent.
- <sup>7</sup>The offset and gain calibration spans are defined as the voltage range of user system offset and gain errors that the ADuC812 can compensate.
- <sup>8</sup>SNR calculation includes distortion and noise components.
- <sup>9</sup>Specification is not production tested, but is supported by characterization data at initial product release.
- <sup>10</sup>The temperature sensor will give a measure of the die temperature directly; air temperature can be inferred from this result.
- <sup>11</sup>DAC linearity is calculated using:  
Reduced code range of 48 to 4095, 0 to V<sub>REF</sub> range  
Reduced code range of 48 to 3995, 0 to V<sub>DD</sub> range  
DAC output load = 10 kΩ and 50 pF.
- <sup>12</sup>Flash/EE Memory Performance Specifications are qualified as per JEDEC Specification (Data Retention) and JEDEC Draft Specification A117 (Endurance).
- <sup>13</sup>Endurance Cycling is evaluated under the following conditions:  
Mode = Byte Programming, Page Erase Cycling  
Cycle Pattern = 00H to FFH  
Erase Time = 20 ms  
Program Time = 100 μs
- <sup>14</sup>I<sub>DD</sub> at other MCLKIN frequencies is typically given by:  
Normal Mode (V<sub>DD</sub> = 5 V): I<sub>DD</sub> = (1.6 nAs × MCLKIN) + 6 mA  
Normal Mode (V<sub>DD</sub> = 3 V): I<sub>DD</sub> = (0.8 nAs × MCLKIN) + 3 mA  
Idle Mode (V<sub>DD</sub> = 5 V): I<sub>DD</sub> = (0.75 nAs × MCLKIN) + 6 mA  
Idle Mode (V<sub>DD</sub> = 3 V): I<sub>DD</sub> = (0.25 nAs × MCLKIN) + 3 mA  
where MCLKIN is the oscillator frequency in MHz and resultant I<sub>DD</sub> values are in mA.
- <sup>15</sup>I<sub>DD</sub> currents are expressed as a summation of analog and digital power supply currents during normal MicroConverter operation.
- <sup>16</sup>I<sub>DD</sub> is not measured during Flash/EE program or erase cycles; I<sub>DD</sub> will typically increase by 10 mA during these cycles.
- <sup>17</sup>Analog I<sub>DD</sub> = 2 mA (typ) in normal operation (internal V<sub>REF</sub>, ADC, and DAC peripherals powered on).
- <sup>18</sup>EA = Port0 = DV<sub>DD</sub>, XTAL1 (Input) tied to DV<sub>DD</sub>, during this measurement.

Typical specifications are not production tested, but are supported by characterization data at initial product release.

Timing Specifications—See Pages 46–55.

Specifications subject to change without notice.

Please refer to User Guide, Quick Reference Guide, Application Notes, and Silicon Errata Sheet at [www.analog.com/microconverter](http://www.analog.com/microconverter) for additional information.



# ADuC812

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS\*

( $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted.)

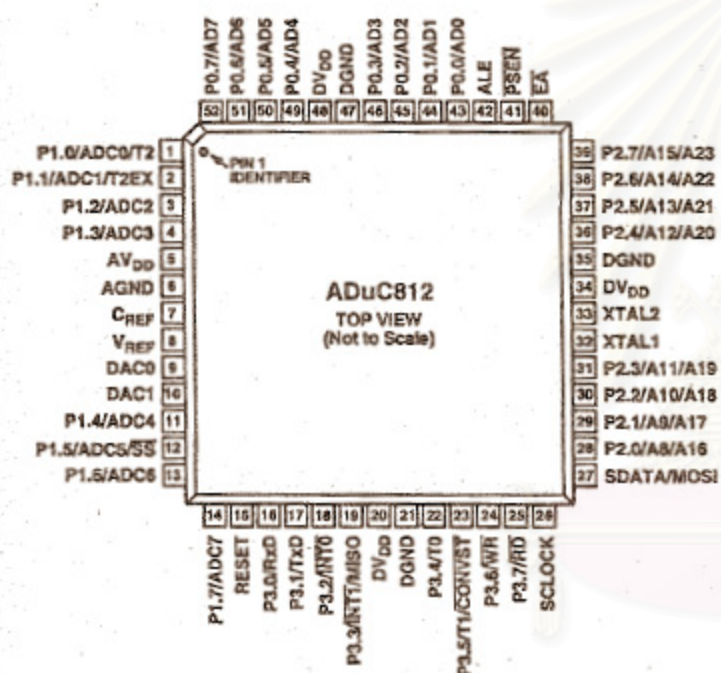
$AV_{DD}$ to $DV_{DD}$ .....	-0.3 V to +0.3 V
AGND to DGND .....	-0.3 V to +0.3 V
$DV_{DD}$ to DGND, $AV_{DD}$ to AGND .....	-0.3 V to +7 V
Digital Input Voltage to DGND ...	-0.3 V to $DV_{DD} + 0.3$ V
Digital Output Voltage to DGND ..	-0.3 V to $DV_{DD} + 0.3$ V
$V_{REF}$ to AGND .....	-0.3 V to $AV_{DD} + 0.3$ V
Analog Inputs to AGND .....	-0.3 V to $AV_{DD} + 0.3$ V
Operating Temperature Range Industrial (B Version)	
.....	-40°C to +85°C

Storage Temperature Range .....	-65°C to +150°C
Junction Temperature .....	150°C
$\theta_{JA}$ Thermal Impedance .....	90°C/W
Lead Temperature, Soldering	
Vapor Phase (60 sec) .....	215°C
Infrared (15 sec) .....	220°C

\*Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; functional operation of the device at these or any other conditions above those listed in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

## PIN CONFIGURATIONS

52-Lead MQFP



56-Lead LFCSP



## ORDERING GUIDE

Model	Temperature Range	Package Description	Package Option
ADuC812BS	-40°C to +85°C	52-Lead Metric Quad Flat Package	S-52
ADuC812BS	-40°C to +85°C	56-Lead Lead Frame Chip Scale Package	CP-56
EVAL-ADuC812QS		QuickStart Development System	
EVAL-ADuC812QSP		QuickStart Development System Plus	

## CAUTION

ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection. Although the ADuC812 features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD precautions are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.



## PIN FUNCTION DESCRIPTIONS

Mnemonic	Type	Function
DV <sub>DD</sub>	P	Digital Positive Supply Voltage, 3 V or 5 V Nominal.
AV <sub>DD</sub>	P	Analog Positive Supply Voltage, 3 V or 5 V Nominal.
C <sub>REF</sub>	I	Decoupling Input for On-Chip Reference. Connect 0.1 $\mu$ F between this pin and AGND.
V <sub>REF</sub>	I/O	Reference Input/Output. This pin is connected to the internal reference through a series resistor and is the reference source for the ADC. The nominal internal reference voltage is 2.5 V, which appears at the pin. This pin can be overdriven by an external reference.
AGND	G	Analog Ground. Ground reference point for the analog circuitry.
P1.0-P1.7	I	Port 1 is an 8-bit input port only. Unlike other ports, Port 1 defaults to Analog Input mode. To configure any of these Port Pins as a digital input, write a 0 to the port bit. Port 1 pins are multifunctional and share the following functionality.
ADC0-ADC7	I	Analog Inputs. Eight single-ended analog inputs. Channel selection is via ADCCON2 SFR.
T2	I	Timer 2 Digital Input. Input to Timer/Counter 2. When enabled, Counter 2 is incremented in response to a 1 to 0 transition of the T2 input.
T2EX	I	Digital Input. Capture/Reload trigger for Counter 2; also functions as an Up/Down control input for Counter 2.
$\overline{SS}$	I	Slave Select Input for the SPI Interface.
SDATA	I/O	User selectable, I <sup>2</sup> C Compatible or SPI Data Input/Output Pin.
SCLOCK	I/O	Serial Clock Pin for I <sup>2</sup> C Compatible or SPI Serial Interface Clock.
MOSI	I/O	SPI Master Output/Slave Input Data I/O Pin for SPI Interface.
MISO	I/O	SPI Master Input/Slave Output Data I/O Pin for SPI Serial Interface.
DAC0	O	Voltage Output from DAC0.
DAC1	O	Voltage Output from DAC1.
RESET	I	Digital Input. A high level on this pin for 24 master clock cycles while the oscillator is running resets the device. External power-on reset (POR) circuitry must be implemented to drive the RESET pin as described in the Power-On Reset Operation section.
P3.0-P3.7	I/O	Port 3 is a bidirectional port with internal pull-up resistors. Port 3 pins that have 1s written to them are pulled high by the internal pull-up resistors; in that state they can be used as inputs. As inputs, Port 3 pins being pulled externally low will source current because of the internal pull-up resistors. Port 3 pins also contain various secondary functions that are described below.
RxD	I/O	Receiver Data Input (Asynchronous) or Data Input/Output (Synchronous) of Serial (UART) Port
TxD	O	Transmitter Data Output (Asynchronous) or Clock Output (Synchronous) of Serial (UART) Port
$\overline{INT0}$	I	Interrupt 0, programmable edge or level triggered Interrupt input, $\overline{INT0}$ can be programmed to one of two priority levels. This pin can also be used as a gate control input to Timer 0.
$\overline{INT1}$	I	Interrupt 1, programmable edge or level triggered Interrupt input, $\overline{INT1}$ can be programmed to one of two priority levels. This pin can also be used as a gate control input to Timer 1.
T0	I	Timer/Counter 0 Input.
T1	I	Timer/Counter 1 Input.
$\overline{CONVST}$	I	Active Low Convert Start Logic Input for the ADC Block when the External Convert Start Function is Enabled. A low-to-high transition on this input puts the track-and-hold into its hold mode and starts conversion.
$\overline{WR}$	O	Write Control Signal, Logic Output. Latches the data byte from Port 0 into the external data memory.
$\overline{RD}$	O	Read Control Signal, Logic Output. Enables the external data memory to Port 0.
XTAL2	O	Output of the Inverting Oscillator Amplifier.
XTAL1	I	Input to the Inverting Oscillator Amplifier and to the Internal Clock Generator Circuits.
DGND	G	Digital Ground. Ground reference point for the digital circuitry.
P2.0-P2.7 (A8-A15) (A16-A23)	I/O	Port 2 is a bidirectional port with internal pull-up resistors. Port 2 pins that have 1s written to them are pulled high by the internal pull-up resistors; in that state they can be used as inputs. As inputs, Port 2 pins being pulled externally low will source current because of the internal pull-up resistors. Port 2 emits the high order address bytes during fetches from external program memory and middle and high order address bytes during accesses to the external 24-bit external data memory space.

## ADuC812

## PIN FUNCTION DESCRIPTIONS (continued)

Mnemonic	Type	Function
$\overline{\text{PSEN}}$	O	Program Store Enable, Logic Output. This output is a control signal that enables the external program memory to the bus during external fetch operations. It is active every six oscillator periods except during external data memory accesses. This pin remains high during internal program execution. $\overline{\text{PSEN}}$ can also be used to enable serial download mode when pulled low through a resistor on power-up or RESET.
ALE	O	Address Latch Enable, Logic Output. This output is used to latch the low byte (and page byte for 24-bit address space accesses) of the address into external memory during normal operation. It is activated every six oscillator periods except during an external data memory access.
$\overline{\text{EA}}$	I	External Access Enable, Logic Input. When held high, this input enables the device to fetch code from internal program memory locations 0000H to 1FFFH. When held low, this input enables the device to fetch all instructions from external program memory.
P0.7-P0.0 (A0-A7)	I/O	Port 0 is an 8-bit open-drain bidirectional I/O port. Port 0 pins that have 1s written to them float and in that state can be used as high impedance inputs. Port 0 is also the multiplexed low order address and data bus during accesses to external program or data memory. In this application, it uses strong internal pull-ups when emitting 1s.

## TERMINOLOGY

## ADC SPECIFICATIONS

## Integral Nonlinearity

This is the maximum deviation of any code from a straight line passing through the endpoints of the ADC transfer function. The endpoints of the transfer function are zero scale, a point 1/2 LSB below the first code transition, and full scale, a point 1/2 LSB above the last code transition.

## Differential Nonlinearity

This is the difference between the measured and the ideal 1 LSB change between any two adjacent codes in the ADC.

## Offset Error

This is the deviation of the first code transition (0000...000) to (0000...001) from the ideal, i.e., +1/2 LSB.

## Full-Scale Error

This is the deviation of the last code transition from the ideal AIN voltage (Full Scale - 1.5 LSB) after the offset error has been adjusted out.

## Signal-to-(Noise + Distortion) Ratio

This is the measured ratio of signal-to-(noise + distortion) at the output of the ADC. The signal is the rms amplitude of the fundamental. Noise is the rms sum of all nonfundamental signals up to half the sampling frequency ( $f_s/2$ ), excluding dc. The ratio is

dependent upon the number of quantization levels in the digitization process; the more levels, the smaller the quantization noise. The theoretical signal-to-(noise + distortion) ratio for an ideal N-bit converter with a sine wave input is given by:

$$\text{Signal-to-(Noise + Distortion)} = (6.02N + 1.76) \text{ dB}$$

Thus for a 12-bit converter, this is 74 dB.

## Total Harmonic Distortion

Total Harmonic Distortion is the ratio of the rms sum of the harmonics to the fundamental.

## DAC SPECIFICATIONS

## Relative Accuracy

Relative accuracy or endpoint linearity is a measure of the maximum deviation from a straight line passing through the endpoints of the DAC transfer function. It is measured after adjusting for zero-scale error and full-scale error.

## Voltage Output Settling Time

This is the amount of time it takes for the output to settle to a specified level for a full-scale input change.

## Digital-to-Analog Glitch Impulse

This is the amount of charge injected into the analog output when the inputs change state. It is specified as the area of the glitch in nV sec.

### ARCHITECTURE, MAIN FEATURES

The ADuC812 is a highly integrated, true 12-bit data acquisition system. At its core, the ADuC812 incorporates a high performance 8-bit (8052 compatible) MCU with on-chip reprogrammable nonvolatile Flash program memory controlling a multichannel (eight input channels) 12-bit ADC.

The chip incorporates all secondary functions to fully support the programmable data acquisition core. These secondary functions include User Flash Memory, Watchdog Timer (WDT), Power Supply Monitor (PSM), and various industry-standard parallel and serial interfaces.

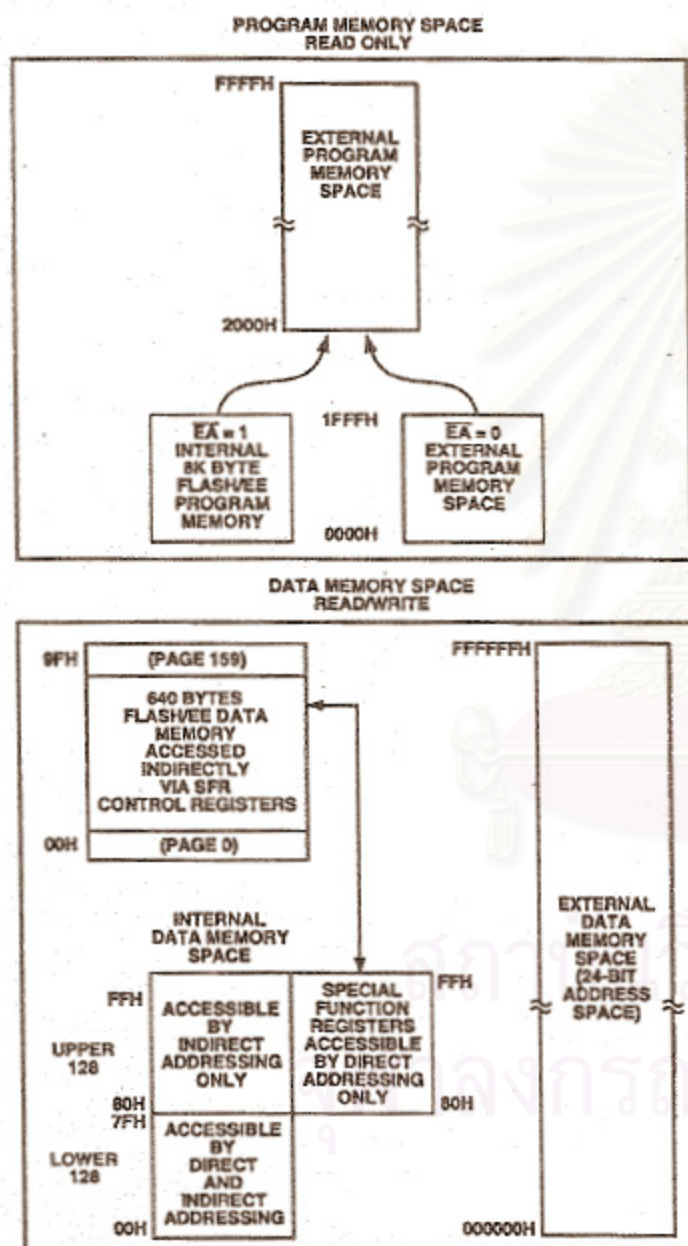


Figure 1. Program and Data Memory Maps

The lower 128 bytes of internal data memory are mapped as shown in Figure 2. The lowest 32 bytes are grouped into four banks of eight registers addressed as R0 through R7. The next 16 bytes (128 bits) above the register banks form a block of bit addressable memory space at bit addresses 00H through 7FH.

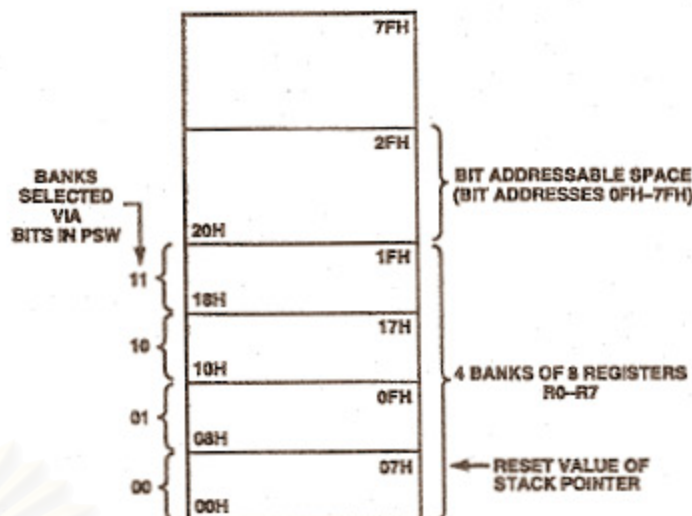


Figure 2. Lower 128 Bytes of Internal RAM

### MEMORY ORGANIZATION

As with all 8052 compatible devices, the ADuC812 has separate address spaces for program and data memory as shown in Figure 1. Also as shown in Figure 1, an additional 640 bytes of User Data Flash EEPROM are available to the user. The User Data Flash Memory area is accessed indirectly via a group of control registers mapped in the Special Function Register (SFR) area in the Data Memory Space.

The SFR space is mapped in the upper 128 bytes of internal data memory space. The SFR area is accessed by direct addressing only and provides an interface between the CPU and all on-chip peripherals. A block diagram showing the programming model of the ADuC812 via the SFR area is shown in Figure 3.

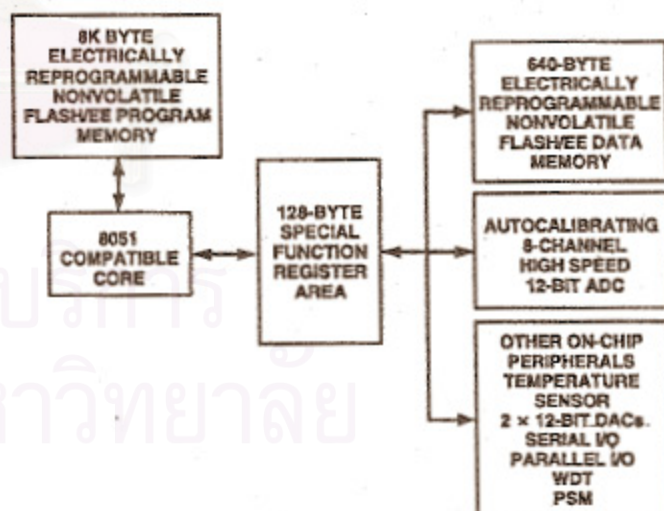


Figure 3. Programming Model

# ADuC812

## OVERVIEW OF MCU-RELATED SFRs

### Accumulator SFR

ACC is the Accumulator register and is used for math operations including addition, subtraction, integer multiplication and division, and Boolean bit manipulations. The mnemonics for accumulator-specific instructions refer to the Accumulator as A.

### B SFR

The B register is used with the ACC for multiplication and division operations. For other instructions, it can be treated as a general-purpose scratch pad register.

### Stack Pointer SFR

The SP register is the stack pointer and is used to hold an internal RAM address that is called the "top of the stack." The SP register is incremented before data is stored during PUSH and CALL executions. While the stack may reside anywhere in on-chip RAM, the SP register is initialized to 07H after a reset. This causes the stack to begin at location 08H.

### Data Pointer

The Data Pointer is made up of three 8-bit registers: DPP (page byte), DPH (high byte), and DPL (low byte). These are used to provide memory addresses for internal and external code access and external data access. It may be manipulated as a 16-bit register (DPTR = DPH, DPL), although INC DPTR instructions will automatically carry over to DPP, or as three independent 8-bit registers (DPP, DPH, and DPL).

### Program Status Word SFR

The PSW register is the Program Status Word that contains several bits reflecting the current status of the CPU as detailed in Table I.

SFR Address                      D0H  
Power-On Default Value        00H  
Bit Addressable                 Yes

CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P
----	----	----	-----	-----	----	----	---

Table I. PSW SFR Bit Designations

Bit	Name	Description	
7	CY	Carry Flag	
6	AC	Auxiliary Carry Flag	
5	F0	General-Purpose Flag	
4	RS1	Register Bank Select Bits	
3	RS0		
			RS1    RS0    Selected Bank
			0      0      0
			0      1      1
		1      0      2	
		1      1      3	
2	OV	Overflow Flag	
1	F1	General-Purpose Flag	
0	P	Parity Bit	

### Power Control SFR

The Power Control (PCON) register contains bits for power saving options and general-purpose status flags as shown in Table II.

SFR Address                      87H  
Power-On Default Value        00H  
Bit Addressable                 No

SMOD	—	—	ALEOFF	GF1	GF0	PD	IDL
------	---	---	--------	-----	-----	----	-----

Table II. PCON SFR Bit Designations

Bit	Name	Description
7	SMOD	Double UART Baud Rate
6	—	Reserved
5	—	Reserved
4	ALEOFF	Disable ALE Output
3	GF1	General-Purpose Flag Bit
2	GF0	General-Purpose Flag Bit
1	PD	Power-Down Mode Enable
0	IDL	Idle Mode Enable

## ADuC812

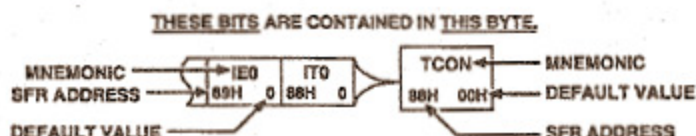
## SPECIAL FUNCTION REGISTERS

All registers except the program counter and the four general-purpose register banks reside in the special function register (SFR) area. The SFR registers include control, configuration, and data registers that provide an interface between the CPU and other on-chip peripherals.

Figure 4 shows a full SFR memory map and SFR contents on reset. Unoccupied SFR locations are shown dark shaded (NOT USED). Unoccupied locations in the SFR address space are not implemented, i.e., no register exists at this location. If an unoccupied location is read, an unspecified value is returned. SFR locations reserved for on-chip testing are shown lighter shaded (RESERVED) and should not be accessed by user software. Sixteen of the SFR locations are also bit addressable and denoted by "1" i.e., the bit addressable SFRs are those whose address ends in 0H or 8H.

ISPI FFH 0	WCOL FEH 0	SPE FDH 0	SPIM FCH 0	CPOL FBH 0	CPHA FAH 0	SPR1 F9H 0	SPR0 F8H 0	BITS	SPICON <sup>1</sup> F8H 00H	DAC0L F9H 00H	DAC0H FAH 00H	DAC1L FBH 00H	DAC1H FCH 00H	DACCON FDH 00H	RESERVED	NOT USED
F7H 0	F6H 0	F5H 0	F4H 0	F3H 0	F2H 0	F1H 0	F0H 0	BITS	B <sup>1</sup> F0H 00H	ADCOFSL <sup>2</sup> F1H 00H	ADCOFSH <sup>2</sup> F2H 20H	ADCGAINL <sup>2</sup> F3H 00H	ADCGAINH <sup>2</sup> F4H 00H	ADCCON3 F5H 00H	RESERVED	SPIDAT F7H 00H
MDO EFH 0	MDE EEH 0	MCO EDH 0	MDI ECH 0	I2CM EBH 0	I2CRS EAH 0	I2CTX E9H 0	I2CI E8H 0	BITS	I2CCON <sup>1</sup> E8H 00H	RESERVED	RESERVED	RESERVED	RESERVED	RESERVED	RESERVED	ADCCON1 EFH 20H
E7H 0	E6H 0	E5H 0	E4H 0	E3H 0	E2H 0	E1H 0	E0H 0	BITS	ACC <sup>1</sup> E9H 00H	RESERVED	RESERVED	RESERVED	RESERVED	RESERVED	RESERVED	RESERVED
ADC1 DFH 0	DMA DEH 0	CCONV DOH 0	SCONV DCH 0	CS3 DBH 0	CS2 DAH 0	CS1 D9H 0	CS0 D8H 0	BITS	ADCCON2 <sup>2</sup> D8H 00H	ADCCDATA1 D9H 00H	ADCCDATAH DAH 00H	RESERVED	RESERVED	RESERVED	RESERVED	PSMCON DFH DEH
CY D7H 0	AC D6H 0	F0 D5H 0	RS1 D4H 0	RS0 D3H 0	OY D2H 0	FI D1H 0	P D0H 0	BITS	PSW <sup>1</sup> D0H 00H	RESERVED	DMAL D2H 00H	DMAH D3H 00H	DMAH D4H 00H	RESERVED	RESERVED	RESERVED
TF2 CFH 0	EXF2 CEH 0	RCLK CDH 0	TCLK CCH 0	EXEN2 CBH 0	TR2 CAH 0	CNT2 C9H 0	CAP2 C8H 0	BITS	T2CON <sup>1</sup> C8H 00H	RESERVED	RCAP2L CAH 00H	RCAP2H CBH 00H	TL2 CCH 00H	TH2 CDH 00H	RESERVED	RESERVED
PRE2 C7H 0	PRE1 C6H 0	PRE0 C5H 0	WDR1 C4H 0	WDR2 C3H 0	WOS C2H 0	WDE C1H 0	WDE C0H 0	BITS	WDCON <sup>1</sup> C0H 00H	NOT USED	NOT USED	NOT USED	ETIM3 C4H C9H	RESERVED	EDARL C6H 00H	RESERVED
PS1 BFH 0	PADC BEH 0	PT2 BDH 0	PS BCH 0	PT1 BBH 0	PX1 BAH 0	PT0 B9H 0	PX0 B8H 0	BITS	IP <sup>1</sup> B8H 00H	ECON B9H 00H	ETIM1 BAH 02H	ETIM2 BBH 04H	EDATA1 BCH 00H	EDATA2 BDH 00H	EDATA3 BEH 00H	EDATA4 BFH 00H
RD B7H 1	WR B6H 1	T1 B5H 1	T0 B4H 1	INT1 B3H 1	INT0 B2H 1	TxD B1H 1	RxD B0H 1	BITS	P3 <sup>1</sup> B0H FFH	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED
EA AFH 0	EADC AEH 0	ET2 ADH 0	ES ACH 0	ET1 ABH 0	EX1 AAH 0	ET0 A9H 0	EX0 A8H 0	BITS	IE <sup>1</sup> A8H 00H	IE2 A9H 00H	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED
A7H 1	A6H 1	A5H 1	A4H 1	A3H 1	A2H 1	A1H 1	A0H 1	BITS	P2 <sup>1</sup> A0H FFH	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED
SM0 9FH 0	SM1 9EH 0	SM2 9DH 0	REN 9CH 0	TB8 9BH 0	RB8 9AH 0	T1 99H 0	R1 98H 0	BITS	SCON <sup>1</sup> 98H 00H	SBUF 99H 00H	I2CDATA 9AH 00H	I2CADD 9BH 55H	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED
97H 1	96H 1	95H 1	94H 1	93H 1	92H 1	91H 1	90H 1	BITS	P1 <sup>1,3</sup> 90H FFH	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED
TF1 8FH 0	TR1 8EH 0	TF0 8DH 0	TR0 8CH 0	IE1 8BH 0	IT1 8AH 0	IE0 89H 0	IT0 88H 0	BITS	TCON <sup>1</sup> 88H 00H	TMOD 89H 00H	TL0 8AH 00H	TL1 8BH 00H	TH0 8CH 00H	TH1 8DH 00H	NOT USED	NOT USED
87H 1	86H 1	85H 1	84H 1	83H 1	82H 1	81H 1	80H 1	BITS	P0 <sup>1</sup> 80H FFH	SP 81H 07H	DPL 82H 00H	DPH 83H 00H	DPP 84H 00H	RESERVED	RESERVED	PCON 87H 00H

SFR MAP KEY:



SFR NOTES

<sup>1</sup>SFRs WHOSE ADDRESS ENDS IN 0H OR 8H ARE BIT ADDRESSABLE.

<sup>2</sup>CALIBRATION COEFFICIENTS ARE PRECONFIGURED ON POWER-UP TO FACTORY CALIBRATED VALUES.

<sup>3</sup>THE PRIMARY FUNCTION OF PORT 1 IS AS AN ANALOG INPUT PORT; THEREFORE, TO ENABLE THE DIGITAL SECONDARY FUNCTIONS ON THESE PORT PINS, WRITE A "0" TO THE CORRESPONDING PORT 1 SFR BIT.

Figure 4. Special Function Register Locations and Reset Values

## ADuC812

### ADuC812 HARDWARE DESIGN CONSIDERATIONS

This section outlines some of the key hardware design considerations that must be addressed when integrating the ADuC812 into any hardware system.

#### Clock Oscillator

The clock source for the ADuC812 can come either from an external source or from the internal clock oscillator. To use the internal clock oscillator, connect a parallel resonant crystal between Pins 32 and 33, and connect a capacitor from each pin to ground as shown below.

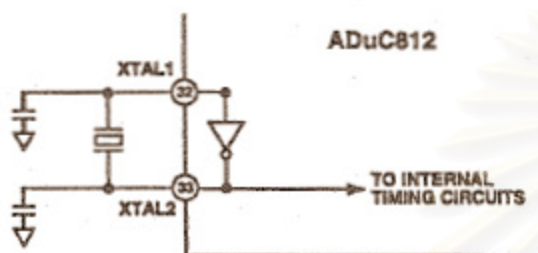


Figure 35. External Parallel Resonant Crystal Connections

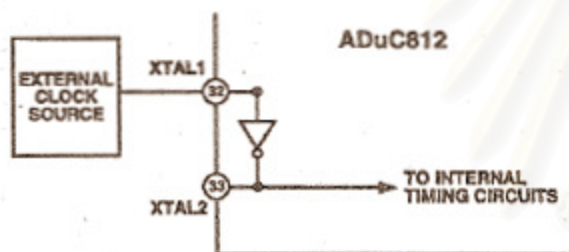


Figure 36. Connecting an External Clock Source

Whether using the internal oscillator or an external clock source, the ADuC812's specified operational clock speed range is 300 kHz to 16 MHz. The core is static, and will function all the way down to dc. But at clock speeds slower than 400 kHz the ADC will no longer function correctly. Therefore, to ensure specified operation, use a clock frequency of at least 400 kHz and no more than 16 MHz.

#### External Memory Interface

In addition to its internal program and data memories, the ADuC812 can access up to 64 K bytes of external program memory (ROM, PROM, etc.) and up to 16 M bytes of external data memory (SRAM).

To select from which code space (internal or external program memory) to begin executing instructions, tie the  $\overline{EA}$  (external access) pin high or low, respectively. When  $\overline{EA}$  is high (pulled up to  $V_{DD}$ ), user program execution will start at address 0 of the internal 8 K bytes Flash/EE code space. When  $\overline{EA}$  is low (tied to ground) user program execution will start at address 0 of the external code space. In either case, addresses above 1FFFH (8K) are mapped to the external space.

Note that a second very important function of the  $\overline{EA}$  pin is described in the Single Pin Emulation Mode section.

External program memory (if used) must be connected to the ADuC812 as illustrated in Figure 37. Note that 16 I/O lines (Ports 0 and 2) are dedicated to bus functions during external program memory fetches. Port 0 (P0) serves as a multiplexed address/data bus. It emits the low byte of the program counter (PCL) as an address, and then goes into a float state awaiting the arrival of the code byte from the program memory. During the time that the low byte of the program counter is valid on P0, the signal ALE (Address Latch Enable) clocks this byte into an address latch. Meanwhile, Port 2 (P2) emits the high byte of the program counter (PCH), then  $\overline{PSEN}$  strobes the EPROM and the code byte is read into the ADuC812.

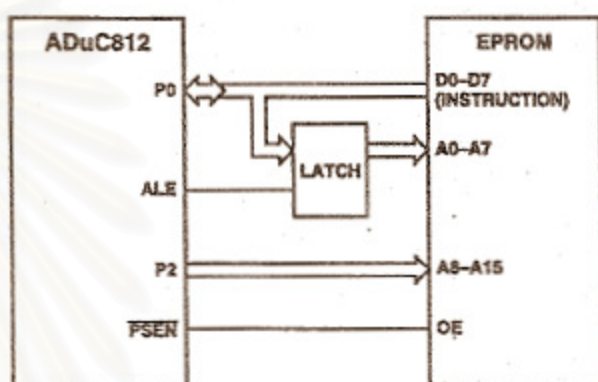


Figure 37. External Program Memory Interface

Note that program memory addresses are always 16 bits wide, even in cases where the actual amount of program memory used is less than 64 K bytes. External program execution sacrifices two of the 8-bit ports (P0 and P2) to the function of addressing the program memory. While executing from external program memory, Ports 0 and 2 can be used simultaneously for read/write access to external data memory, but not for general-purpose I/O.

Though both external program memory and external data memory are accessed by some of the same pins, the two are completely independent of each other from a software point of view. For example, the chip can read/write external data memory while executing from external program memory.

Figure 38 shows a hardware configuration for accessing up to 64 K bytes of external RAM. This interface is standard to any 8051 compatible MCU.

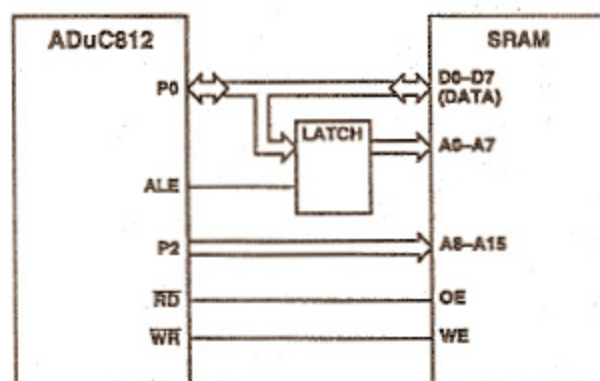


Figure 38. External Data Memory Interface (64K Address Space)

## ADuC812

If access to more than 64K bytes of RAM is desired, a feature unique to the ADuC812 allows addressing up to 16 MBytes of external RAM simply by adding an additional latch as illustrated in Figure 39.

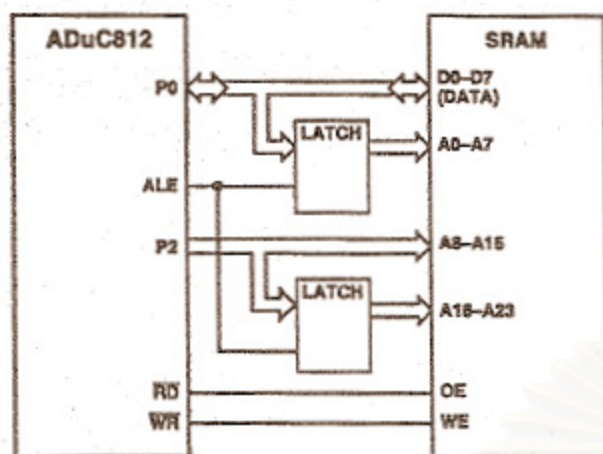


Figure 39. External Data Memory Interface (16 M Bytes Address Space)

In either implementation, Port 0 (P0) serves as a multiplexed address/data bus. It emits the low byte of the data pointer (DPL) as an address, which is latched by a pulse of ALE prior to data being placed on the bus by the ADuC812 (write operation) or the SRAM (read operation). Port 2 (P2) provides the data pointer page byte (DPP) to be latched by ALE, followed by the data pointer high byte (DPH). If no latch is connected to P2, DPP is ignored by the SRAM and the 8051 standard of 64K byte external data memory access is maintained.

Detailed timing diagrams of external program and data memory read and write access can be found in the Timing Specification sections.

#### Power-On Reset Operation

External POR (power-on reset) circuitry must be implemented to drive the RESET pin of the ADuC812. The circuit must hold the RESET pin asserted (high) whenever the power supply ( $DV_{DD}$ ) is below 2.5 V. Furthermore,  $V_{DD}$  must remain above 2.5 V for at least 10 ms before the RESET signal is deasserted (low), by which time the power supply must have reached at least a 2.7 V level. The timing diagram in Figure 40 illustrates this functionality under three separate events: power-up, brownout, and power-down. Notice that when RESET is asserted (high), it tracks the voltage on  $DV_{DD}$ . These recommendations must be adhered to through the manufacturing flow of your ADuC812 based system as well as during its normal power-on operation. Failure to adhere to these recommendations can result in permanent damage to device functionality.

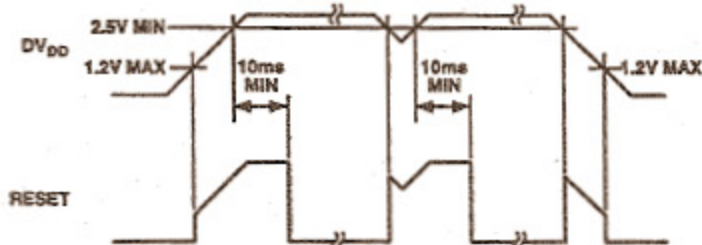


Figure 40. External POR Timing

The best way to implement an external POR function to meet the above requirements involves the use of a dedicated POR chip, such as the ADM809/ADM810 SOT-23 packaged PORs from Analog Devices. Recommended connection diagrams for both active high ADM810 and active low ADM809 PORs are shown in Figure 41 and Figure 42, respectively.

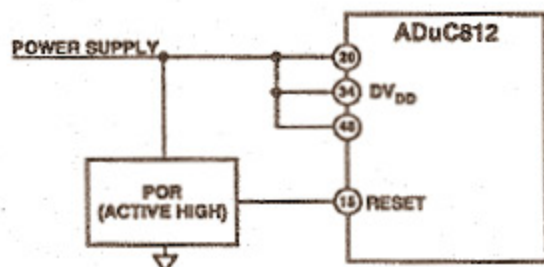


Figure 41. External Active High POR Circuit

Some active-low POR chips, such as the ADM809, can be used with a manual push-button as an additional reset source as illustrated by the dashed line connection in Figure 42.

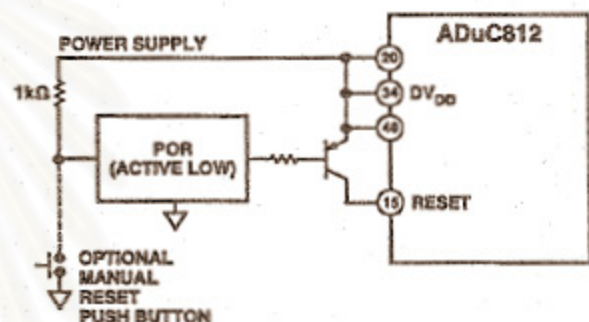


Figure 42. External Active Low POR Circuit

#### Power Supplies

The ADuC812's operational power supply voltage range is 2.7 V to 5.25 V. Although the guaranteed data sheet specifications are given only for power supplies within 2.7 V to 3.6 V or  $\pm 10\%$  of the nominal 5 V level, the chip will function equally well at any power supply level between 2.7 V and 5.5 V.

Separate analog and digital power supply pins ( $AV_{DD}$  and  $DV_{DD}$ , respectively) allow  $AV_{DD}$  to be kept relatively free of noisy digital signals often present on the system  $DV_{DD}$  line. However, though you can power  $AV_{DD}$  and  $DV_{DD}$  from two separate supplies if desired, you must ensure that they remain within  $\pm 0.3$  V of one another at all times in order to avoid damaging the chip (as per the Absolute Maximum Ratings section). Therefore it is recommended that unless  $AV_{DD}$  and  $DV_{DD}$  are connected directly together, you connect back-to-back Schottky diodes between them as shown in Figure 43.

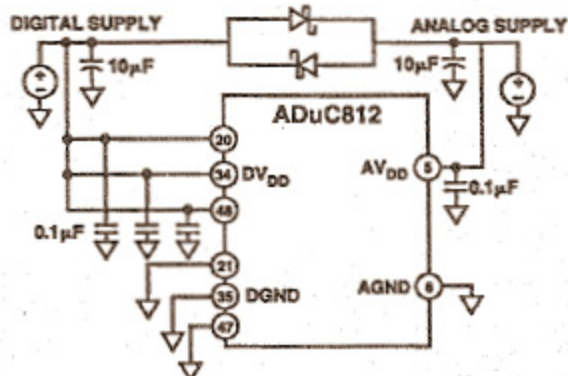


Figure 43. External Dual-Supply Connections



## ADuC812

As an alternative to providing two separate power supplies, the user can help keep  $AV_{DD}$  quiet by placing a small series resistor and/or ferrite bead between it and  $DV_{DD}$ , and then decoupling  $AV_{DD}$  separately to ground. An example of this configuration is shown in Figure 44. With this configuration, other analog circuitry (such as op amps, voltage reference, and so on) can be powered from the  $AV_{DD}$  supply line as well. The user will still want to include back-to-back Schottky diodes between  $AV_{DD}$  and  $DV_{DD}$  in order to protect from power-up and power-down transient conditions that could separate the two supply voltages momentarily.

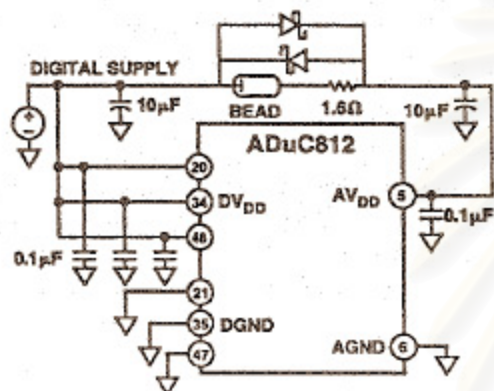


Figure 44. External Single-Supply Connections

Notice that in both Figure 43 and Figure 44, a large value ( $10\ \mu\text{F}$ ) reservoir capacitor sits on  $DV_{DD}$  and a separate  $10\ \mu\text{F}$  capacitor sits on  $AV_{DD}$ . Also, local small value ( $0.1\ \mu\text{F}$ ) capacitors are located at each  $V_{DD}$  pin of the chip. As per standard design practice, be sure to include all of these capacitors, and ensure the smaller capacitors are close to each  $AV_{DD}$  pin with trace lengths as short as possible. Connect the ground terminal of each of these capacitors directly to the underlying ground plane. Finally, it should also be noted that, at all times, the analog and digital ground pins on the ADuC812 must be referenced to the same system ground reference point.

### Power Consumption

The currents consumed by the various sections of the ADuC812 are shown in Table XXVII. The CORE values given represent the current drawn by  $DV_{DD}$ , while the rest (ADC, DAC, Voltage Reference) are pulled by the  $AV_{DD}$  pin and can be disabled in software when not in use. The other on-chip peripherals (watchdog timer, power supply monitor, and so on) consume negligible current and are therefore lumped in with the CORE operating current here. Of course, the user must add any currents sourced by the DAC or the parallel and serial I/O pins, in order to determine the total current needed at the ADuC812's supply pins. Also, current drawn from the  $DV_{DD}$  supply will increase by approximately 10 mA during Flash/EE erase and program cycles.

Table XXVII. Typical  $I_{DD}$  of Core and Peripherals

	$V_{DD} = 5\ \text{V}$	$V_{DD} = 3\ \text{V}$
CORE (Normal Mode)	$(1.6\ \text{nAs} \times \text{MCLK}) + 6\ \text{mA}$	$(0.8\ \text{nAs} \times \text{MCLK}) + 3\ \text{mA}$
CORE (Idle Mode)	$(0.75\ \text{nAs} \times \text{MCLK}) + 5\ \text{mA}$	$(0.25\ \text{nAs} \times \text{MCLK}) + 3\ \text{mA}$
ADC	1.3 mA	1.0 mA
DAC (Each)	250 $\mu\text{A}$	200 $\mu\text{A}$
Voltage Ref	200 $\mu\text{A}$	150 $\mu\text{A}$

Since operating  $DV_{DD}$  current is primarily a function of clock speed, the expressions for CORE supply current in Table XXVII are given as functions of MCLK, the oscillator frequency. Plug in a value for MCLK in hertz to determine the current consumed by the core at that oscillator frequency. Since the ADC and DACs can be enabled or disabled in software, add only the currents from the peripherals you expect to use. The internal voltage reference is automatically enabled whenever either the ADC or at least one DAC is enabled. And again, do not forget to include current sourced by I/O pins, serial port pins, DAC outputs, and so forth, plus the additional current drawn during Flash/EE erase and program cycles.

A software switch allows the chip to be switched from normal mode into idle mode, and also into full power-down mode. Below are brief descriptions of power-down and idle modes.

In idle mode, the oscillator continues to run but is gated off to the core only. The on-chip peripherals continue to receive the clock, and remain functional. Port pins and DAC output pins retain their states in this mode. The chip will recover from idle mode upon receiving any enabled interrupt, or upon receiving a hardware reset.

In full power-down mode, the on-chip oscillator stops, and all on-chip peripherals are shut down. Port pins retain their logic levels in this mode, but the DAC output goes to a high impedance state (three-state). The chip will only recover from power-down mode upon receiving a hardware reset or when power is cycled. During full power-down mode, the ADuC812 consumes a total of approximately 5  $\mu\text{A}$ .

### Grounding and Board Layout Recommendations

As with all high resolution data converters, special attention must be paid to grounding and PC board layout of ADuC812 based designs in order to achieve optimum performance from the ADC and DACs.

Although the ADuC812 has separate pins for analog and digital ground (AGND and DGND), the user must not tie these to two separate ground planes unless the two ground planes are connected together very close to the ADuC812, as illustrated in the simplified example of Figure 45a. In systems where digital and analog ground planes are connected together somewhere else (for example, at the system's power supply), they cannot be connected again near the ADuC812 since a ground loop would result. In these cases, tie the ADuC812's AGND and DGND pins all to the analog ground plane, as illustrated in Figure 45b. In systems with only one ground plane, ensure that the digital and analog components are physically separated onto separate halves of the board such that digital return currents do not flow near analog circuitry and vice versa. The ADuC812 can then be placed between the digital and analog sections, as illustrated in Figure 45c.

In all of these scenarios, and in more complicated real-life applications, keep in mind the flow of current from the supplies and back to ground. Make sure the return paths for all currents are as close as possible to the paths the currents took to reach their destinations. For example, do not power components on the analog side of Figure 45b with  $DV_{DD}$  since that would force return currents from  $DV_{DD}$  to flow through AGND. Also, try to avoid digital currents flowing under analog circuitry, which could happen if the user placed a noisy digital chip on the left half of the board in Figure 45c. Whenever possible, avoid large discontinuities in the ground plane(s) (formed by a long trace on the same layer), since they force return signals to travel a longer path. And of course, make all connections to the ground plane directly, with little or no trace separating the pin from its via to ground.

If the user plans to connect fast logic signals (rise/fall time  $< 5$  ns) to any of the ADuC812's digital inputs, add a series resistor to each relevant line to keep rise and fall times longer than 5 ns at the ADuC812 input pins. A value of 100 or 200  $\Omega$  is usually sufficient to prevent high speed signals from coupling capacitively into the ADuC812 and affecting the accuracy of ADC conversions.

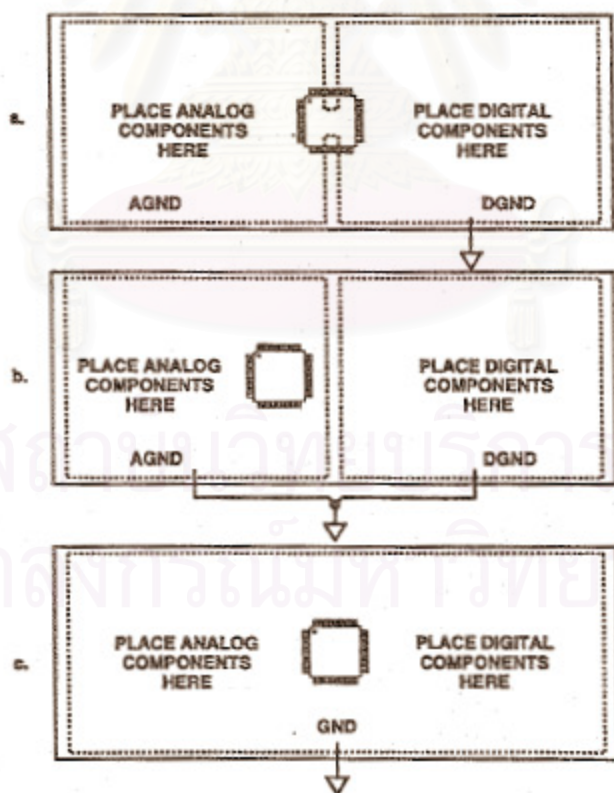


Figure 45. System Grounding Schemes

ภาคผนวก ข.

โปรแกรมควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## โปรแกรมควบคุม SCA

```
$MOD812
CSEG
ORG 0000h

MAIN: MOV DACCON,#07FH
NEXT0:
    JB P3.0,NEXT0_0
    JNB P3.0,NEXT2

NEXT0_0:
    MOV DACCON,#7FH ;BOTH DACS ACTIVE ,Vdd=5V
    MOV A,P0
NEXT0_1: MOV DAC0L,A ;DAC0
NEXT1: MOV DAC0H,A
    AJMP NEXT0

NEXT2:
    MOV DACCON,#7FH ; BOTH DACS ACTIVE,Vdd = 5V
    MOV B,P0
NEXT2_1: MOV DAC1L,B ; DAC1
NEXT2_2: MOV DAC1H,B
    JNB P3.0,NEXT2
    AJMP NEXT0

END
```

## โปรแกรมควบคุม SCA SWEEP

```
$MOD812
```

```
CSEG
```

```
ORG 0000h
```

```
MAIN: MOV DACCON,#07FH
```

```
AJMP NEXT0_00
```

```
NEXT0:
```

```
JB P3.0,NEXT0_0
```

```
JNB P3.0,NEXT2
```

```
NEXT0_0: ; JB P3.1, RATE
```

```
JB P3.2,SWEEP
```

```
NEXT0_00: MOV DACCON,#7FH ;BOTH DACS ACTIVE ,Vdd=5V
```

```
MOV A,P0
```

```
NEXT0_1: MOV DAC0L,A ;DAC0
```

```
NEXT1: MOV DAC0H,A
```

```
JB P3.1,RATE
```

```
AJMP NEXT0
```

```
NEXT2: ;JB P3.1, RATE
```

```
JB P3.2,SWEEP
```

```
MOV DACCON,#7FH ; BOTH DACS ACTIVE,Vdd = 5V
```

```
MOV B,P0
```

```
NEXT2_1: MOV DAC1L,B ;DAC1
```

```
NEXT2_2: MOV DAC1H,B
```

```
JB P3.1,RATE
```

```
JNB P3.0,NEXT2
```

```
AJMP NEXT0
```

```
RATE:
```

```
AJMP RATE
```

```
SWEEP: MOV DACCON,#7FH ; BOTH DACS ACTIVE,Vdd = 5V
```

```
MOV DAC0L,#000H ;DAC0 ;0
```

```
MOV DAC0H,#000H
```

```
LCALL DELAY_1S
```

```
MOV DAC1L,#003H ;DAC1 ;X1
```

```
MOV DAC1H,#000H
```

```
LCALL DELAY_1S
```

```
MOV DAC0L,#003H ;DAC0 ;X1
```

```
MOV DAC0H,#000H
```

```
LCALL DELAY_1S
```

```
MOV DAC1L,#006H ;DAC1 ;X2
```

```
MOV DAC1H,#000H
```

```
LCALL DELAY_1S
```

```
MOV DAC0L,#006H ;DAC0 ;X2
```

```
MOV DAC0H,#000H
```

```
LCALL DELAY_1S
```

```
MOV DAC1L,#009H ;DAC1 ;X3
```

```
MOV DAC1H,#000H
```

```
LCALL DELAY_1S
```

```
MOV DAC0L,#009H ;DAC0 ;X3
```

```
MOV DAC0H,#000H
```

```
LCALL DELAY_1S
```

```
.  
.
..
.  
.
```

เพิ่มค่าแรงดันต่อเนื่อง

```
MOV DAC1L,#081H ;DAC1 ;X299
```

```
MOV DAC1H,#003H
```

```
LCALL DELAY_1S
```

```
MOV DAC0L,#081H ;DAC0 ;X299
```

```
MOV DAC0H,#003H

LCALL DELAY_1S

MOV DAC1L,#084H ;DAC1 ;X300

MOV DAC1H,#003H

LCALL DELAY_1S

MOV DAC0L,#084H ;DAC0 ;X300

MOV DAC0H,#003H

LCALL DELAY_1S

LJMP SWEEP

DELAY_100MS: MOV R5,#10
DELAY_100MS_1: ACALL DELAY_10MS
                DJNZ R5,DELAY_100MS_1
                RET
DELAY_500MS: MOV R5,#50
DELAY_500MS_1: ACALL DELAY_10MS
                DJNZ R5,DELAY_500MS_1
                RET

DELAY_1S: MOV R5,#200 ;1 minute
DELAY_1S_1: ACALL DELAY_10MS
DJNZ R5,DELAY_1S_1
                RET
```



```
;DELAY_1S: MOV R5,#100  
;DELAY_1S_1: ACALL DELAY_10MS  
DJNZ R5,DELAY_1S_1  
RET
```

```
DELAY_10MS: MOV R7,#010  
DELAY_10MS_1: MOV R6,#0E6H  
DELAY_10MS_2: NOP  
NOP  
DJNZ R6,DELAY_10MS_2  
DJNZ R7,DELAY_10MS_1  
RET  
END
```



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายรุ่งพันธ์ เกตุกล้า เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อปีการศึกษา 2538 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันรับราชการที่สำนักงานประมงเพื่อสันติ



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย